

목 차

분기 보고서	2
【대표이사 등의 확인】	3
I. 회사의 개요	4
1. 회사의 개요	4
2. 회사의 연혁	9
3. 자본금 변동사항	14
4. 주식의 총수 등	17
5. 의결권 현황	19
6. 배당에 관한 사항 등	19
II. 사업의 내용	21
III. 재무에 관한 사항	49
IV. 감사인의 감사의견 등	57
V. 이사의 경영진단 및 분석의견	60
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항	61
1. 이사회에 관한 사항	61
2. 감사제도에 관한 사항	71
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항	74
4. 계열회사 등의 현황	74
VII. 주주에 관한 사항	87
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	93
1. 임원 및 직원의 현황	93
2. 임원의 보수 등	98
IX. 이해관계자와의 거래내용	103
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	105
XI. 재무제표 등	115
XII. 부속명세서	130
【전문가의 확인】	133
1. 전문가의 확인	133
2. 전문가와의 이해관계	133

분기보고서

(제 65 기)

사업연도 2012년 01월 01일 부터
2012년 03월 31일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2012년 05월 23일

회 사 명 : 에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 : 권 오 철 (인)

본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-630-4114

(홈페이지) <http://www.skhynix.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 이 명 영 (인)

(전 화) 02-3459-5541~8

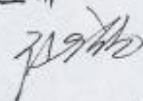
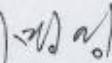
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 내용이 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2012. 05. 23.

주식회사	하이닉스반도체
대표이사	권오철 
공시책임자	이명영 

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

에스케이하이닉스는 이천, 청주의 국내 사업장을 비롯하여 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 생산 공장과 전세계 16개국에 걸쳐 판매 법인 및 국내외 사무소를 두고 있는 글로벌 기업으로서 지속적인 연구개발 및 투자로 기술 및 원가 경쟁력을 확보하고 있으며, 세계 반도체 시장을 선도하기 위해 노력하고 있습니다.

당사의 개요와 관련한 보다 자세한 내용은 다음과 같습니다.

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업 연도말 자산총액	지배관 계 근거	주요종 속 회사 여 부
(주)하이닉스엔지니어링	2001. 04	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	40,267	지분 50% 초과보 유	X
(주)하이스텍	2008. 03	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	16,528	지분 50% 초과보 유	X
(주)하이닉스인재개발원	2008. 03	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	교육사업	2,157	지분 50% 초과보 유	X
(주)하이로지텍	2008. 03	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	물류사업	2,946	지분 50% 초과보 유	X
아미파워(주)	2010. 01	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	열병합 발전	59,608	지분 50% 초과보 유	○

(주)큐알티반도체	2005.03	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	반도체 신뢰성 평가	10,784	지분 50% 초과보유	X
SK hynix America Inc.(SKHYA)	1983.03	3101 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A.	반도체 판매	764,593	지분 50% 초과보유	○
Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc.(HSMA)	1995.07	1830 Willow Creek Circle, Eugene OR,97104, U.S.A.	반도체 생산	59,700	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	1989.03	Am Prime Parc 13, Kelsterbacher Str.16, D-65479 Raunheim, Germany	반도체 판매	132,495	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Europe Holding Ltd.(SKHYE)	1995.07	243 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 ORH, U.K.	해외현지 투자 지주회사	214,829	지분 50% 초과보유	○
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	1995.07	243 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 ORH, U.K.	반도체 판매	91,146	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Asia Pte.Ltd.(SKHYS)	1991.09	7 Temasek Boulevard #42-02 Suntec City Tower1 Singapore 038987	반도체 판매	135,027	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(SKHYIS)	2006.11	Unit 10, Level 8, Innovator Building, ITPB(International Technology Park Bangalore), Whitefield Road, Bangalore 560066, India	반도체 판매	623	지분 50% 초과보유	X
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SKHYH)	1995.04	Suite 2401, 24F., Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong	반도체 판매	240,632	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(SKHYCS)	2001.08	Room 2702-2705, Maxdo Center, No.8, Xing Yi RD, Changning Zone, Shanghai, China	반도체 판매	23,125	지분 50% 초과보유	X

SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	1996.09	23F SHIROYAMA TRUST TOWER, 4-3-1 Toranomon, Minatoku, Tokyo	반도체 판매	264,567	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	1996.07	11F, No.392, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei11492, Taiwan, R.O.C.	반도체 판매	321,079	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	2005.04	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in WuxiNew District, Wuxi, Jiangsu Province, China	웨이퍼 생산 및 판매	3,732,468	지분 50% 초과보유	○
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	2006.04	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in WuxiNew District, Wuxi, Jiangsu Province, China	웨이퍼 생산 및 판매	262,395	지분 50% 초과보유	○
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	2010.08	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in WuxiNew District, Wuxi, Jiangsu Province, China	반도체 판매	883	지분 50% 초과보유	X

주요 종속회사 판단기준: 직전 사업연도말 자산총액 500억원 이상

나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 에스케이하이닉스 주식회사이며, 영문으로는 SK hynix Inc.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 SK하이닉스 또는 SK hynix라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 1949년 10월 국도건설 주식회사로 설립되어 1983년 2월 현대전자산업주식회사로 상호를 변경하였으며, 이후 2001년 3월 주식회사 하이닉스반도체로, 2012년 3월 에스케이하이닉스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '000660'입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소: 경기도 이천시 경충대로 2091
 전화번호: 031-630-4114
 홈페이지: <http://www.skhynix.com>

마. 주요 사업의 내용

현재 당사의 주력 생산제품은 DRAM, 낸드플래시 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품이며, 2007년부터는 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에 재진출하여 종합 반도체 회사로 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

당사 정관에 근거하여 현재 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

- 반도체소자 제조 및 판매
- 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매
- 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업
- 기술연구 및 용역수탁업
- 부동산 매매 및 임대업

한편, 사업실적은 없으나, 환경 변화에 능동적이고 유기적으로 대처하기 위하여 유지하고 있는 목적사업은 다음과 같습니다.

- 무역업
- 정보서비스업
- 기계부분품 제조업 및 금형제조업
- 특수통신(위성통신 등) 방송관련 기기 제작, 판매, 임대업 및 서비스업
- 출판업
- 발전업
- 건설업
- 전자관 제조업
- 창고업
- 주차장업
- 위성통신사업
- 전기통신회선설비 임대사업
- 전자 전기 기계, 기구의 임대업
- 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업
- 전자상거래 및 인터넷 관련사업
- 전기 각호와 관련되는 사업 및 투자

사업부문별 보다 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(1) 기업집단의 명칭 : SK계열

(2) 기업집단에 소속된 회사 (2012. 4. 12 기준 계열사 : 94개사)

업종	상장사	비상장사
지주회사(1)	SK(주)	-

에너지·화학 (30)	SK이노베이션(주), SK케미칼(주), SKC(주), SK가스(주), 코원에너지서비스 (주), (주)부산도시가스	SK E&S(주), SK에너지(주), SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), (주)대한송유관 공사, SK모바일에너지(주), 충청에너지서비스(주), 영남에너지서비스(주), 전북에너지서비스(주), 전남도시가스(주), 강원도시가스(주), 평택에너지서비 스(주), SK사이텍(주), SK유화(주), SKC에어가스(주), (주)남원사랑발전소, 인싸이 토(주), (주)지코스, SK더블유(주), 유베이스매뉴팩처링아시아(주), 울산아로마틱스 (주), 김천에너지(주), 피엠피(주), 아미파워(주)
정보통신/ 전기전자 (29)	SK텔레콤(주), (주)로엔엔터테인먼트, SK커뮤니케이션즈 (주), SK브로드밴드(주), SK C&C(주), SK하이닉스(주), 주식회사실리콘화 일	SK텔레시스(주), SK텔링크(주), 인포섹(주), 엔카네트워크(주), (주)팍스넷, (주)인디펜던스, (주)커머스플래닛, 피에스앤마켓팅(주), 에스케이네트웍스인터넷(주), 브로드밴드미디어(주), 브로드밴드D&M(주), 텔레비전미디어코리아(주), 서비스에이스(주), 서비스탑(주), 서비스인주식회 사, 넷웍오앤에스(주), SKC라이팅(주), (주)에이앤티에스, 엘씨앤씨주식회 사, SK플래닛(주), (주)하이시텍, 주식회사큐알티반도체
건설/물류/서비 스 (26)	SK네트웍스(주)	SK건설(주), SK해운(주), 행복나래주식회사, SK디앤디(주), 엠앤서비스(주), 에프앤유신용정보(주), SK네트웍스서비스(주), 리얼베스트(주), 내트럭(주), SK마케팅애크퍼니(주), 브로드밴드씨에스(주), 앤츠개발(주), SK신택(주), 더블유에스통상(주), 엠케이에스개런티(유), SK임업(주), 대전맑은물(주), 광주맑은물(주), SK핀크스(주), 내트럭프렌즈(주), SK에스엠주 식회사, 스피드모터스주식회사, (주)하이로지텍, 하이웨이스타(주), (주)하이 닉스엔지니어링
금융(1)	SK증권(주)	-
기타(7)	SKC솔믹스(주), (주)유비케어	SK바이오팜(주), SK와이번스(주), 그린바이오(주), 제주유나이티드FC(주), (주) 하이닉스인재개발원

(*) 사명 변경 : 코원에너지서비스(주) (舊 대한도시가스(주)), 울산아로마틱스(주) (舊 아로케미(주)), 행복나래주식회사 (舊 엠알
오코리아(주))

사. 신용평가에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 당사의 신용등급은 다음과 같습니다.

구분	평가기관	현등급	최종평가일
국내	한신정평가	A	2012.02.16
	한국기업평가	A	2012.02.17
	한국신용평가	A	2012.02.17
해외	Moody's	Ba3	2012.02.15
	S&P	BB-	2012.02.14

최근 3개 사업연도 신용등급과 관련한 상세 내역 및 각 등급에 따른 정의는 본 보고서 'II. 11. 나. 최근 3년간 신용등급'을 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 중요한 변동상황

(1) 회사의 주된 변동내용

- 1949. 10 국도건설 주식회사 설립
- 1983. 02 현대전자산업주식회사로 상호 변경
- 1996. 12 기업공개 및 상장
- 1997. 03 대표이사 김영환 외 이사 5인 변경 선임
이사 5인, 감사 1인 변경 선임
- 1999. 05 LG그룹과 LG반도체 주식 양수도 계약 체결
- 1999. 07 LG반도체 대주주 지분 인수
- 1999. 10 현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병
- 2000. 03 박종섭 대표이사 외 이사 1인, 감사위원 2인 변경 선임
- 2000. 05 전장사업부문 (주)현대오토넷으로 분사
- 2000. 08 모니터사업부문 "현대이미지퀘스트(주)"로 분사
- 2001. 03 주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경
박상호 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
- 2001. 05 통신단말기 사업부문 "현대큐리텔"로 분사
통신 ADSL 사업부문 "현대네트웍스"로 분사
- 2001. 07 통신 네트워크 사업부문 "현대시스콤"으로 분사
- 2001. 08 현대그룹으로부터 계열분리
- 2001. 10 채권금융기관 공동관리 시작
- 2001. 12 현대큐리텔, '팬택 컨소시엄'에 지분 매각
- 2002. 01 현대시스콤, '쓰리알'에 지분 매각
- 2002. 05 시러스 로직社와 파운드리 전략적 장기공급 계약체결
박종섭 대표이사 사임
- 2002. 06 최대주주 변경(현대상선(주) → (주)한국외환은행)
- 2002. 07 우의제 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
- 2002. 12 현대네트웍스, '엠비엔'에 지분 매각
- 2003. 02 박상호 대표이사 사임
- 2003. 04 STMicro社와 낸드플래시 메모리 공동 개발 및 파운드리 공급 계약 체결
- 2003. 06 환경/안전/보건 기술연구소 설립

- 2004. 06 매그나칩반도체 유한회사와 비메모리 사업부문 영업양도계약 체결
- 2004. 08 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시와 중국 현지공장설립 협력계약 체결
- 2004. 10 비메모리 사업부문 영업양도
- 2004. 11 STMicro社와 중국 현지 합작공장설립을 위한 협력계약 체결
- 2005. 03 황학중, 김덕수, 민형욱, 이준호 사외이사 선임
박시룡, 장윤중 사외이사 임기만료 퇴임
- 2005. 07 채권금융기관 공동관리 조기종료
현대이미지퀘스트(주), (주)빅터스캐피탈코리아에 지분 매각
- 2005. 10 (주)현대오토넷 지분매각 완료
출자전환주식 공동관리협의회 1차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)
- 2006. 03 권오철 이사, 손방길 사외이사 선임, 정형량 이사 임기만료 퇴임
- 2006. 04 중국 현지생산법인(HSMC) 설립
- 2006. 06 출자전환주식 공동관리협의회 2차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)
- 2006. 09 300mm 연구소(R3 R&D Fab) 개소
- 2007. 03 김종갑 대표이사 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 4인 포함) 선임
- 이사 선임: 김종갑, 최진석
- 사외이사 선임: 박종선, 김경한, 조동성, 김형준
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 황학중, 민형욱, 손방길, 손성호
우의제 대표이사 임기만료 퇴임
이사 1인(오춘식), 사외이사 4인(김범만, 김수창, 이선, 이준호) 임기만료 퇴임
- 2007. 04 청주 신규 M11(300mm) 공장 착공
- 2007. 07 공정거래 자율준수프로그램 도입
- 2007. 10 환경운동연합과 '환경경영검증위원회' 협약 체결
- 2007. 11 '일하는 이사회'를 위한 신(新)이사회 제도 도입
- 2008. 02 김경한 사외이사 중도 퇴임
- 2008. 03 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
- 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 정홍원, 최장봉
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈
사외이사 3인(황학중, 민형욱, 손방길) 임기만료 퇴임
- 2008. 06 정홍원 사외이사 중도 퇴임
- 2009. 03 권오철 이사 재선임 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
- 이사 선임: 권오철, 박성욱
- 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 최장봉, 한부환
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈
- 2009. 11 중국 후공정 합작사 HITECH 설립
- 2010. 03 최대주주 변경((주)한국외환은행 → 한국정책금융공사)
최대주주 변경(한국정책금융공사 → 미래에셋자산운용투자자문(주))

권오철 대표이사외 이사 1인 신규 선임, 김종갑 이사 재선임
사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임

- 이사 선임: 김종갑, 권오철, 김민철
- 사외이사 선임: 박종선, 전인백, 한부환, 최장봉, 정병태, 김형준
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 김창호

2010. 06 중국 후공정 합작공장 HITECH 준공

2010. 08 최대주주 변경(미래에셋자산운용투자자문(주) → 한국정책금융공사)

2010. 10 최대주주 변경(한국정책금융공사 → 국민연금공단)

2011. 03 사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임

- 사외이사 선임: 한부환, 전인백, 정병태, 이달곤, 김갑희, 정상환
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 조현명

2011. 09 정상환 사외이사 중도 퇴임

2012. 02 최대주주 변경(국민연금공단 → 에스케이텔레콤(주))

사외이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임

- 이사 선임: 최태원, 하성민, 박성욱
- 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 윤세리, 김대일, 이창양
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양

(2) 주요종속회사의 주된 변동내용

- 1983. 03 미국 현지법인(HSA) 설립
- 1989. 03 독일 현지법인(HSD) 설립
- 1991. 08 싱가포르 현지법인(HSS) 설립
- 1995. 04 홍콩 현지법인(HSH) 설립
- 1995. 07 영국 현지법인(HSE) 설립
영국 현지판매법인(HSU) 설립
- 1995. 08 미국 생산법인(HSMA) 설립
- 1996. 07 대만 현지법인(HST) 설립
- 1996. 09 일본 현지법인(HSJ) 설립
- 2001. 05 사업지원 서비스부문 "(주)현대아스텍" 분사
- 2001. 07 LCD 사업부문 "(주)현대디스플레이테크놀로지"로 분사
- 2001. 08 중국 현지판매법인(HSCS) 설립
- 2001. 12 "에스알씨(주)" 분사
- 2002. 11 "(주)현대디스플레이테크놀로지" TFT-LCD 사업부문 매각
- 2005. 04 중국 합작법인(HSSL) 설립
에스알씨(주)→(주)큐알티반도체 사명 변경
(주)현대아스텍→(주)아스텍 사명 변경

- 2006. 04 중국 현지생산법인(HSMC) 설립
- 2006. 10 중국 현지생산법인(HSMC) 준공
- 2007. 01 인도 현지법인(HSIS) 설립
- 2008. 03 (주)아스텍에서 (주)하이닉스인재개발원 분할
(주)아스텍에서 (주)하이시텍으로 분할
(주)아스텍에서 (주)하이로지텍으로 분할
(주)아스텍에서 (주)하이닉스엔지니어링으로 분할
- 2010. 01 (주)하이닉스엔지니어링에서 (주)아미파워로 분할
- 2010. 08 중국 현지판매법인(HSCW) 설립
- 2011. 09 "(주)현대디스플레이테크놀로지" 청산, 주요종속회사 제외
"프로모스엔에이치유한회사, 티와이프로주식회사, 외환은행특정금전신탁" 청산, 주요종속회사 제외

나. 상호의 변경

- 1983. 02 현대전자산업주식회사로 상호 변경
- 2001. 03 주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경
- 2012. 03 에스케이하이닉스 주식회사로 상호 변경

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환 · 이전, 중요한 영업의 양수 · 도 등

- 1999. 10 현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병
- 2004. 10 비메모리 사업부문 영업양도
- 2011. 11 에스케이텔레콤, 하이닉스반도체 지분인수계약

라. 생산설비의 변동

- 2006. 10 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 C2(300mm), C1(200mm)공장 준공
- 2008. 07 미국 유진 공장 E1(200mm) 가동 중단
- 2008. 08 청주 신규 낸드플래시 전용 M11공장(300mm) 준공
- 2008. 09 이천 M7(200mm) 및 청주 M9(200mm) 공장 가동 중단
- 2008. 12 중국 C1(200mm) 공장 가동 중단
- 2010. 06 중국 후공정 합작공장 HITECH 준공

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 2005. 01 전력 소모 30% 줄인 서버용 메모리 모듈 개발
- 2005. 01 대만 프로모스社와 전략적 제휴를 위한 본계약 체결

- 2005. 07 2GB DDR2-667 노트북용 모듈 업계 최초 인텔사 인증 획득
- 2005. 07 당사 출자전환 주식 공동관리 협의회와 '특별 약정' 체결
- 2005. 11 JEDEC 표준형 8GB DDR2 R-DIMM과 2GB DDR VLP R-DIMM 개발
- 2005. 12 512Mb GDDR4 DRAM 개발
- 2006. 03 80나노 512Mb DDR2 DRAM 인텔사 인증 획득
- 2006. 12 200Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발
60나노급 1Gb DDR2 기반 1GB DDR2 800Mbps 모듈 개발
- 2007. 03 ECC회로 적용한 185Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발
- 2007. 04 퓨전메모리 제품 DOC(Disk On Chip) H3 양산
- 2007. 05 80나노 DDR3 1Gb DRAM 단품 및 모듈 인텔사 인증 획득
초박형(25 μ m) 20단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package) 개발
- 2007. 08 200Mbps 1Gb 모바일 DRAM 개발
이노베이티브 실리콘사와 신개념 메모리 'ZRAM' 라이선스계약 체결
- 2007. 09 초박형(25 μ m) 24단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package)개발
- 2007. 10 오보닉스사와 차세대 메모리 'PRAM' 기술 라이선스 계약 체결
- 2007. 11 1Gb GDDR5 개발
50나노급 1Gb DDR2 DRAM 인텔사 인증 획득
실리콘화일사와 CMOS 이미지 센서(CIS) 사업 추진을 위한 협력 계약 체결
- 2008. 01 50나노급 1GB/2GB DDR2 모듈 인텔사 인증 획득
- 2008. 03 피델릭스사와 전략적 제휴를 위한 협력계약 체결
- 2008. 04 그란디스사와 'STT-RAM' 라이선스 및 공동개발계약 체결
- 2008. 05 프로모스사와 포괄적 제휴 협력 계약 체결
- 2008. 06 파이슨사와 낸드플래시 응용제품 기술에 대한 사업협력계약 체결
실리콘화일사 지분취득 결정 및 기존 파운드리 계약범위 확대
3중셀(X3) 기술 기반 32Gb 낸드플래시 개발
- 2008. 07 씨엔에스테크놀로지사와 시스템반도체 공동개발 및 파운드리 협력계약 체결
- 2008. 08 뉴모닉스사와 낸드플래시 기술 및 제품 공동 개발 협력계약 체결
16GB 서버용 모듈 개발
- 2008. 12 8단 적층 낸드플래시 개발
50나노급 2Gb 고용량 모바일 DRAM 개발
- 2009. 01 DDR3 서버용 모듈 4GB ECC UDIMM 인텔사 인증 획득
- 2009. 02 40나노급 DDR3 DRAM 개발
- 2009. 05 뉴모닉스사 및 파이슨사와 낸드플래시 응용제품용 컨트롤러 3자 공동개발 계약 체결
중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 무석산업발전집단유한공사와 합작 반도체 후공정 전문회사 설립을 위한 본계약 체결
- 2009. 06 4GB 1333Mbps 노트북용 모듈 외 10건 인텔사 DDR3 전용 플랫폼 인증획득
- 2009. 07 대만 프로모스사와 전략적 제휴 협력계약 종결

- 2009. 08 50나노급 4Gb 모바일 DRAM 인텔社 인증 획득
- 2009. 10 2세대 1Gb DDR3 개발
- 2009. 12 40나노급 2Gb GDDR5 개발
- 2010. 01 40나노급 2Gb 모바일 DRAM 개발
- 2010. 02 20나노급 64Gb 낸드플래시 개발
- 2010. 09 휴렛팩커드(HP)社와 Re램 공동개발 계약 체결
- 2010. 12 30나노급 4Gb DDR3 개발
- 2011. 03 30나노급 2Gb DDR4 개발
- 2011. 07 도시바社와 STT-MRAM 공동개발 및 합작사 설립을 위한 공동생산 계약 체결
- 2012. 03 30나노급 2Gb DDR3 저탄소제품 인증 획득
- 2012. 04 스펀션社와 특허사용 크로스라이선스 및 SLC낸드플래시 공급계약 체결

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2012년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2008년 01월 23일	주식매수선택 권행사	보통주	45,200	5,000	5,000	
2008년 07월 16일	-	보통주	328,962	5,000	5,000	우리사주매수선택 권행사
2009년 01월 17일	유상증자(일 반공모)	보통주	60,000,000	5,000	5,400	
2009년 02월 18일	주식매수선택 권행사	보통주	18,260	5,000	5,000	
2009년 05월 06일	전환권행사	보통주	12	5,000	24,184	
2009년 05월 19일	유상증자(일 반공모)	보통주	70,000,000	5,000	10,350	
2009년 06월 23일	주식매수선택 권행사	보통주	4,600	5,000	5,000	
2009년 08월 13일	전환권행사	보통주	8,731	5,000	23,328	2009.08.13~ 2009.09.21

2009년 09월 22일	주식매수선택 권행사	보통주	3,740	5,000	5,000	
2009년 12월 14일	전환권행사	보통주	428	5,000	23,328	
2010년 01월 04일	전환권행사	보통주	28,608	5,000	23,328	2010.01.04~2 010.03.22
2010년 04월 01일	전환권행사	보통주	565,120	5,000	23,328	2010.04.01~2 010.06.25
2010년 07월 08일	전환권행사	보통주	44,150	5,000	23,328	2010.07.08~2 010.09.01
2010년 10월 29일	전환권행사	보통주	115	5,000	23,328	2010.10.29~2 010.11.16
2011년 01월 13일	전환권행사	보통주	434,385	5,000	23,328	2011.01.13~2 011.03.25
2011년 04월 01일	전환권행사	보통주	1,460,643	5,000	23,328	2011.04.01~2 011.06.10
2012년 01월 27일	전환권행사	보통주	855	5,000	23,328	2012.01.27~2 012.02.13
2012년 02월 14일	유상증자(제 3자배정)	보통주	101,850,000	5,000	23,000	
2012.02.15	전환권행사	보통주	3,065	5,000	23,328	2012.02.15~2 012.03.30
2012년 02월 23일	전환권행사	보통주	1,094	5,000	23,328	2012.02.23~2 012.03.30

결산기 이후 발생한 증자(감자) 현황은 다음과 같습니다.

[제출일 현재]

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	
2012년 04월 06일	전환권행사	보통주	3,000	5,000	23,328	
2012년 05월 02일	-	보통주	93,500	5,000	22,800	우리사주매수선택 권행사
2012년 05월 04일	전환권행사	보통주	428	5,000	23,328	

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2012.03.31)

(단위 : 원, 주)

종류 \ 구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상 주식의 종류	전환청구가 능기간	전환조건		미상환사채		비고
						전환비율 (%)	전환가액	권면총액	전환가능주 식수	
제6회 해외 공모 무보증 전환사채	2007년 12월 14일	2012년 12월 14일	US\$583,400,000	보통주	2008.12.1 5~ 2012.11.2 9	100	35,862	US\$35,700,000	915,745	-
제207회 국내 공모 무보증 전환사채	2008년 09월 05일	2013년 09월 05일	500,000,000,000	보통주	2008.10.0 5~ 2013.08.0 5	100	23,328	440,649,570,000	18,889,299	-
제7회 해외 공모 무보증 전환사채	2010년 05월 14일	2015년 05월 14일	US\$500,000,000	보통주	2011.05.1 5~ 2015.04.2 8	100	34,394	US\$500,000,000	16,482,526	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	36,287,570	-

※ 상기 '권면총액'은 최초발행시의 권면총액이며, '미상환사채의 권면총액'은 기준일 현재의 잔액 기준입니다

(기준일 : 제출일 현재)

(단위 : 원, 주)

종류 \ 구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상 주식의 종류	전환청구가 능기간	전환조건		미상환사채		비고
						전환비율 (%)	전환가액	권면총액	전환가능주 식수	
제6회 해외 공모 무보증 전환사채	2007년 12월 14일	2012년 12월 14일	US\$583,400,000	보통주	2008.12.1 5~ 2012.11.2 9	100	35,862	US\$35,700,000	915,745	-
제207회 국내 공모 무보증 전환사채	2008년 09월 05일	2013년 09월 05일	500,000,000,000	보통주	2008.10.0 5~ 2013.08.0 5	100	23,328	440,569,570,000	18,885,870	-
제7회 해외 공모 무보증 전환사채	2010년 05월 14일	2015년 05월 14일	US\$500,000,000	보통주	2011.05.1 5~ 2015.04.2 8	100	34,394	US\$500,000,000	16,482,526	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	36,284,141	-

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2012년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 9,000,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,688,003,346주입니다. 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다. 당기말 현재의 유통주식수는 보통주 694,025,502주 입니다.

(기준일 : 2012년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류			비고
	보통주	우선주	합계	
I. 발행할 주식의 총수	9,000,000,000	-	9,000,000,000	-
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,688,003,346	-	5,688,003,346	-
III. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,993,977,844	-	4,993,977,844	-
1. 감자	4,990,449,799	-	4,990,449,799	2003.03.31, 주식병합 (21:1)
2. 이익소각	3,528,045	-	3,528,045	2000.03.31, 이익소각
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)	694,025,502	-	694,025,502	-
V. 자기주식수	-	-	-	-
VI. 유통주식수 (IV-V)	694,025,502	-	694,025,502	-

결산일 이후 제207회 국내 전환사채의 전환권 행사로 3,428주가 발행되었으며, 우리사주 매수선택권 행사로 93,500주가 발행되어 제출일 현재의 발행주식총수는 보통주5,688,100,274주이며, 유통주식수는 694,122,430주입니다.

[제출일 현재]

구 분	주식의 종류			비고
	보통주	우선주	합계	
I. 발행할 주식의 총수	9,000,000,000	-	9,000,000,000	-
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,688,100,274	-	5,688,100,274	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,993,977,844	-	4,993,977,844	-
1. 감자	4,990,449,799	-	4,990,449,799	2003.03.31, 주식병합 (21:1)
2. 이익소각	3,528,045	-	3,528,045	2000.03.31, 이익소각
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	694,122,430	-	694,122,430	-
Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	694,122,430	-	694,122,430	-

나. 자본금 및 1주당가액

[2012. 03. 31 현재]

(단위 : 천원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)			1주당가액			비고
		재무제표상 자본금 (A)	발행주식의 액면총액 ('가'의 IV×B)	유통주식의 액면총액 ('가'의 VI×B)	1주당 액면가액 (B)	자본금÷ 발행주식의 총수 (A÷'가'의 IV)	자본금÷ 유통주식수 (A÷'가'의 VI)	
기명식	보통주	3,487,767,735	3,487,767,735	3,487,767,735	5	5.03	5.03	-
합	계	3,487,767,735	3,487,767,735	3,487,767,735	5	5.03	5.03	-

[제출일 현재]

(단위 : 천원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)			1주당가액			비고
		재무제표상 자본금 (A)	발행주식의 액면총액 ('가'의 IV×B)	유통주식의 액면총액 ('가'의 VI×B)	1주당 액면가액 (B)	자본금÷ 발행주식의 총수 (A÷'가'의 IV)	자본금÷ 유통주식수 (A÷'가'의 VI)	
기명식	보통주	3,488,252,375	3,488,252,375	3,488,252,375	5	5.03	5.03	-
합	계	3,488,252,375	3,488,252,375	3,488,252,375	5	5.03	5.03	-

다. 이익소각 현황

당사는 주주에게 배당할 이익으로서 주식을 소각할 수 있는 바, 2000년 3월 31일자로 3,528,045주를 이익소각한 바 있습니다.

5. 의결권 현황

(기준일 : 2012년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	694,025,502	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	694,025,502	-
	우선주	-	-

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다.

(1) 제52조(이익배당)

- ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당 할 수 있다.

(2) 제54조(중간배당)

- ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.
- ③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당,

전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

- ④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
- ⑤ 제53조(배당금 지급청구권의 소멸시효)는 중간배당의 경우에 준용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제65기 1분기	제64기	제63기
주당액면가액 (원)		5,000	5,000	5,000
당기순이익 (백만원)		-271,223	-55,971	2,597,575
주당순이익 (원)		-420	-96	4,440
현금배당금총액 (백만원)		-	-	88,541
주식배당금총액 (백만원)		-	-	-
현금배당성향 (%)		-	-	0.64
현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	150
	우선주	-	-	-
주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야는 매우 광범위 합니다. WSTS(World Semiconductor Trade Statistics, 2012년 2월)에 따르면, 지난 2011년도 세계 반도체 시장규모는 US\$2,995억에 이르렀으며, 이중 메모리 제품은 US\$607억의 시장규모를 기록하며 전체 반도체 시장의 약20% 수준에 달하였습니다. 메모리 반도체 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 DRAM은 지난 2011년 US\$294억을 기록하며 전체 메모리 시장의 약 48%를 차지하였고, 그 뒤를 이어 낸드플래시가 US\$244억으로 40%, 노어플래시가 US\$38억으로 6%를 차지하였습니다.

아울러 아래 표에 나타난 바와 같이 반도체 산업은 우리 나라 산업 생산 및 수출에 있어서 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 특히, 2011년에는 세계 경기 침체로 인한 반도체 시장 성장 둔화와 메모리 반도체의 판가 하락으로 반도체 수출이 전년 대비 1.1% 감소하였으나, 우리나라 전체 수출액 중 반도체의 비중은 9.1%로 중요 수출품의 자리를 차지하고 있습니다.

※ 전체 수출중 반도체 비중

(단위: 백만USD, %)

구분	2011	2010	2009	2008	2007
총수출	556,514	466,384	363,534	422,007	371,489
반도체	50,881	51,464	31,918	32,792	39,046
전년비 증감율	-1.1	61.2	-2.7	-16.0	4.5
비중	9.1	11.0	8.8	7.8	10.5

출처 : 관세청, 2012

특히, 반도체 수출의 대부분은 메모리 반도체 산업을 통해 이룬 것으로, 메모리 반도체는 우리나라 최대의 수출 산업입니다. 이러한 메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.

반도체 제품을 직접 설계하고 제조, 판매까지 하는 업체들을 가리켜 IDM이라고 하는데 이들은 자체 디자인 능력, 제조 노하우(know-how) 및 생산 설비 등을 바탕으로 비IDM(non-IDM) 업체들에 비해 독자적 기술개발력과 제조 경쟁력을 확보함으로써 산업 내에서의 위치를 더욱 확고히 하고 있습니다. (DRAM 상위 4개 업체의 시장 점유율: 1990년 49% →2011년 89%, 출처: 가트너, 매출액 기준)

가) 메모리 반도체

정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시메모리를 생산하고 있습니다.

[DRAM(Dynamic Random Access Memory)]

DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory)로 사용되고 있으며, 가전 제품의 디지털화에 따라 디지털TV, 스마트 TV, DVD 플레이어 그리고 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다. 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿 PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있습니다.

[플래시메모리(Flash Memory)]

플래시메모리는 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code저장형)과 낸드(NAND)형(Data저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이중 당사가 생산하는 낸드 플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 영상과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다.

낸드 플래시 제품이 주로 적용되는 분야는 스마트폰, 태블릿 PC 같은 모바일 기기와 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 네비게이션, SSD(Solid State Drive)등입니다. 플래시메모리 사업은 DRAM 공정의 활용이 가능하므로 DRAM 팹(FAB) 보유업체들에게는 신규투자를 최소화하여 수익성을 높이고 DRAM 사업 변동성을 다소 보완할 수 있는 장점이 있습니다. 한편, 최근 플래시메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품개발 및 철저한 고객대응 필요성이 커지고 있습니다.

나) 비메모리 반도체

[CIS(CMOS Image Sensor)]

논리적 연산 등 정보처리기능을 담당하는 비메모리 반도체 중에서도, 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지 센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 두 가지 타입으로 나뉩니다. 최근 CIS의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영기가 소형화됨에 따라, 크기가 작고 전력 소모가 적은 CIS의 활용 범위가 점차 확대되고 있으며, 디지털 일안 반사식 카메라와 캠코더 등 고화질을 요구하는 고가 제품에도 많이 사용되는 추세입니다. 이에 따라 CIS 시장에서는 기술 경쟁력과 원가 경쟁력이 점차 중요한 성공 요인으로 부각되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

메모리 반도체 산업은 2007년 이후 공급 과잉에 따른 판매 가격의 급격한 하락과 2008년 미국 신용위기에 따른 세계 경제 침체의 영향으로 2009년까지 다소 저조한 성장세를 보이기도 하였지만, 2010년 이후 새로운 IT 기기의 등장과 디지털 기기의 모바일화, 스마트화로 DRAM 수요는 PC에서 모바일 영역으로, NAND 수요는 모바일에서 PC영역으로 확대됨에 따라 향후 지속적인 성장에 예상됩니다. 하지만 공정 미세화의 기술은 한계에 다다르고 있으며, 생산 및 연구 개발을 위한 투자 비용은 급증하고 고객들의 요구 성능과 품질 수준은 점점 더 다양화, 고도화 되고 있어 선두업체와 후발업체와의 기술 및 원가경쟁력 격차가 점차 확대됨과 동시에 공급은 제한적인 성장을 보일 것으로 예상되기 때문에 선두업체를 중심으로 메모리 신성장의 기회가 더욱 증대할 것으로

로 예상됩니다.

[DRAM]

시장 조사기관인 아이서플라이(iSuppli, 2012년 3월, 금액기준)에 따르면, DRAM 시장은 2009년 US\$227억에서 2010년 US\$397억으로 75%의 고성장을 이뤘으며, 2011년은 2010년 보다 축소된 US\$296억의 매출을 기록하였습니다. 분야별로 살펴 보면, 개인용 컴퓨터와 업그레이드용 메모리 모듈이 지속적으로 주요 수요처가 될 전망이나, 성장 속도는 다소 둔화될 것으로 보이며, 개인용 컴퓨터의 이동성(Mobility)에 대한 요구가 증가함에 따라 노트북 컴퓨터로의 교체 및 신규 수요가 확대될 전망입니다. 이에 개인용 컴퓨터 중 넷북을 포함한 노트북의 출하 비중이 2011년 60%에서 2016년 69%로 증가할 것으로 업계는 예상하고 있습니다. 또한 디지털 기기의 스마트화 및 모바일화의 진전에 따라 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 기기 시장이 급성장하고 있으며, 대용량의 콘텐츠를 처리할 수 있는 그래픽 메모리의 수요 또한 증가할 전망입니다. 이에 따라 DRAM 수량 확대뿐만 아니라 개별 기기의 탑재용량도 지속 증가할 것으로 예상됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 디지털 미디어의 성장과 더불어 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털 카메라, MP3 플레이어, 휴대폰, 위성위치추적장치(GPS) 그리고 기타 멀티미디어 가전에 사용되는 플래시카드와 USB 드라이브 같은 휴대용 정보 저장장치(Removable Storage Devices)등에 널리 사용되고 있습니다.

아이서플라이(iSuppli, 2012년 3월, 금액기준)의 전망에 따르면 낸드플래시 시장은 2010년 38%의 성장을 기록하였으며, 2011년에는 글로벌 경기 침체에도 불구하고 약 7% 정도의 성장세를 이어가고 있습니다. 2012년에도 8%대의 성장이 예상되는 등 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 특히 스마트폰을 포함한 휴대전화 시장에서의 메모리 탑재용량 증가와 SSD 및 응용복합 제품 등은 향후 지속적으로 성장하면서 낸드플래시의 수요를 견인할 것으로 전망됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지 센서는 1990년대 중반 디지털 카메라에 장착되어 일반 소비자에게 선보인 이후 PC 카메라, 휴대폰, PDA, 감시카메라 등 다양한 제품에 활용되는 등 수요 증가에 힘입어 시장 규모도 크게 증가하는 추세입니다. 특히 DSLR 카메라 및 휴대폰 카메라 시장의 수요 증가로 시장이 지속 성장할 것으로 보입니다. 아이서플라이(iSuppli, 2012년 3월, 금액기준)의 전망에 따르면 이미지 센서 시장은 2016년 US\$124억 규모로 2011년 이래 연평균 4.4%의 성장이 예상되며, 특히 당사가 생산중인 CIS 시장은 다양한 응용기기로의 확대 적용과 수요 증가로 전체 이미지 센서 시장에서의 비중이 2011년 72%에서 2016년 91%까지 증가하며 연평균 9.5%의 높은 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 지금까지 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며 제품 수명주기가 매우 짧은 특징을 가지고 있습니다. 아울러 대규모 장치 산업의 특성을 가짐과 동시에 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 비교적 크게 나타났으나, 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 일부 경쟁력이 부족한 업체들의 구조조정 등으로 인해 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었다고 볼 수 있습니다.

[DRAM]

DRAM은 과거에 PC 수요에 상당부분 의존하고 있어 세계 IT 경기 사이클의 영향을 크게 받아 왔습니다. 최근에는 선진 시장에서의 Windows7 안착에 따른 PC 교체 및 기업의 노후PC 교체 수요, 신흥 시장에서의 신규 수요가 DRAM 수요 증가에 영향을 끼치고 있습니다. 또한 스마트폰 및 태블릿 PC 등 신규 모바일 기기의 폭발적인 시장 성장에 따라 전통적인 PC 시장에서뿐만 아니라 모바일 시장에서의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 한편, 수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 및 중국 춘절 등의 수요 증가

로 인한 매출액 증가를 들 수 있습니다. 하지만 최근에는 아시아 시장의 성장에 따른 판매시장의 다변화로 이 같은 전통적인 수요의 계절성이 약화되는 모습도 나타나고 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 시장 초기에 MP3 플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속히 성장을 하였으며, 또한 주요 공급업체들이 DRAM을 함께 생산하고 있어 DRAM 시장의 안정적 성장에도 우호적인 여건을 제공해 왔습니다. 하지만 낸드플래시의 주 수요처인 MP3 플레이어, 메모리 카드 등이 경기에 민감한 소비재 제품이기 때문에 DRAM과 마찬가지로 세계 경제 상황에 따라 경기가 함께 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 IT 기기들의 스마트화가 진행되면서 낸드플래시의 주 수요처가 스마트폰, 태블릿PC와 같은 모바일기기로 확대되었습니다. 향후 고용량 낸드플래시를 탑재하는 스마트폰 및 태블릿 PC 시장이 지속적으로 성장하고 노트북 및 서버의 SSD 채용이 본격화됨에 따라 2012년 이후 낸드플래시 시장은 세계 경기 회복과 더불어 지속적으로 성장할 것으로 보입니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지 센서 중 자사가 생산중인 CIS는 모바일 핸드셋, 캠코더, PC 등 멀티미디어 기기 시장의 영향을 크게 받는 제품으로서 소비재의 특성상 경기변동과 기술변화에 매우 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다. 따라서 가격경쟁력을 지닌 제품을 적시에 출시하여 시장을 선점하는 것이 사업 성공 여부에 매우 중요한 요소라 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1. 인적자원(R&D 및 엔지니어링), 2. 기술 및 원가 경쟁력, 3. 고객확보 능력 4. 설비투자 능력 등이 있습니다. 최근 대량생산이 용이한 표준제품 위주에서 응용분야가 점차 다양화, 융복합화함에 따라 시설투자와 생산성 향상을 통한 원가경쟁력 중심에서 제품 가치 증대를 통한 수익성 중심으로 경쟁의 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다. 지금까지 생산능력 확대와 생산원가 절감이 주요 경쟁 목표였던 시기에는 제조/공정기술, 대규모 설비투자, 규모의 경제 등이 중요한 사업 성공 요인이었지만, 공정 미세화의 난이도 증가와 투자의 불확실성 증대 등 사업환경이 변화함에 따라 앞으로는 제품 경쟁력과 부가가치 증대를 위해 선행기술 및 응용기술 개발, 마케팅 및 고객 만족 등이 더욱 중요한사업 경쟁력이 되고 있습니다.

이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난 2012년 1분기는 매출 감소와 일회성 비용의 증가 등으로 전 분기 대비 영업적자 규모가 소폭 증가하였으나, 격려금 등 일회성 비용을 제외할 경우 전 분기와 비슷한 수준의 영업실적을 유지하였습니다. 당사의 연결기준 매출은 전 분기 대비 약 6% 감소한 2조 3천 8백 8십억원을 기록하였으며, 연결기준 영업이익은 전 분기 대비 약 55% 감소한 2천 6백억원의 손실을 기록하였습니다. 또한 이자비용 및 영업외비용 발생으로 약 2천 7백 1십억원의 당기순손실을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제65기 1분기 (2012.01.01~ 2012.03.31)	제64기 4분기 (2011.10.01~ 2011.12.31)	전기 대비 증감	제64기 1분기 (2011.01.01~ 2011.03.31)	전년동기 대비증감
매출액	2,388,389	2,553,159	-6.5%	2,793,185	-14.5%
영업이익	-259,981	-167,485	-55.2%	322,829	적자전환
당기순이익	-271,223	-239,888	-13.1%	273,540	적자전환

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[제64기]

(단위: 백만원)

구 분	매출액	매출액 비중 (%)	주요 제품
반도체 부문	2,388,389	100.0%	DRAM, 낸드플래시, MCP 등
합계	2,388,389	100.0%	

※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 및 기타 전자부품 제조업(분류번호: 321)'에 해당하며, 반도체부문의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 반도체부문으로 기재함.

(2) 시장점유율 등

구 분	'11년	'10년	'09년	'08년	'07년	비 고
DRAM	22.8%	21.8%	22.9%	19.2%	21.3%	IDC 매출액 기준
낸드플래시	11.7%	9.5%	8.4%	12.6%	16.0%	

(3) 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

(가) 메모리반도체 사업

[DRAM]

메인 메모리(Main Memory) 사업의 경우 범용적인 특성이 강한 데스크탑(Desktop)용 제품 비중은 점차 낮아지고 있으며, 가격이 높고 품질의 신뢰성이 바탕이 되어야 하는 고용량(High Density) 서버용 제품 비중과 이동성 확대에 따른 노트북(Notebook)용 제품의 비중이 확대되고 있습니다. 태국의 홍수사태와 글로벌 경제 위기로 2011년 PC시장은 2% 성장하였으나, 2012년에는 수요 회복과 더불어 울트라북, Windows8의 출시로 5%의 성장이 예상됩니다(출처: IDC).

서버의 경우 최근 스마트기기와 SNS 등의 등장으로 인한 IT 자원의 증가에 따라 고용량 서버 수요가 지속 증가하고 있습니다. 새로운 기술 트렌드인 빅데이터(Big Data) 처리와 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) 서비스 제공을 위한 데이터 센터(Data Center)의 수요 역시 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 당사는 다양한 고용량, 저전력 서버용 모듈 제품군을 갖추고 인텔 및 AMD의 서버 어플리케이션(Server Application) 등에 적합한 고성능 서버 메모리 시장을 선도하고 있습니다.

그래픽 메모리(Graphics Memory)는 동영상 및 3D 그래픽 기술의 발전과 함께 꾸준한 성장세를 보이고있습니다. 당사는 주요 그래픽 칩셋 업체들과의 전략적 관계강화를 통하여 데스크탑, 노트북용 등 PC 그래픽 및 기존 게임 외에 의료, 교육, 네트워크 커뮤니케이션 등 분야로 활용 영역을 넓히고 있는 차세대 게임콘솔 분야에서도 주도적인 위치를 공고히 하고 있습니다.

컨수머 메모리(Consumer Memory) 시장은 디지털TV, 디지털 셋톱박스(Set-top Box), 블루레이 플레이어(Blu-ray player)등의 디지털 영상 가전제품과 프린터 등 PC주변기기 및 자동차용 네비게이션 제품등에 다양하게 사용됩니다. 또 당사는 클라우드 컴퓨팅 확대에 따른 네트워크 인프라 장비에 맞는 고용량, 고속의 첨단 컨수머 메모리를 개발하여 경쟁력 있는 제품을 시장에 공급하고 있으며, 고온 및 저온에도 견딜 수 있는 극한 환경에 특성화된 IT(Industrial Temperature)와 AT(Automotive Temperature) 제품을 개발, 공급하는 등 고객의 다양한 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다.

모바일 메모리(Mobile Memory)는 스마트폰, 태블릿 PC, 휴대전화, 디지털 카메라, MP3 플레이어 등의 다양한 수요처가 있으며 라이프 스타일 변화에 따른 IT 수요 증가와 정보통신 융합(Convergence)의 가속화로 현재 가장 성장성이 높은 제품입니다. 이 중에서도 대용량 메모리를 필요로 하는 스마트폰 및 태블릿 PC의 보급확대는 향후에도 모바일 메모리 제품의 수요를 강하게 견인할 것으로 예상됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 데이터 저장 용도로 쓰이는 대표적인 메모리 반도체로서, 빠른 테크놀로지의 진화로 매년 높은 성장률을 기록하였습니다. 낸드플래시 시장이 이렇게 성장을 지속하는 이유는 최첨단 IT기기 및 다양한 소비자 가전에서 낸드플래시 채용률이 지속적으로 높아지고 있기 때문입니다.

과거에는 플래시카드, USB 드라이브, MP3 플레이어, PMP 등이 낸드플래시 메모리의 주요 수요처였으나, 최근에는 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 분야에서 멀티 미디어 기능의 확대로 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 스마트TV, 스마트카 등의 신 개념 도입으로 인하여 과거에 저용량의 낸드플래시 메모리만 사용했던 이들 시장에서도 고용량 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 최근에는 SSD와 같은 낸드플래시를 기반으로 한 다양한 형태의 PC Storage Solution이 노트북은 물론이고 서버 시장에서도 주요 제품군으로 자리잡고 있어, 향후 낸드플래시 메모리시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 것으로 전망되고 있습니다.

이와 같은 낸드플래시 시장에서 당사는 저용량부터 고용량까지 다양한 단품 및 응용 복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 개발 및 양산 측면에서도 응용분야별 선택과 집중을 통하여 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장 지배력을 높여 가고 있습니다. 또한 적극적 연구 개발 투자 및 제휴사와의 기술 협력을 통해 선두업체와의 기술 격차를 단축해 나가고 있습니다. 특히, 2012년 1분기에 20나노급 64Gb 제품 개발을 완료하여 올해 2분기부터 본격적인 양산에 들어갈 예정이며, 향후에도 지속적으로 미세공정 전환에 집중할 계획입니다.

(나) 비메모리반도체 사업

회사는 지난 2007년 11월, 제품 포트폴리오를 더욱 다양화하고, 기존 메모리 사업 역량을 활용하여 안정적인 수익성과 높은 투자효율성이 기대되는 CIS 사업에 재진출하였습니다

[CIS (CMOS Image Sensor)]

CIS는 휴대 전화, 디지털 카메라, 노트북, 태블릿 PC, 웹캠 등 디지털 기기에서 촬영 필름 역할을 하는 반도체 소자이며, 2007~2015년까지 약 17%의 연평균 성장률이 예상되는 시장입니다. (출처: Techno-Systems

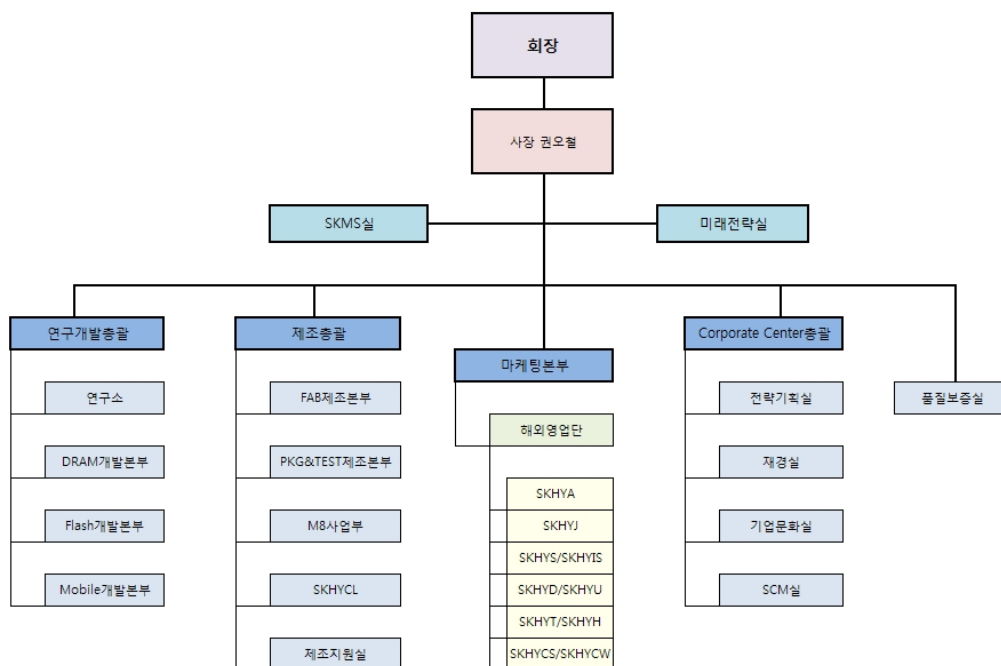
Research, 출하량 기준)

현재는 휴대 전화에 가장 많이 쓰이고 있으나 주변 회로가 필요 없고 전력 소모가 적은 장점과 함께 최근기술의 발전으로 화질이 크게 향상되면서 의료 기기, DSLR 및 캠코더, 자동차, 보안장비, 게임기, 가전 제품 등으로 응용 범위가 급속히 확대되고 있습니다. 또한 최근 3G 통신용 휴대 전화에 사진 촬영과 화상 통화를 위해 두 개의 이미지 센서가 장착되고 있으며, 이러한 경향은 태블릿PC에도 반영되어 기기당 이미지 센서 탑재 비율 역시 늘어나는 추세입니다.

현재 당사의 CIS는 센서 중 가장 많은 수량 비중을 점유하고 있는 휴대전화 응용시장과 이와 유사한 센서특징을 요구하고 있는 노트북 시장, 그리고 최근 급속한 성장세를 보이고 있는 태블릿 PC와 Toy 시장에 집중하고 있으며, 유사 응용시장으로의 전개를 통해 신규 시장 및 직역, 고객을 발굴하여 사업의 안정성 강화와 수익성을 개선하고 있습니다.

당사는 국내와 중국, 대만 지역뿐만 아니라 2012년에는 한층 강화된 사업 역량을 바탕으로 미구주 지역의 고객 확대와 어플리케이션 다양화로 CIS시장에서의 입지를 확대해 나갈 계획입니다.

(4) 조직도(제출일 기준)



다. 사업부문별 재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문으로서 부문별 기재를 생략합니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
반도체 부문	제품 외	DRAM, 낸드플래시, MCP 등	산업용 전자기기	하이닉스	2,388,389(100%)
합계					2,388,389(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : USD)

품 목	제65기 1분기	제64기 연간	제63기 연간
DRAM(COMPONENT)	1.47	1.70	1.99
DRAM(MODULE)	18.89	24.88	41.28
낸드플래시(COMPONENT)	4.08	4.45	4.36

(1) 산출기준 : 시장판매가 기준(용량(Density)별 제품군의 단순 평균 가격)

☞ 상기 자료는 Density 변화를 감안하지 아니한(기준 Density에 대한 환산수량 미적용)

단순 평균 공급가격임.

(2) 주요 가격변동원인

☞ 제품의 고급화 및 시장상황(수출)에 따른 판가변동 등

3. 주요 원재료에 관한 사항

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), 리드프레임(Lead Frame) 및 섭스트레이트(Substrate), PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료등으로 구성됩니다.

웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다.

리드프레임은 반도체 IC를 구성하는 또 다른 주요 요소이며 반도체 칩과 PCB 기판간의 전기신호를 전달하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다.

섭스트레이트는 리드프레임과 같은 기능을 하지만 전기신호를 전달하는 역할을 하는 다리를 기존의 금속 다리가 아닌 공(Ball) 모양의 연결부분을 이용한 부품입니다.

PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 장치하고 납땀하여 회로기능을 완성시키는 인쇄 배선판입니다. 그 외 가스 및 화학약품 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다.

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	투입액	비율	비 고
반도체 부문	원재료	Wafer	F a b	172,363	21	-
		Lead Frame	P K G	55,320	7	-
		PCB	M O D	46,026	6	-
		기타		290,774	36	-
		소계		564,483	69	-
	저장품	S/P, 부재료		249,746	31	-
	합 계			814,229	100	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

구 분	제65기 1분기	제64기 연간	제63기 연간	
반도체 부문	Wafer	115,358	102,951	101,902
	Lead Frame	114	98	72
	PCB	1,664	1,495	1,429

(1) 산출기준

▷ 총매입액 / 총매입수량

(2) 주요 가격변동원인

▷ 투입제품 변경, 생산성 향상 및 수요변화 등에 따라 가격 변동함.

▷ 환율변동

다. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본의 2개사, 독일의 1개사, 한국 1개사로부터 반도체 공정의 주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 수입 하고 있습니다. 당사는 당사와 거래하는 매입처 등과 일상적인 영업활동 이외의 특수한 관계를 갖고 있지 않습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 4개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90%를 차지하고 있습니다.

웨이퍼는 그 원재료가 되는 폴리 실리콘의 수급 동향에 따라 300mm 웨이퍼 완제품 가격이 큰 영향을 받습니다. 특히, 폴리 실리콘은 웨이퍼 이외에도 태양전지(Solar Cell)의 원료로도 사용되기 때문에 태양전지의 수요에 따라 폴리 실리콘의 일시적 부족현상이 발생하면 웨이퍼의 공급에 영향을 줄

수 있습니다. 따라서, 당사는 주요 원재료인 웨이퍼의 원활한 확보를 위해 유가 및 폴리 실리콘 시장의 가격동향은 물론, 동일한 원재료를 사용하는 태양전지 수급동향을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 국내사업장 기준 4조3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2012년 1분기 총 가동일은 91일로, 각 지역별 팹(Fab)의 가동인원 및 수율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월 9,517,144시간입니다.

생산능력은 "해당분기내 최대생산월의 생산량 x 누적개월수 x 평균원가"의 방법으로 산출하고 있으며, 2012년 1분기 생산능력은 2,525,138백만원 입니다

(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	제65기 1분기	제64기 연간	제63기 연간
반도체 부문	2,525,138	11,773,104	9,049,076

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 생산실적 및 가동률

당사의 2012년 1분기 생산실적은 전년도 동기 대비 4% 감소한 2,525,138백만원으로 집계 되었으며, 동 기간 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	제65기 1분기	제64기 연간	제63기 연간
반도체 부문	2,525,138	10,414,567	8,328,023

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 가동률

(단위 :시간, %)

사업부문	분기가동가능시간	분기실제가동시간	평균가동률
------	----------	----------	-------

반도체 부문	28,551,431	28,551,431	100%
--------	------------	------------	------

※가동률은 각 지역별 팹(Fab)의 가동인원 및 수율을 고려하여 계산함.

다. 생산설비의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계
2012.01.01								
취득원가	462,586	1,670,585	487,426	26,297,598	2,906	618,529	444,973	29,984,604
감가상각누계액	-	(422,188)	(270,826)	(17,522,850)	(2,454)	(460,559)	-	(18,678,877)
손상차손누계액	-	(23,877)	(30,639)	(340,580)	-	(2,867)	-	(397,964)
정부보조금	-	-	-	(8,456)	-	-	-	(8,456)
기초순장부금액	462,586	1,224,519	185,961	8,425,712	452	155,103	444,973	10,899,308
기중변동액								
취득		11		3	54	225	1,186,716	1,187,119
처분	-	(16)	-	(17,634)	(12)	(24)	(2,154)	(19,840)
감가상각	-	(11,802)	(5,439)	(775,788)	(46)	(14,980)	-	(808,055)
대체	-	784	655	900,394	26	6,696	(908,559)	(3)
손상차손	-	-	-	-	-	-	-	-
환율변동 등	(162)	(2,607)	(1,142)	(30,000)	(9)	(208)	(25)	(34,153)
기말순장부금액	462,425	1,210,890	180,035	8,502,687	465	146,812	720,950	11,224,264
2012.03.31								
취득원가	462,425	1,667,862	486,615	27,045,979	2,929	600,339	720,950	30,987,098
감가상각누계액	-	(433,095)	(275,951)	(18,192,365)	-	(450,665)	-	(19,352,075)
손상차손누계액	-	(23,877)	(30,629)	(342,667)	(2,464)	(2,861)	-	(402,499)
정부보조금	-	-	-	(8,260)	-	-	-	(8,260)
기말순장부금액	462,425	1,210,890	180,035	8,502,687	465	146,812	720,950	11,224,263

라. 투자계획

당사의 2012년 입고기준 투자금액은 해외 현지 생산법인을 포함하여 약 4.2조원을 계획하고 있습니다. 아울러 동 투자금액은 환율변동, 시장상황 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있습니다.

[관련공시: 2012년 2월 2일자 수시공시의무관련사항(공정공시)]

한편, 2012년 1분기 당사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다.

[입고기준]

(단위 : 십억원)

구 분	투자대상자산	투자효과	투자 기간	총 투자	기투자액	향후	비 고
-----	--------	------	-------	------	------	----	-----

				액 (계획)	(제65기 1분기)	투자액	
보완투자	기계장치 외	생산능력증 가	2012.01.01 ~2012.12. 31	4,244	1,145	3,099	-
합 계				4,244	1,145	3,099	-

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제65기 1분기	제64기	제63기
반도체 부문	제품 외	DRAM, 낸드플래시, MCP 등	2,388,389	10,395,811	12,106,090
합 계			2,388,389	10,395,811	12,106,090

※ 매출실적은 연결기준입니다

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

국내에서는 마케팅 본부 내 국내영업팀 관할 하에 대리점 6개사를 운영하고 있습니다. 해외 판매 법인은 미국, 독일, 영국, 일본, 싱가포르, 인도, 홍콩, 대만, 중국 등 총 9개 국가에 소재하고 있으며 산하에 20개 지사 및 14개 대리점을 두고 있습니다.

(2) 판매경로

당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

(3) 판매방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점 등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 거래하고있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 조건 등으로거래하고 있습니다.

(4) 판매전략

당사 판매 전략은 '비즈니스 포트폴리오 최적화', '수익 구조 개선', '고객 관계 유지', '지역별 포지셔닝 유지' 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.

비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 서버, 그래픽, 모바일, 컨수머 등 응용분야의 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다.

수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래시장 발굴을 추진하고 있습니다.

고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다.

지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처

DRAM의 경우, DELL, HP 등 세계 유수의 PC 및 서버 등 PC 관련 전자 업체에 제품을 공급하고 있습니다.

낸드플래시는 IT 컨수머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에, Apple 등 세계적인 PC 및 스마트폰 제조업체, 메모리 모듈 업체, 그리고 휴대용 저장장치와 메모리 카드 생산 업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다.

6. 수주상황

당사는 주요 고객사들과 월별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기 공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 주요 시장위험 요소

당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영안정성 제고를 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 영업측면에서 매출의 90% 이상이 US\$로 연동되어 US\$ 수입이 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 수입에서 지출을 차감한 잔존 외화 현금흐름이 환리스크 관리의 주 대상입니다.

나. 회사의 위험관리 정책

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 주요 글로벌 금융기관으로부터 환리스크 관리에 대한 컨설팅을 받은 바 있으며, 환위험 관리규정 제정, 외환관리위원회 구성 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다.

(1) 위험관리의 일반적 전략

[위험관리규정]

당사는 환리스크 관리를 위한 외환거래에 있어 환관리시행규칙을 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며, 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보 하기 위해 실행되어야 하며, ②실 수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고 ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 환위험관리위원회가 설정한 지침에 따라 관리하고 있습니다.

[파생상품계약 운용]

당사는 파생상품계약을 환위험 헤지 목적으로 운용하고 있으며, 동 파생상품계약은 기말외화 부채의 10% 미만 수준으로 관리되고 있습니다.

(2) 위험관리조직 및 운영 현황

당사는 외환관리에 관한 의사결정기구로서 외환관리위원회를 설치·운영하고있으며, 외환관리위원회의 주요 업무는 다음과 같습니다.

- ① 외환 관리 정책, 전략 심의 및 의결
- ② 외환 관리 규정의 제정 및 개정
- ③ 환관리 목표와 허용 손실한도의 설정
- ④ 환위험 헤지 범위 및 헤지 비율, 관리수단 등의 조정
- ⑤ 환포지션, 환율 변동 영향, 환율 전망 등 환관련 정보의 공유

다. 위험관리 관련 추진사항

당사는 종합적 외화 자산 부채 관리의 일환으로 영업상의 환율 변동 영향을 축소하기 위해 파생상품 거래를 체결하고 있습니다. 파생상품 거래를 매매목적의 거래로 분류하여 회계처리 하고 있으며, 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.

8. 파생상품 거래현황

연결회사는 이자 및 원금스왑, 선물환 매도계약, 이자율 스왑, 통화옵션계약 등을통하여 환율변동위험, 현금흐름 이자율위험 등을 관리하고 있습니다. 또한 내재파생상품인 무보증외화공모사채에 내재되어 있는 조기상환옵션과 해외전환사채에 내재되어 있는 전환권옵션을 분리하여 공정가치로 평가하여 당기손익으로 인식하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 기타금융자산으로 계상되어 있는 파생금융자산은 8,363백만원(전기말: 3,114백만원)이며 기타금융부채로 계상되어 있는 파생금융부채는 81,832백만원(전기말: 46,474백만원)입니다.

당분기에 파생상품거래와 관련하여 인식한 평가이익 및 거래이익은 8,704백만원(전분기: 9,804백만원)이며 평가손실 및 거래손실은 37,864백만원(전분기: 65,666백만원)입니다.

9. 경영상의 주요계약 등

계약 상대방	항목	내용	비고
Toshiba Corp.	계약 유형	공동개발계약 및 라이선스 연장	
	계약 기간	2011년 7월 13일~	
	목적 및 내용	차세대 메모리의 조기 상용화 및 시장 진입 기반 구축 개발비용 절감 및 투자 효율성 제고	
	기타 주요내용	STT-MRAM 공동개발 진행 공동개발 성공시 합작회사를 설립하여 STT-MRAM 공동 생산	
무석산업발전집단 유한공사	계약 유형	공동 투자를 통한 반도체 후공정 전문합작회사 설립계약	
	계약 기간	2009년 5월 17일~	
	목적 및 내용	중국 내 일괄생산체제 구축을 통한 제조 및 물류 효율성 증 대와 원가경쟁력 강화, 안정적 외주처 확보	
	기타 주요내용	양사의 협의로 합작법인을 후공정 전문회사로 장기 육성, '합작사는 향후 5년간 하이닉스에 후공정 장기 외주 임가 공 제공 및 장비운용/교육을 위한 인력파견	
C&S Technology Ltd.	계약 유형	공동개발 및 파운드리 공급계약	
	계약 기간	2008년 7월 14일~	
	목적 및 내용	설계 및 파운드리 전략제휴를 통한 시스템반도체분야 사업경쟁력 확보	
	기타 주요내용	자동차용 반도체 공동개발, 씨엔에스社에 자사 파운드리 제공, 씨엔에스社는 당사에 디자인서비스 제공, 씨엔에스 社의 일정지분취득	
SiliconFile Technologies Inc.	계약 유형	기존 파운드리 계약범위 확대 및 경영권인수를 위한 주식매매계약	
	계약 기간	2008년 7월 21일~	본계약체결일
	목적 및 내용	경영권 인수를 통해 기존의 단기적, 상호경쟁력 협력모델을 중장기적, 상호 보완적 협력모델로 전환	
	기타 주요내용	2007년 11월 13일의 기존 CMOS 이미지 센서분야 기술공 동개발, 판권허여 및 파운드리협력계약의 제품 계약범위 확대 및 실리콘화일社 지분 30% 확보로 최대주주로서 경 영에 참여	
Phison Electronics Corp.	계약 유형	제품공급 및 공동개발계약	
	계약 기간	2008년 6월 18일~	
	목적 및 내용	제품 공급 및 낸드플래시 응용기기 기술확보로	

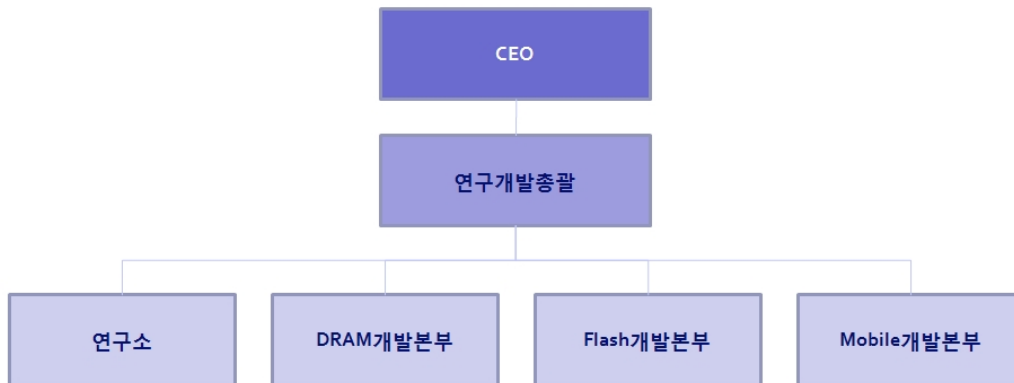
		사업경쟁력 강화	
	기타 주요내용	파이슨사에 당사의 낸드플래시 제품 공급, 파이슨사와 낸드 플래시 응용제품 공동개발 파이슨사의 일정지분취득	
Grandis Inc.	계약 유형	공정기술 라이선스 계약	
	계약 기간	2008년 3월 10일 ~ 2023년 3월 10일	
	목적 및 내용	STT-RAM 기술 확보 및 차세대 메모리 역량 강화	
	기타 주요내용	STT-RAM 기술 및 라이선스 확보	
Fidelix Co., Ltd.	계약 유형	설계용역, 파운드리 공급 및 판권허여 계약	
	계약 기간	2008년 3월 19일 ~ 2013년 3월 18일	
	목적 및 내용	200mm 팹(Fab) 활용성 및 수익성 강화와 다양한 제품설계기술 확보	
	기타 주요내용	피델릭스사는 당사에 설계용역 제공, 당사의 파운드리서비스를 피델릭스 측에 제공, 동 생산제품의 판권 허여, 피델릭스 지분취득 권리 확보	
SiliconFile Technologies Inc.	계약 유형	공동연구개발, 판권 허여 및 파운드리 공급계약	
	계약 기간	2007년 11월 13일~	
	목적 및 내용	CMOS 이미지 센서 기술협력 및 안정적인 조기 CIS시장진입 기회 확보	
	기타 주요내용	실리콘파일사의 휴대폰용 CMOS 제품 판권을 당사에 허여 하였으며, 향후 제품 공동개발, 당사의 파운드리서비스를 실리콘파일사에 제공	
Ovonyx Inc.	계약 유형	공정기술 라이선스 및 기술 도입	
	계약 기간	2007년 10월 1일~2027년 10월 1일	
	목적 및 내용	PRAM 기술 확보 및 차세대 메모리개발 역량 강화	
	기타 주요내용	PRAM 기술이 구현된 메모리제품을 생산/판매할 수 있는 비독점적, 비양도성 라이선스를 당사에 허여	
Innovative Silicon Inc.	계약 유형	공정기술 라이선스 및 기술 도입	
	계약 기간	2007년 7월 16일 ~	
	목적 및 내용	ZRAM 기술 확보 및 미래 기술역량 강화	
	기타 주요내용	ZRAM Memory Macro 개발, 생산, 판매에 필요한 ZRAM 기술 라이선스 허여 및 ZRAM 공동연구 개발	

10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직

당사는 보고서 제출일 현재, 연구소 및 DRAM개발본부, Flash개발본부, Mobile개발본부에서 연구개

발 활동에 주력하고 있습니다.



나. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목	제65기 1분기	제64기	제63기	비 고	
원 재 료 비	9,650	42,991	33,492	-	
인 건 비	93,700	264,890	292,800	-	
감 가 상 각 비	32,617	155,967	154,370	-	
위 탁 용 역 비	4,390	33,191	31,457	-	
기 타	83,117	336,749	278,142	-	
연구개발비용 계	223,473	833,788	790,261	-	
회계처리	판매비와 관리비	200,586	679,197	669,758	-
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	22,887	154,592	120,503	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 ÷ 당기매출액 × 100]	9.4%	8.0%	6.5%	-	

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적

구 분	연구과제명	기대효과
제65기 1분기	1) 64Gb MLC NAND	2Y나노 공정을 적용한 핵심제품으로써 기존의 고용량 2X나노 64Gb 제품 대비 생산성이 40% 이상 향상되어 원가 경쟁력을 확

		보하였으며, 최근 크게 수요가 증가하고 있는 모바일향 솔루션 제품 수익성 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됨.
	2) 4Gb LPDDR3	30나노급 기술을 적용한 LPDDR3 제품으로 기 양산중인 LPDDR2 제품 대비 고속 동작 및 저전력 동작이 가능함. PC에 채용되는 DDR3 제품의 속도를 구현할 수 있어 저전력 고속 동작을 요구하는 고사양 스마트폰 및 태블릿 PC에 채용될 예정임.

구 분	연구과제명	기대효과
제64기	1) 2Gb DDR3	30나노급 기술을 적용한 메인메모리 제품으로 서버, 데스크탑 PC, 노트북 등에 사용되는 제품임. 하이닉스 최초로 6F2기술을 적용하여 상용화한 제품으로 기존 40나노급 제품보다 월등히 생산성이 높아지게 되어 경영실적에 크게 기여할 것으로 예상됨. 30나노급의 기술 플랫폼을 구축하게 되었으며 향후 개발될 30나노급 파생제품의 개발을 선도할 제품임.
	2) 1Gb LPDDR	40나노급 기술을 적용한 모바일 메모리 제품으로 핸드폰, PMP, MID, 넷북, 게임 콘솔 등 다양한 모바일 어플리케이션에 대응 가능한 제품임. 특히 Small Package가 가능하도록 제작되어 점차 소형화 되고 있는 모바일 시장의 시장점유율확대에 기여할 것으로 예상됨.
	3) 16Gb/32Gb/64Gb MLC eNAND	2X나노 기술을 적용한 응용복합 제품으로 스마트폰, 태블릿PC 등의 모바일 시장에 대응하기 위하여 개발된 제품임. eMMC4.4 Spec 요건을 만족하고 있으며, 기존 30나노급 기술 대비 60% 이상의 생산성 향상으로 인해 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상됨.
	4) VGA 1.75um 130nm	1.75um 130나노 기술을 적용한 VGA 제품으로 중국시장내 가격 경쟁력 심화에 대응하기 위한 제품으로 기존 제품 대비 생산성이 14% 증가하였으며 중국 시장에서 VGA 제품의 가격이 하락하는 시점에서 시장 진입함으로써 수익성 유지를 목적으로 함.
	5) 256Mb Combo Mobile	40나노급 기술을 적용한 저사양 모바일폰 및 데이터카드, 베이스 밴드향의 모바일 메모리 제품으로 기존 기술 대비 다이(die) 수 증가로 인한 원가 경쟁력 확보로 수익성 향상에 기여할 것으로 예상됨.
	6) 4Gb DDR3	하이닉스 최초의 30나노급 4Gb 고용량 제품으로 PC용 메인메모리 뿐만 아니라 그래픽, 컨슈머 시장에도 대응이 가능함. 32GB RDIMM과 64GB 슈퍼 노바 DIMM 개발을 통해 고용량 모듈 지원이 가능하여 수익성 확보 및 유지에 기여할 것으로 기대됨.
	7) 2Gb DDR3(x16)	30나노급 기술을 적용한 그래픽, 컨슈머 시장 주력 제품으로서 1GHz의 빠른 스피드 특성을 확보하여 시장지배력 유지에 기여할 것으로 기대됨. 1.35V의 저전압에서도 900MHz의 속도를 확보하여 Low Vdd 경쟁력도 갖추었음.
	8) 1M, 2.0um, 130nm	2.0um, HD format Pixel array를 적용하여 노트북 시장을 타겟으로 개발한 제품임. 노트북용 카메라 시장이 베가에서 1M HD 센서로 급격히 이동함에 따라 이에 대응하기 위한 제품으로 노트북 시장 점유율 확대와 안정적 수익 창출에 기여할 것으로 예상됨.

	9) 2Gb DDR5	30나노급 기술을 적용한 그래픽 시장 주력 제품으로 저전력, 초고속, 고용량, 소형화가 요구되는 그래픽 시장 대응을 위한 제품임. 세계 최고 수준의 속도 구현 및 저전력, 고속동작지원으로 기술의 리더십을 유지하는 독보적인 위치를 확보하였음. PC와 노트북 그래픽 카드 및 HPC(High Performance Computing)에 최적화된 제품임.
	10) 512Mb LPDDR	40나노급 기술을 적용한 저사양 모바일폰 및 데이터카드, 베이스밴드향의 모바일 메모리 제품으로 기존 50나노급 기술 대비 다이(die) 수 증가로 인한 원가 경쟁력 확보로 수익성 향상에 기여할 것으로 예상됨.
	11) 4Gb LPDDR2	30나노급 6F2 기술이 적용된 모바일 제품으로 고용량, 고속동작이 가능한 제품임. 초박형 패키지로 제작되어 고사양 스마트폰 및 태블릿 PC에 채용될 예정으로, 수익성 증대에 기여할 것으로 예상됨.
	12) 2Gb LPDDR2	30나노급 기술을 적용한 스마트폰 시장 주력 제품으로서 기존 800Mbps 동작 대비 향상된 1066Mbps 특성을 확보하여 고사양 제품 채용도 가능하여 수익성 향상에 기여할 것으로 예상됨.
	13) 1Gb SLC NAND	30나노급 기술을 적용한 SLC 최초 4bit ECC 지원 제품으로 모바일향으로 개발 되었으며, 매출 및 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상됨. LTE 등 통신환경 개선으로 Data card 시장 성장 예상과 중국에서 512Mb~1Gb SLC 제품을 채용하는 SOC가 신규 개발 예정되어 중화권 모바일 시장 확대가 전망됨.
	14) 120GB mSATA SSD	20나노급 기술을 적용한 mSATA SSD 개발을 통해 자사 최초로 SSD 시장진입을 달성함. 모바일과 함께 NAND 어플리케이션 중 가장 가파른 성장이 예상되는 SSD 시장 진입에 성공함으로써 매출 및 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상됨.
	15) 2M MIPI, 1.75um, 130nm	기 개발된 130nm 1.75um 2M 제품에 MIPI 시리얼 인터페이스를 추가한 제품으로 칩셋업체의 MIPI 지원 제품의 본격적인 출시와 Set 업체의 MIPI 지원에 대한 요구에 대응하기 위한 제품임. 향후 MIPI 지원 제품의 수요가 급격히 증가할 것으로 예상되어 매출 확대에 크게 기여할 것으로 전망됨.
	16) 3M, 1.4um, 90nm	1.4um 화소를 적용한 첫 90nm 코어 제품으로 향후 90nm 파생 제품 개발을 통한 제품 라인업 확대와 모바일폰에서 요구되는 소형화 추세에 대응하기 위한 제품임. 낮은 1.2V 전압에서 동작하여 소비전력이 낮은 장점이 있으며, 개발 단계에서부터 고객 평가를 통한 요구사항을 적극 반영하여 개발 완료와 동시에 판매로 이어져 매출 확대가 기대됨.
구 분	연구과제명	기대효과
제63기	1) 512Mb Combo Mobile	50나노급 기술을 적용한 모바일 메모리 제품으로 모바일폰, PDA, 스마트폰, MP3플레이어, PMP, 네비게이션, DMB 등 모바일 기기 대응을 위한 제품임. 저사양 휴대폰에 낸드 MCP가 노어 MCP를 대체하는 추세에 따라 수요 증대가 예상되며, 저전력 DDR의 원가 경쟁력 확보를 통해 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.

2) 32Gb MLC Flash	30나노급 기술을 적용한 핵심 제품으로 고용량 어플리케이션 및 PC Storage 시장에 대응하기 위한 제품임. 기존 기술 대비 Net die 증가로 인한 가격 경쟁력 확보로 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
3) 4Gb SLC Flash	40나노급 기술을 적용한 파생제품으로 모바일용 MCP 시장에 대응하기 위한 제품임. 향후 모바일 분야에서 4Gb 제품이 주력 제품으로 예상됨에 따라 공정 미세화를 통한 가격경쟁력 확보 및 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
4) VGA 2Sh WLCSP 2.25um	실리콘화일과 공동개발한 2.25um 130나노 기술을 적용한 기존의 VGA 2Sh CMOS 이미지 센서 제품으로 수정작업이 다른 패키지 제품보다 용이하여 빠른 불량분석이 가능하며 중국 및 대만 고객사의 대응에 적합한 제품으로 판매량과 매출 증대에 기여 할 것으로 기대됨.
5) 1.3M SoC 1.75um	실리콘화일과 공동개발한 1.75um 130나노 기술을 적용한 CMOS 이미지 센서 제품으로써 휴대전화용 카메라는 물론 노트북과 PC 카메라에도 사용이 가능하며, 화질이 우수하고 크기가 작아 특히 국내 시장에서의 판매량과 매출이 기대됨.
6) 2Gb GDDR5	40나노급 기술을 적용한 그래픽스 메모리 제품으로 고사양 PC와 서버, 차세대 게임 콘솔 대응을 위한 제품임. 1Gb GDDR5에 이어 2Gb 제품의 사용이 증가할 것으로 예상되며, 고사양 그래픽 시장에서 주력 제품으로 예상되는 바 시장 선점 및 경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대됨.
7) 2Gb Mobile DDR2	40나노급 기술을 적용한 모바일 메모리 제품으로 MID(Mobile Internet Device), 스마트폰 및 고사양 모바일 DDR2 시장요구에 대응하기 위한 제품임. 스마트폰 및 MID(Mobile Internet Device)에서 전반적인 채용이 증가할 것으로 예상됨에 따라 모바일 시장 매출에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.
8) 3M SoC 1.75um 130nm	실리콘화일과 공동개발한 1.75um 130나노 기술을 적용한 CMOS 이미지 센서 제품으로써 휴대전화용 카메라는 물론 노트북과 PC 카메라에도 사용이 가능하며, 화질이 우수하고 크기가 작아 특히 국내 시장에서의 매출이 기대됨.
9) Slim VGA 2.25um 130nm	실리콘화일과 공동개발한 2.25um 130나노 기술이 적용된 기존의 VGA 2Sh CMOS 이미지 센서를 기반으로 더욱 소형화된 제품을 개발함. Net Die 향상 및 원가 절감으로 경쟁이치열한 중국 시장에 특화된 제품. 품질이 뛰어나 고객의 선호도가 높은 제품으로 판매량 및 수익성 향상에 기여를 하고 있음.
10) 3M SoC 1.75um 130nm	실리콘화일과 공동개발한 1.75um 130나노 기술을 적용한 CMOS 이미지 센서 제품으로써 300만화소의 고품질로 이미지 센서 시장에서 주력 제품으로 자리매김을 할 것으로 예상함. 휴대전화용 카메라는 물론 노트북에서도 사용이 가능하며 국내 시장에서 매출이 기대됨.
11) 2Gb Combo Mobile	40나노급 기술을 적용한 모바일 메모리 제품으로 기존 모바일 어플리케이션인 핸드셋, PMP, 모바일 인터넷 기기, 넷북, 게임 콘솔

	뿐만 아니라 다양한 고객 요구사항에 대응하기 위한 제품임. 기존 기술 대비 다이(die) 수 증가로 원가경쟁력 확보와 모바일 메모리 제품의 수요 급증으로 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 기대됨.
12) 512Mb DDR2	40나노급 기술을 적용한 제품으로 디지털티비, 셋톱박스, 네트워크의 고사양 제품에 적용되는 컨수머 제품임.
13) 32Gb TLC NAND	하나의 셀(Cell)당 세개의 Bit 정보를 저장할 수 있는 제품으로 기존 SLC, MLC 대비 고용량, 저비용의 실현이 가능하여 원가 경쟁력 및 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
14) 16Gb MLC NAND	핵심제품의 향상된 성숙도와 신뢰성 조기 확보로 최단기간 개발된 제품으로, 이전 기술 공정 제품을 대체하여 수익성 향상이 기대되며 단품은 물론 uSD, eNAND까지 다양한 어플리케이션에 적용할 예정임.
15) 16Gb SLC HS NAND	자사 최초로 초고속 사양을 적용한 제품으로 기존제품보다 대폭 속도가 향상되었음. Flash 시장의 킬러 어플리케이션으로 기대되고 있는 SSD를 타겟으로 개발된 제품으로 향후스토리지 업체 및 자사 SSD 개발에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.
16) 64Gb MLC NAND	20나노급 공정을 적용한 핵심제품으로써 혁신적인 기술 개발을 통해 경쟁사와의 기술격차를 크게 줄임. 기존 30나노급32Gb제품 대비 생산성이 60% 향상되어 업계 최고 수준의 원가 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대됨.
17) 2M 1.75um 130nm	실리콘화일과 공동개발한 1.75um 130나노 기술을 적용한 200만 화소 CMOS 이미지 센서 제품으로써 중국 이미지 센서시장에 특화된 제품. 휴대전화용 카메라 제품으로 중국시장의 차세대 주력 제품으로 매출 및 이윤 향상에 기여 할 것으로 예상함.
18) 1Gb GDDR5	40나노급 공정을 적용한 그래픽 메모리 제품으로 고사양 PC 그래픽 대응 제품임. 이전 기술 공정 대비 다이(die) 수 증가 및 고사양 PC 그래픽의 주력 제품으로서 수익성 향상이 기대됨.
19) 1Gb Mobile DDR2	40나노급 공정을 적용한 모바일 메모리 제품으로 Mid-Range 및 고사양 시장인 MID, 스마트폰에 대응하기 위한 제품임. MID 및 스마트폰의 고사양화에 따른 저전력 고속제품 요구 증가로 LPDDR2의 채용이 급격히 확대될 것으로 전망됨에 따라 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 기대됨.
20) 32Gb MLC HS NAND	폭발적인 성장세를 보이고 있는 스마트폰, 태블릿 PC 등에 채용되고 있는 eMMC향으로 개발된 제품임. 기존 30나노급공정 대비 크기는 약 24% 작아지고 다이(die)수는 30% 많아 모바일 분야의 매출 및 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 기대됨.

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

- 국내CB 전환권행사 : 0백만원 (21주*23,328원, 2012년 2월 1일),
- 국내CB 전환권행사 : 1백만원 (63주*23,328원, 2012년 2월 13일),
- 국내CB 전환권행사 : 46백만원 (1,971주*23,328원, 2012년 2월 15일),
- 국내CB 전환권행사 : 0백만원 (4주*23,328원, 2012년 2월 23일),
- 국내CB 전환권행사 : 10백만원 (428주*23,328원, 2012년 3월 15일),
- 국내CB 전환권행사 : 5백만원 (234주*23,328원, 2012년 3월 29일),
- 국내CB 전환권행사 : 10백만원 (428주*23,328원, 2012년 3월 30일)
- 소계 : 91백만원

(주5) 당기 중 감소분은 관계사차입금 US\$42백만임.

※ 상기 신규조달 및 상환 등 감소 금액은 환율변동으로 인한 외화평가분을 포함함.

(2) 해외조달

(단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고
금융기관	908,289	146,009	190,431	863,867	(주6)
해외증권(회사채)	1,194,473	-	16,053	1,178,420	-
해외증권(주식등)	2,134,130	-	-	2,134,130	-
자산유동화		-	-	-	-
기타	399,710	-	6,499	393,211	(주7)
총계	4,636,602	146,009	212,983	4,569,627	-

(주6) 당기 중 증가분은 SKHYCL 단기 US\$130백만이며, 감소분은 SKHYCL Syndi Loan US\$44백만 및 단기 US\$115백만임.

(주7) SKHYCL Lian Xian 금융리스차입금임.

※ 상기 신규조달 및 상환 등 감소 금액은 환율변동으로 인한 외화평가분을 포함함.

나. 최근 3년간 신용등급

[국내]

평가일	평가대상 유가증권등	평가대상 유 가증권의 신용등급	평가회사	신용평가등 급범위	평가구분
09.06.29	회사채(정기평가)	BBB+	한기평	AAA ~ D	정기평가
09.06.30	회사채(정기평가)	BBB+	한신정평가	AAA ~ D	정기평가
09.07.16	회사채(정기평가)	BBB+	한신평	AAA ~ D	정기평가
09.09.21	회사채(208)	BBB+	한기평	AAA ~ D	본평가
09.09.21	회사채(208)	BBB+	한신정평가	AAA ~ D	본평가
09.09.22	회사채(208)	BBB+	한신평	AAA ~ D	본평가
09.12.24	회사채(수시평가)	BBB+	한기평	AAA ~ D	수시평가
10.06.29	회사채(정기평가)	BBB+	한신정평가	AAA ~ D	정기평가

10.06.30	회사채(정기평가)	BBB+	한기평	AAA ~ D	정기평가
10.06.30	회사채(정기평가)	BBB+	한신평	AAA ~ D	정기평가
10.08.31	회사채(209)	BBB+	한기평	AAA ~ D	본평가
10.08.31	회사채(209)	BBB+	한신정평가	AAA ~ D	본평가
10.08.31	회사채(209)	BBB+	한신평	AAA ~ D	본평가
11.01.05	회사채(210)	BBB+	한기평	AAA ~ D	본평가
11.01.05	회사채(210)	BBB+	한신정평가	AAA ~ D	본평가
11.01.05	회사채(210)	BBB+	한신평	AAA ~ D	본평가
11.04.27	회사채(211)	A-	한기평	AAA ~ D	본평가
11.04.27	회사채(211)	A-	한신정평가	AAA ~ D	본평가
11.04.27	회사채(211)	A-	한신평	AAA ~ D	본평가
11.04.27	회사채(정기평가)	A-	한기평	AAA ~ D	정기평가
11.04.27	회사채(정기평가)	A-	한신정평가	AAA ~ D	정기평가
11.04.27	회사채(정기평가)	A-	한신평	AAA ~ D	정기평가
11.11.15	회사채(수시평가)	A-	한신평	AAA ~ D	수시평가
11.11.16	회사채(수시평가)	A-	한기평	AAA ~ D	수시평가
12.02.16	회사채(수시평가)	A	한신정평가	AAA ~ D	수시평가
12.02.17	회사채(수시평가)	A	한신평	AAA ~ D	수시평가
12.02.17	회사채(수시평가)	A	한기평	AAA ~ D	수시평가

[해외]

평가일	평가대상 유가증권등	평가대상 유 가증권의 신용등급	평가회사	신용평가등 급범위	평가구분
09.01.14	해외사채	B	S & P	AAA ~ D	수시평가
09.11.13	발행회사	B+	S & P	AAA ~ D	수시평가
10.01.25	발행회사	B1	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
10.11.24	해외사채	B+	S & P	AAA ~ D	수시평가
12.02.14	해외사채	BB-	S&P	AAA ~ D	수시평가
12.02.15	발행회사	Ba3	Moody's	Aaa ~ C	수시평가

※ 상기 S&P 및 Moody's의 본점 소재지는 미국임.

[참고] 국내 신용평가사(한신정평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 등급정의

신용등급	등급의 정의
AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음
A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음
BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음
BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음
B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임
CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음
CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음
C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음
D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ AA ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 해외 신용평가사 Moody's 등급 정의

신용등급	등급의 정의
Aaa	최소한의 신용 리스크를 보이며, 최고의 신용상태를 가진 것으로 판단됨.
Aa	신용상태가 우수한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 낮음.
A	중상위 등급으로 간주되며 신용 리스크가 낮음.
Baa	신용 리스크가 보통 수준임. 이들은 중위 등급으로 간주되며 그에 따라 일부 투기적 특징을 가질 수 있음.
Ba	투기적 요소가 있는 것으로 판단되며 신용 리스크가 상당한 수준임.
B	투기적인 것으로 간주되며 신용 리스크가 높음.
Caa	신용상태가 불량한 것으로 판단되며 신용 리스크가 매우 높음.
Ca	투기성이 매우 높고 부도상태이거나 부도에 매우 근접해 있을 가능성이 높으며 원리금 회수 가능성이 어느 정도 있음.
C	채권의 최하 등급. 일반적으로 부도상태이고 원리금 회수 가능성이 거의 없음.

※ Aa부터 Caa까지 각 일반 등급 분류에 1,2,3의 숫자를 부여함. 숫자 1은 해당 등급 분류 내에서 상위에 있음을, 숫자 2는 중위에, 숫자 3은 하위에 있음을 나타냄.

[참고] 해외 신용평가사 S&P 등급 정의

신용등급	등급의 정의
AAA	채무상환능력이 극히 높음. 최상 등급임.
AA	채무상환능력이 매우 높음, 상위 등급과 크게 차이는 없으나 최고 수준은 아님.
A	채무상환능력이 높음, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무상환능력은 충분하나, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BB	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나, 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 충분히 고려됨
B	현재로서는 채무상환능력이 있으나, 상위 등급의 기업에 비해 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 높음.
CCC	현재 채무불이행 가능성이 있으며, 채무이행 능력은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 있다고 보여짐.
CC	채무불이행 가능성이 현재로서 상당히 높음.
D	채무만기시 1건 이상의 채무를 상환하지 못한 기업을 의미함.

※ AA등급에서 CCC등급까지는 해당 등급에서의 상대적인 위치에 따라 '+', '-'를 추가로 부여할 수 있음.

다. 회사의 고객관리 정책

당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 당사 매출기여도가 매우 높고 당사 판매 전략과 부합하는 고객을 '전략 고객(Strategic Account, S/A)'으로 정하여 관리하고 있습니다. 당사의 S/A 고객은 본 보고서 작성일 현재 총 13개사로 각 응용 분야별 전략 고객의 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다.

라. 지식재산권 보유현황

2012년 3월 31일 현재 당사는 반도체와 관련하여 총 23,617건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록유지 또는 포기여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다.

특허와 실용신안권은 각국의 특허법과 실용신안법에 근거하여 보호되고 있으며, 상표권은 각국의 상표법에 근거하여 보호되고 있습니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년(실용신안은 10년), 상표는 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기한을 연장할 수 있습니다.

당사 지식재산권은 총 58인으로 구성된 전담조직에서 출원, 등록 및 사후관리, 분쟁대응등을 담당하고 있습니다. 다양한 지식재산권이 당사 제품 생산 및 사업운영에 활용되고 있으며 각각의 세부사항 및 특허권의 상세한 내용은 영업비밀에 해당되므로 기술하지 않습니다.

마. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항

'산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제11조'에 의하여 국가핵심기술로 지정된 반도체 제조기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 지식경제부에 신고할 의무를 지니고 있습니다. 이에 당사는 중국공장의 생산효율성을 극대화하고 현지 시장에서의 우위를 지속적으로 유지하기 위하여 중국 우시공장(SKHYCL)과 후공정합작사인 HITECH에 디자인롤 29나노 DRAM 공정기술과 조립검사기술의 이전에 대하여 관련법에 의한 국가핵심기술 신고절차를 준수하여 신고 수리를 완료하였습니다.

당사 경영계획 일정에 따른 적기 기술 이전을 통해 차질 없는 생산 전개로 경영목표를 원활하게 달성해 나갈 것입니다.

바. 환경보호 정책 및 현황

(1) ESH경영시스템 인증

당사는 ESH경영시스템에 의한 ISO14001 & OHSAS18001/KOSHA18001 프로그램 인증을 취득하여 유지관리하고 있으며, 기업활동의 부산물로 생성되는 환경영향 및 작업장에서의 안전보건 영향요인을 효율적으로 관리하기 위해 회사전반에 ISO14001/OHSAS18001에 의한 경영체제를 도입하여, 관리시스템을 재정비하고 조직을 구성하여 체계적인관리를 실시하고 있습니다. 2010년에는 ISO14001:2007 규격으로 인증 갱신심사를 실시하여 ESH경영시스템의 유효성 재검증 및 효율화를 위한 활동을 지속적으로 전개해 나가고 있습니다. 2010년도에는 ESH경영시스템을 전산화하여 각 사업부서별 ESH 담당자들의 업무혁신을 이루었습니다.

(2) 기후변화 협약 대응

당사는 2005년 12월부터 2010년 12월까지 지식경제부와 에너지 절약 및 온실가스 배출 감소를 위한 자발적 협약(Voluntary Agreement, VA)을 체결하였으며, 이에 따라 체계적인에너지 절감 및 투자 계획을 수립하여 에너지 절감량, 효율 향상 등에 관한 실적을 매년 공개하고 있습니다.

[에너지 목표관리제]

당사는 전세계적인 이슈인 기후변화 대응을 위해 온실가스 인벤토리 시스템을 완료했으며 특히 2009년도에 지식경제부에서 주관하는 에너지 목표관리제 시범사업에 참여하여 중장기적으로 기후변화에 대비함은 물론 에너지효율적 사업장을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

[CDP(탄소정보 공개 프로젝트) 탄소경영 최우수기업 3년 연속 선정]

당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영 최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 3년 연속 편입되어 탄소경영 최우수기업이라는 성과를 인정 받았습니다.

또한 탄소성과리더십지수(CPLI: Carbon Performance Leadership Index)에서도 선두 그룹을 의미하는 'Band A'에 편입되었으며, 협력사 저탄소 경영체제 구축을 위해 18개 협력사에 탄소경영 노하우를 공유하는 탄소파트너십 프로그램을 운영하는 등 다양한 활동을 전개하고 있습니다.

(3) 친환경제품을 위한 노력

[전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/Eco-efficiency/탄소성적]

하이닉스는 2010년 LCA 전산화 시스템을 구축하여 DRAM 및 Nand Flash 메모리 단품 제품의 환경영향평가를 수행하고 있습니다. 또한 2008년도에는 Eco-efficiency를 개발하여 각 제품별 환경성을 공개하고, 환경영향을 감소시키기 위한 지표로 활용하고 있습니다. 2011년은 DRAM과 Nand Flash 부문에서 성공적인 제품 개발 및 양산을 통해 목표인 3.00대비 13% 향상된 factor 3.39 을 달성하였습니다.

당사는 2012년 2월에 반도체 업계 최초로 30나노급 2Gb DDR3 제품에 대해 환경부로부터 저탄소 제품 인증을 획득하였습니다. 이는 2009년 탄소성적표지 최초 인증 이후 네 번째로 받은 인증으로

회사는 앞으로도 주요 DRAM 및 Nand Flash 제품에 대해 인증을 획득할 계획입니다.

(4) 기타 환경보호 정책

특별히 당사 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 내 각 분야별 전문가를 중심으로 환경경영검증위원회를 구성, 2009년 5월 환경경영검증위원회 보고서를 발행하여 당사 홈페이지 및 환경운동연합 홈페이지에 공개하였습니다. 2010년도에는 환경운동연합에서 추천한 국내 환경전문가와 함께 CEO환경경영자문회의를 개최하였으며 당사의 전반적인 환경경영 및 환경전략관련 의견을 수렴하여 당사 경영활동에 반영하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약 연결재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 :백만원)

구 분	제65기 1분기	제64기	제63기
[유동자산]	6,634,695	4,936,850	5,416,086
· 현금및현금성자산	2,691,104	1,243,788	1,253,226
· 단기금융상품	707,583	632,139	948,476
· 매출채권	1,572,139	1,540,925	1,604,952
· 재고자산	1,254,207	1,183,608	1,281,519
· 기타	409,661	336,389	327,913
[비유동자산]	12,629,665	12,301,298	11,996,031
· 지분법적용투자주식	111,199	103,613	98,163
· 매도가능금융자산	52,988	47,492	57,044
· 유형자산	11,224,263	10,899,308	10,590,580
· 무형자산	702,410	707,648	603,653
· 기타	538,805	543,237	646,591
자산총계	19,264,360	17,238,148	17,412,117
[유동부채]	4,688,708	4,817,286	5,349,559
[비유동부채]	4,677,404	4,545,591	4,154,982
부채총계	9,366,112	9,362,877	9,504,541
[지배기업 소유주지분]	9,898,873	7,875,742	7,905,923
· 자본금	3,487,768	2,978,498	2,969,023
· 자본잉여금	3,045,857	1,229,052	1,193,100
· 기타포괄손익누계액	75,355	107,107	△23,261
· 기타자본항목	5,762	5,762	5,762
· 이익잉여금	3,284,131	3,555,323	3,761,299
[비지배지분]	△625	△471	1,653
자본총계	9,898,248	7,875,271	7,907,576
매출액	2,388,389	10,395,811	12,106,090
영업이익	△259,981	325,474	2,975,271
연결총당기순이익	△271,223	△55,971	2,597,575

지배기업지분순이익	Δ271,119	Δ56,641	2,620,962
비지배주주지분순이익	Δ104	670	Δ23,387
기본주당순이익	Δ420원	Δ96원	4,440원
연결에 포함된 회사수	21개사	21개사	23개사

[Δ는 부(-)의 수치임]

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

※ 제65기의 연결재무상태표에 해당하는 부분은 2012년 3월 31일 기준이며, 연결포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2012년 3월 31일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

2. 연결재무제표 이용상의 유의점

가. 감사 의견

회사는 회계처리기준 및 연결재무제표준칙에 따라 회계처리하고 있으며, 회사가 작성한 연결재무제표에 대한 감사의견은 다음과 같습니다.

구분	제65기 1분기 (2012.01.01~ 2012.03.31)	제64기 (2011.01.01~ 2011.12.31)	제63기 (2010.01.01~ 2010.12.31)
감사인	삼일회계법인 대표이사 안 경 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태	한영회계법인 대표이사 권 승 화
감사의견	-	적정 의견	적정 의견

나. 연결재무제표의 작성기준 및 중요한 회계정책

(1) 작성기준

연결회사의 2012년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2012년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

제정·공표되었으나 2012년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정

동 개정 내용에 따르면, 보험수리적 손익에 대한 범위접근법의 적용이 더 이상 허용되지 않으며, 따라서 발생한 모든 보험수리적손익은 기타포괄손익으로 즉시 인식됩니다. 또한 제도의 변경에 따라 발생한 모든 과거근무원가를 즉시 인식하며, 이자원가와 사외적립자산에 대한 기대수익을 별도로 산출하던 것을 순확정급여부채(자산)에 확정급여채무의 측정에 사용한 할인율 적용하여 계산한 순이자비용(수익)을 산출하는 것으로 변경하였습니다. 동 개정 내용은 2013년 1월 1일 이후에 개시하

는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 회사는 상기의 개정 기준서의 적용에 따른 연결재무제표에 대한 영향을 파악 중입니다.

- 기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정' 제정

기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정'은 공정가치를 명확히 정의하고, 공정가치의 측정을 위한 체계 및 공시사항을 단일의 기준서에서 정하여 한국채택국제회계기준 적용시 일관성을 제고하고 복잡성을 감소시키기 위하여 제정되었습니다. 기업회계기준서 제1113호는 다른 기준서에서 이미 요구하거나 허용하는 사항 이외에 추가적으로 공정가치측정을 요구하지 않으며, 다른 기준서에서 공정가치 측정이 요구되거나 허용되는 경우 적용되는 지침을 제공합니다. 동 제정 내용은 2013년 1월 1일 이후에 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 회사는 상기의 제정 기준서의 적용이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 회계정책

중간연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정 평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

중간연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과부채및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를수도 있습니다.

중간연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다

다. 연결대상회사의 변동현황

사업 연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사	전기대비 연결에서 제외된 사유
제 65기	(주)하이닉스엔지니어링 (구, (주)아스텍)등 21개 사	-	-	-
제 64기	(주)하이닉스엔지니어링 (구, (주)아스텍)등 21개 사	-	현대디스플레이테크놀로지 ProMOS특정금전신탁	청산
제 63기	(주)하이닉스엔지니어링 (구, (주)아스텍)등 23개 사	-	-	-

※ 연결대상회사의 변동현황은 한국채택국제회계기준임.

라. 부문별 연결재무정보

(1) 사업부문별 연결재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하여 지배적 단일사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보

(가) 지역의 구분

지리적 근접도 및 경제활동의 유사성 등을 고려하여 본국(대한민국)과 미주, 중국, 아시아, 유럽(기타) 지역으로 구분하여 표시하였습니다.

(나) 공시대상 지역부문

본국(대한민국)과 미주, 중국, 아시아 지역을 공시대상 지역에 포함하였으며, 총매출액 또는 총자산의 10% 미만인 지역(유럽)은 공시대상 지역부문에서 제외하였습니다.

(다) 지역부문별 현황

- 1) 대한민국 : 반도체소자, 소프트웨어 개발 및 정보서비스 제공업 등 영위
- 2) 미주지역 : 반도체 판매, 비메모리 시스템의 제조 판매 및 연구개발업 등 영위
- 3) 아시아지역 : 반도체소자 판매업 등 영위

(라) 지역별 재무현황

(단위 : 백만원)

구분	제65기 1분기	제64기	제63기
본국(대한민국)			
1. 매출액			
외부매출액	167,878	709,569	795,664
지역간내부매출액	2,278,431	9,745,014	11,431,869
계	2,446,308	10,454,583	12,227,534
2. 영업이익	△285,118	513,073	3,126,309
3. 자산	18,500,650	16,526,560	16,222,392
미주			
1. 매출액			
외부매출액	915,053	3,346,611	3,283,021

지역간내부매출액	4,632	39,646	14,708
계	919,685	3,386,257	3,297,729
2. 영업손익	△3,688	3,094	16,092
3. 자산	857,363	824,293	897,614
중국			
1. 매출액			
외부매출액	367,794	1,770,690	1,626,510
지역간내부매출액	640,359	2,461,780	2,201,892
계	1,008,154	4,232,470	3,828,402
2. 영업이익	10,185	△240,991	△243,619
3. 자산	4,251,767	4,259,503	4,575,601
아시아			
1. 매출액			
외부매출액	707,987	3,480,037	4,868,301
지역간내부매출액	2,524	49,427	69,146
계	710,511	3,529,464	4,937,447
2. 영업이익	476	19,857	16,104
3. 자산	776,813	721,295	898,670
유럽			
1. 매출액			
외부매출액	229,677	1,088,904	1,532,593
지역간내부매출액	1,864	16,839	4,564
계	231,540	1,105,743	1,537,157
2. 영업손익	1,743	2,751	4,551
3. 자산	416,984	438,471	486,531
합계			
1. 매출액			
외부매출액	2,388,389	10,395,811	12,106,090
지역간내부매출액	2,927,809	12,312,706	13,722,180
계	5,316,198	22,708,517	25,828,269
2. 영업이익			
연결조정	16,422	27,690	55,834
계	△259,981	325,474	2,975,271
3. 자산			
연결조정	△5,539,217	△5,531,974	△5,668,692
계	19,264,360	17,238,148	17,412,117

[Δ는 부(-)의 수치임]

마. 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등

(단위:M\$)

구분	장비그룹	매각금액	적용연도	회계처리	
				별도기준	연결기준
(주)하이닉스반도체	MODULE	10	2011	담보부차입	담보부차입
(주)하이닉스반도체	PKG/PKT	177	2010	담보부차입	
Hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(HSMC)	PROBE TEST	128	2009	금융리스	
		315			

3. 요약 재무정보

가. 요약 별도재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제65기 1분기	제64기	제63기
[유동자산]	5,932,261	4,307,194	4,437,351
· 현금및현금성자산	2,415,705	980,359	960,046
· 단기금융상품	665,979	588,528	844,368
· 매출채권	1,454,514	1,417,886	1,389,394
· 재고자산	939,876	928,891	926,456
· 기타	456,187	391,530	317,088
[비유동자산]	12,421,453	12,086,716	11,622,574
· 지분법적용투자주식	2,989,863	2,989,863	3,001,328
· 매도가능금융자산	52,771	47,327	50,477
· 유형자산	8,242,641	7,902,653	7,277,397
· 무형자산	700,742	705,807	601,988
· 기타	435,436	441,066	691,384
자산총계	18,353,715	16,393,910	16,059,926
[유동부채]	4,246,147	4,496,983	4,618,003
[비유동부채]	3,871,201	3,693,866	3,219,211
부채총계	8,117,348	8,190,849	7,837,214

[자본금]	3,487,768	2,978,498	2,969,023
[자본잉여금]	3,084,060	1,267,257	1,231,064
[기타포괄손익누계액]	16,265	10,375	2,470
[기타자본항목]	5,762	5,762	5,762
[이익잉여금]	3,642,512	3,941,169	4,014,394
자본총계	10,236,367	8,203,061	8,222,712
매출액	2,367,709	10,188,162	11,973,426
영업이익	-286,389	511,517	3,128,368
당기순이익	-298,653	129,142	2,785,945
기본주당순이익	-463	218원	4,720원

[△는 부(-)의 수치임]

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

※ 제65기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2012년 3월 31일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2012년 3월 31일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

4. 재무제표 이용상의 유의점

가. 재무제표의 작성기준 및 중요한 회계정책

(1) 작성기준

회사의 2012년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제 1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2012년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

제정·공표되었으나 2012년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정

동 개정 내용에 따르면, 보험수리적 손익에 대한 범위접근법의 적용이 더 이상 허용되지 않으며, 따라서 발생한 모든 보험수리적손익은 기타포괄손익으로 즉시 인식됩니다. 또한제도의 변경에 따라 발생한 모든 과거근무원가를 즉시 인식하며, 이자원가와 사외적립자산에 대한 기대수익을 별도로 산출하던 것을 순확정급여부채(자산)에 확정급여채무의 측정에 사용한 할인율 적용하여 계산한 순이자비용(수익)을 산출하는 것으로 변경하였습니다. 동 개정 내용은 2013년 1월 1일 이후에 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 회사는 상기의 개정 기준서의 적용에 따른 재무제표에 대한 영향을 파악 중입니다.

- 기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정' 제정

기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정'은 공정가치를 명확히 정의하고, 공정가치의 측정을 위한 체계 및 공시사항을 단일의 기준서에서 정하여 한국채택국제회계기준 적용시 일관성을 제고하고 복

잡성을 감소시키기 위하여 제정되었습니다. 기업회계기준서 제1113호는 다른 기준서에서 이미 요구하거나 허용하는 사항 이외에 추가적으로 공정가치측정을 요구하지 않으며, 다른 기준서에서 공정가치 측정이 요구되거나 허용되는 경우 적용되는 지침을 제공합니다. 동 제정 내용은 2013년 1월 1일 이후에 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 회사는 상기의 제정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 회계정책

중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정 평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

중간재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과 부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

중간재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

IV. 감사인의 감사의견 등

1. 연결 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

가. 연결 감사인

제65기 1분기 (2012.01.01~ 2012.03.31)	제64기 (2011.01.01~ 2011.12.31)	제63기 (2010.01.01~ 2010.12.31)
삼일회계법인 대표이사 안 경 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태	한영회계법인 대표이사 권 승 화

나. 당해 사업연도의 연결감사절차 요약

1. 감사절차의 개요

본인은 에스케이하이닉스 주식회사(구, 주식회사 하이닉스반도체)와 그 종속기업의 분기 연결재무제표를 검토하였습니다. 동 분기 연결재무제표는 2012년 3월 31일 현재의 연결재무상태표, 2012년과 2011년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 연결포괄손익계산서와 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

경영자는 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 이 연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

본인의 책임은 상기 연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 대한민국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

2. 감사일정

□ 당기 감사: 2012. 04. 05 ~ 04. 20

다. 연결 감사의견

사 업 연 도	감사의견	지적사항 등 요약
---------	------	-----------

제65기 1분기	-	지적사항 없음
제64기	적정	지적사항 없음
제63기	적정	지적사항 없음

2. 회계감사인의 감사의견 등

가. 감사인

제65기 1분기 (2012.01.01~ 2012.03.31)	제64기 연간 (2011.01.01~ 2011.12.31)	제63기 연간 (2010.01.01~ 2010.12.31)
삼일회계법인 대표이사 안 경 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태	한영회계법인 대표이사 권 승 화

나. 당해 사업연도의 감사 절차 요약

1. 감사 절차의 개요

본인은 에스케이하이닉스 주식회사(구, 주식회사 하이닉스반도체)의 분기재무제표를 검토하였습니다. 동 분기재무제표는 2012년 3월 31일 현재의 재무상태표, 2012년과 2011년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 포괄손익계산서와 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

경영자는 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

본인의 책임은 상기 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 대한민국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

본인의 검토결과 상기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

2. 감사 일정

□ 당기 감사: 2012. 04. 05 ~ 04. 20

다. 감사 의견

사업연도	감사 의견	지적사항 등 요약
제65기 1분기	-	지적사항 없음
제64기	적정	지적사항 없음
제63기	적정	지적사항 없음

라. 감사인과의 감사용역계약 체결현황

(단위: 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내용	총소요시간	보수	비고
제65기	삼일회계법인	회계감사(연결포함)	12,940	695	
제64기	삼일회계법인	회계감사(연결포함)	12,940	695	
제63기	한영회계법인	회계감사(연결포함)	10,218	750	

마. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

(단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	내용	수행기간	보수	비고
제65기	2012.03	Cut off 감사 용역 계약서	2012.03~2013.03	295	
제64기	-	-	-	-	
제63기	2010.05	CB발행 Comfort Letter 작성	2010.04~05	150	

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시 작성지침에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성의 개요

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 5인의 사외이사 등 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회의 2개의 소위원회가 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회는 법령과 회사 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 또한 이사 및 경영진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다.

1. 상법상의 결의사항

- (1) 주주총회의 소집
- (2) 영업보고서의 승인
- (3) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인
- (4) 대표이사의 선임 및 해임
- (5) 공동대표의 결정
- (6) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
- (7) 신주의 발행
- (8) 사채의 모집
- (9) 준비금의 자본전입
- (10) 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행
- (11) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
- (12) 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임
- (13) 주식매수선택권의 부여 및 취소
- (14) 감사위원회를 제외한 위원회의 결의에 대한 수정 결의
- (15) 소규모 주식교환
- (16) 소규모합병 및 소규모분할합병
- (17) 회사 자산 및 매출액의 10분의 1 이하 규모의 영업양도의 결정
- (18) 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에서의 보고
- (19) 지배인의 선임 및 해임

2. 회사 경영에 관한 중요사항

- (1) 주주총회에 부의할 의안
- (2) 사업의 계획과 운영에 관한 사항
- (3) 회사의 예산·결산
- (4) 회사 자기자본 1.5%에 해당하는 금액 또는 1,000억원 중 많은 금액 이상의 신규투자 계획, 차입

(1년 이내의 단기 차입 제외), 채무의 보증, 출자, 자산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 (단, 자기 자본이라 함은 유가증권시장 공시규정상 자기자본을 의미함)

(5) <삭제 2012.3.5>

(6) 해외증권의 발행

(7) <삭제 1999.4.9>

(8) 각 위원회 규정 및 대표이사 위임사항의 제정, 개정 및 폐지

(9) <삭제 2012.3.5>

(10) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본 총계 중 큰 금액의 5% 이상이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 행위

단, 감사위원회에 3인 이상의 사외이사가 포함되고 사외이사 수가 위원 총수의 3분의 2 이상인 경우 감사위원회에 그 의결을 위임함

가. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래

나. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품·용역을 제공 또는 거래

(11) 회사 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정

3. 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

(2) 사외이사 현황

[제65기(2012), 2012년 2월 13일 임시주주총회 선임 이후]

(성명, 학력 및 경력, 최대주주등과의 이해관계, 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 등)

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고
김두경	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수(現)	해당사항 없음	-	-
박영준	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기공학부 교수(現)	해당사항 없음	-	-
윤세리	서울대 법학 학/석사 캘리포니아대 법학 박사 사법고시 20회 부산지검 검사 우방종합법무법인 변호사 법무법인율촌 대표 변호사(現)	해당사항 없음	-	-

김대일	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	해당사항 없음	-	-
이창양	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대 정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학원 교수(現)	해당사항 없음	-	-

[제64기(2011), 2011년 3월 30일 정기주주총회 선임 이후]

(성명, 학력 및 경력, 최대주주등과의 이해관계, 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 등)

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고
전인백	서울대학교 상과대학 경영학과 (주)하이닉스반도체 구조조정본부장 현대그룹 기획총괄본부장 현대유엔아이(주) 대표이사 하이닉스반도체 이사회 의장(現)	해당사항 없음	KIOD ADP 최고경영자과정 -주관: 한국이사협회 -일정: 9월 15일(목)~11월 17일(목) NACD Annual Conference 참가 -주관: 미국이사협회 -일정: 10월 1일(토)~10월 4일(화)	이사회 의장
한부환	서울대학교 법학과, 미국 하버드대 법학대학원(석사) 대전고등검찰청 검사장 법무부 차관 법무부 연수원 원장 법학전문대학원 평가위원회 위원장(現) 한부환법률사무소 변호사(現)	해당사항 없음	NACD Annual Conference 참가 -주관: 미국이사협회 -일정: 10월 1일(토)~10월 4일(화)	
백갑종	고려대학교 농경제학과 신원 기획조정실장/사장 한국농수산방송 대표이사 한양대학교 경영학부 겸임교수	해당사항 없음	2011 세계 감사인 대회 -주관: 세계감사협회 -일정: 7월 11일(월)~7월 13일(수)	
정병태	영남대학교 행정학과 미국 위스컨신대 대학원(공공정책학 석사) 재정경제부 국민생활국장 보건복지부 보건정책국장 BC카드(주) 대표이사	해당사항 없음	2011 NACD Director Professionalism Course -주관: 미국 기업이사협회 -일정: 8월 22일(월)~8월 23일(화)	

송재용	서강대학교 무역학과 고려대학교 경영대학원 경영학과 한국외환은행 독일법인장 한국외환은행 글로벌상품본부 본부장	해당사항 없음	2011 세계 감사인 대회 -주관: 세계감사협회 -일정: 7월 11일(월)~7월 13일(수)	
조현명	영남대학교 경영학과 경희대학교 경영대학원(경영학 박사) 감사원 제1사무차장 우리은행 상근감사위원	해당사항 없음	2011 세계 감사인 대회 -주관: 세계감사협회 -일정: 7월 11일(월)~7월 13일(수)	
이달곤	서울대학교 공과대학 미국 하버드 대학교 졸업(정책학 박사) 서울대학교 행정대학원 교수 국회의원 행정안전부 장관 서울대학교 초빙 교수(現)	해당사항 없음	ICGN Annual Conference 참가 -주관: 세계기업지배구조협회 -일정: 9월 12일(월)~9월 14일(수)	
김갑희	성균관대학교 철학과 신한은행 충청호남기업영업본부 영업본부장 신한은행 중부북한영업본부장 신한은행 인재개발부 교수	해당사항 없음	2011 NACD Director Professionalism Course -주관: 미국 기업이사협회 -일정: 8월 22일(월)~8월 23일(화)	
정상환	한국 외국어대학교 인도어과 한국 외국어대학교 대학원(신문방송학) 경기도지사 비서실장 (주)에이텍 부사장 학교법인 화산학원 이사(現)	해당사항 없음	KIOD ADP 최고경영자과정 -주관: 한국이사협회 -일정: 4월 5일(화)~6월 14일(화)	

※ 2011년 9월 15일, 정상환 사외이사 사임

- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 전략기획실 이사회지원팀

(담당자 : 김선민 책임 ☎ 02-3459-3617)

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함	
개최시기	정기 이사회	매분기 종료 후 45일 이내에 개최함
	임시 이사회	필요에 따라 수시로 개최함
소집권자	이사회 의장	
소집절차	회의일 2일전까지 각 이사에게 개최 시기, 장소 및 안건을 통지함. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다.	
결의방법	이사 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 함. 그러나, 법령 또는 정관으로 그 비율을 높게 정한 경우에는 법령 또는 정관의 규정을 따름	
부의사항	상법, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 회사에 관한 중요사항	

위 임	<p>다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 이사회내 위원회에 위임할 수 있음</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 위원회에 위임할 수 없음을 명시한 사항 <p>- 전항에 의하여 이사회가 이사회내 위원회에 위임할 사항은 해당 위원회 규정에서 정한다.</p>
의 사 록	<p>이사회 의사에 관하여 의사록을 작성함 (의사록에는 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명함)</p>

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 참석															
				한부환 (출석률: 100%)	백갑중 (출석률: 100%)	전인백 (출석률: 100%)	정병태 (출석률: 50%)	송재용 (출석률: 100%)	조현명 (출석률: 100%)	이달근 (출석률: 100%)	김강희 (출석률: 50%)	정상환 (출석률: 100%)	김두경 (출석률: 100%)	박영준 (출석률: 100%)	윤세리 (출석률: 100%)	김대일 (출석률: 100%)	이창양 (출석률: 100%)		
1	12.01.26	1. 2012년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	
		2. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	
2	12.02.01	1. 2011년(제64기) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	
		2. 제3차 배정 신주발행 주금납입기일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	
		3. 제64기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음
3	12.02.14	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 대표이사 선임의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	12.03.05	1. 제64기 정기주주총회 소집의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 이사회 규정 등 개정의 건	수정 가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	수정	수정	수정	수정	수정
5	12.03.28	1. 이사와 회사간의 거래 승인의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	12.05.04	1. 준법통제기준 제정 및 준법지원인 임명의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 이사와 회사 간의 거래 승인의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성	찬성
7	12.05.18	1. 차입 및 국내·외 사채 발행의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	[제64기] 사외이사 3명	백갑중(위원장) 송재용 조현명	"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조	-
	[제65기] 사외이사 3명	김두경(위원장) 김대일 이창양		
사외이사후보추천위원회	[제64기] 사외이사 2명 사내이사 1명	한부환(위원장) 정병태 권오철	"라. (2) 이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조	-
	[제65기] 사외이사 2명 사내이사 1명	박영준 윤세리 하성민		

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(가) 감사위원회

"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조

(나) 사외이사후보추천위원회

"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조

라. 이사의 독립성

당사의 이사는 총 9인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 5명입니다. 사외이사는 심층면접 및

사외이사후보추천위원회의 추천에 따라 주주총회에서 선임합니다.

(1) 이사회후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 경영참고사항 비치·공시 시(2012. 01. 27) 이사회 후보에 대한 인적사항 공시

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	비고
최태원 (1960.12.03)	SK 주식회사 대표이사 회장(現) SK 이노베이션 대표이사 회장(現) (주)하이닉스반도체 대표이사 회장(現)	이사회	없음	-
하성민 (1957.03.24)	SK 텔레콤 MNO Biz 사장 SK 텔레콤 대표이사 사장(現) (주)하이닉스반도체 이사회 의장(現)	이사회	없음	이사회 의장
권오철 (1958.07.18)	하이닉스반도체 CFO 재무기획담당 하이닉스반도체 전략기획실장 하이닉스반도체 대외협력실장 하이닉스반도체 중국생산법인(HSCL: Hynix-Semiconductor (China) Ltd.) 법인장 하이닉스반도체 중국생산법인(HSCL: Hynix-Semiconductor (China) Ltd.) 이사회 의장(現) 하이닉스반도체 대표이사 사장(現)	이사회	없음	2010.03.26 선임
박성욱 (1958.01.08)	하이닉스반도체 미국생산법인 담당 하이닉스반도체 메모리연구소장 하이닉스반도체 연구개발제조총괄본부장(現)	이사회	없음	
김두경 (1949.10.10)	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수(現)	사외이사후 보추천위원 회	없음	감사위원회 위원
박영준 (1952.11.17)	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기공학부 교수(現)	사외이사후 보추천위원 회	없음	
윤세리 (1953.11.20)	서울대 법학 학/석사 캘리포니아대 법학 박사 사법고시 20회 부산지검 검사 우방종합법무법인 변호사 법무법인올촌 대표 변호사(現)	사외이사후 보추천위원 회	없음	

김 대 일 (1962.08.18)	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	사외이사후 보추천위원 회	없음	감사위원회 위원
이 창 양 (1962.09.20)	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학원 교수(現)	사외이사후 보추천위원 회	없음	감사위원회 위원

- 경영참고사항 비치·공시 시(2011. 03. 15) 이사 후보에 대한 인적사항 공시

성 명 (생년월일)	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	비 고
전 인 백 (1948.03.20)	서울대학교 상과대학 경영학과 (주)하이닉스반도체 구조조정본부장 현대그룹 기획총괄본부장 현대유엔아이(주) 대표이사 하이닉스반도체 이사회 의장(現)	이사후보추천 위원회	없음	이사회 의장
권 오 철 (1958.07.18)	하이닉스반도체 CFO 재무기획담당 하이닉스반도체 전략기획실장 하이닉스반도체 대외협력실장 하이닉스반도체 중국생산법인(HSCL: Hynix- Semiconductor (China) Ltd.) 법인장 하이닉스반도체 중국생산법인(HSCL: Hynix- Semiconductor (China) Ltd.) 이사회 의장(現) 하이닉스반도체 대표이사(現)	이사회	없음	2010.03.26 선임
김종갑 (1951.08.10)	특허청장 산업자원부 제1차관 하이닉스반도체 대표이사 하이닉스반도체 이사회 의장	이사회	없음	2010.03.26 선임 2011.05.31 퇴임
박성욱 (1958.01.08)	하이닉스반도체 미국생산법인 담당 하이닉스반도체 메모리연구소장 하이닉스반도체 연구개발제조총괄본부장(現)	이사회	없음	2009.03.26 선임
김 민 철 (1954.05.31)	하이닉스반도체 구매실장 하이닉스반도체 재경실장(現)	이사회	없음	2010.03.26 선임

한 부 환 (1948.09.20)	서울대학교 법학과, 미국 하버드대 법학대학원(석사) 대전고등검찰청 검사장 법무부 차관 법무부 연수원 원장 법학전문대학원 평가위원회 위원장(現) 한부환법률사무소 변호사(現)	이사후보추천 위원회	없음	
백 갑 종 (1946.12.28)	고려대학교 농경제학과 신원 기획조정실장/사장 한국농수산방송 대표이사 한양대학교 경영학부 겸임교수	이사후보추천 위원회	없음	감사위원회 위원
정 병 태 (1952.08.25)	영남대학교 행정학과 미국 위스컨신대 대학원(공공정책학 석사) 재정경제부 국민생활국장 보건복지부 보건정책국장 BC카드(주)대표이사	이사후보추천 위원회	없음	
송재용 (1953.02.03)	서강대학교 무역학과 고려대학교 경영대학원 한국외환은행 독일법인장 한국외환은행 글로벌상품본부 본부장	이사후보추천 위원회	없음	감사위원회 위원
조 현 명 (1950.10.03)	영남대학교 경영학과 경희대학교 경영대학원(경영학 박사) 감사원 제1사무차장 우리은행 상근감사위원	이사후보추천 위원회	없음	감사위원회 위원
이달곤 (1953.09.11)	서울대학교 공과대학 미국 하버드 대학교 졸업(정책학 박사) 서울대학교 행정대학원 교수 국회의원 행정안전부 장관 서울대학교 초빙교수(現)	이사후보추천 위원회	없음	
김갑희 (1954.03.15)	성균관대학교 철학과 신한은행 충청호남기업영업본부 영업본부장 신한은행 중부북합영업본부장 신한은행 인재개발부 교수	이사후보추천 위원회	없음	
정상환 (1961.07.02)	한국 외국어대학교 인도어과 한국 외국어대학교 대학원(신문방송학) 경기도지사 비서실장 (주)에이텍 부사장 학교법인 화산학원 이사(現)	이사후보추천 위원회	없음	2011.09.15 퇴임

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

(가) 사외이사후보추천위원회 설치목적 및 권한사항

[설치목적]

관계법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하고 심사함.

[권한]

① 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정

(나) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

[제65기(2012), 2012년 2월 13일 임시주주총회 선임 이후]

성명	사외이사 여부	비고
박영준	○	- 사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8항 충족)
윤세리	○	
하성민	×	

[제64기(2011), 2011년 3월 30일 정기주주총회 선임 이후]

성명	사외이사 여부	비고
한부환	○	- 사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8항 충족)
정병태	○	
권오철	×	

(다) 사외이사후보추천위원회 활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명	
			한부환 (출석률: 100%)	정병태 (출석률: 50%)
			찬반 여부	
12.01.26	1. 임시주주총회에 대한 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성
	2. 임시주주총회에 대한 사내이사 심사의 건	가결	찬성	불참

마. 이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직의 현황

지원조직	구성	주요담당업무
이사회지원팀	직원 5명 (팀장 1명 포함)	- 이사회 및 소위원회 지원 - 이사직무활동 지원

(2) 사외이사 교육실적

교육일시	교육내용	교육주체
2012.03.15, 14:00	SKMS(SK Management System) (주)하이닉스반도체 사업현황 연구개발, 제조 소개 이사의 직무 및 이사회 운영 소개 공정 공시 등	이사회지원팀
2012.03.28, 14:00	생산라인 현장 방문	이사회지원팀

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사위원이 되는사외이사 3인(김두경, 김대일, 이창양)으로 구성되어 있습니다.

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

- 설치 여부 : 감사에 갈음하는 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치(정관 제48조)
- 권한과 책임 : 회계 및 업무에 대한 감사, 외부감사인의 선임 등
- 구성 방법 : 3인 이상의 이사로 구성(단 위원 총수의 2/3 이상을 사외이사로 구성)
위원장은 호선에 의하여 선임
- 회의 : 정기 위원회(매 분기 종료 후 45일 이내) 및 임시 위원회(필요에 따라 수시로)

나. 감사위원회의 인적사항

[제65기(2012), 2012년 2월 13일 임시주주총회 선임 이후]

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고
김 두 경	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수(現)	해당사항 없음	위원장
김 대 일	서울대 경제학 학사 시카고대 경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	해당사항 없음	-

이창양	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대 정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학원 교수(現)	해당사항 없음	-
-----	--	---------	---

[제64기(2011), 2011년 3월 30일 정기주주총회 선임 이후]

성명	주요경력	결격요건 여부	비고
백갑종	고려대학교 농경제학과 신원 기획조정실장/사장 한국농수산방송대표이사 한양대학교 경영학부 겸임교수	해당사항 없음	위원장
송재용	서강대학교 무역학과 고려대학교 경영대학원 경영학과 한국외환은행 독일법인장 한국외환은행 글로벌상품본부 본부장	해당사항 없음	-
조현명	영남대학교 경영학과 경희대학교 경영대학원(경영학 박사) 감사원 제1사무차장 우리은행 상근감사위원	해당사항 없음	-

다. 감사위원회의 위원의 독립성

당사는 감사위원회 3인 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 3인 중 최소 1인 이상의 회계 또는 재무전문가를 선임하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다.

- 감사위원회 규정 제3조

③ 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제12조(부의사항)

3. 감사에 관한 사항

(1) 업무·재산 조사

(2) 자회사의 조사

(3) 이사의 보고 수령

(7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

(8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수

- 감사위원회 규정 제13조 (관계인의 출석)

① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 경영진, 재무담당임원, 내부감사부서의 장 및 외부감사인 등을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.

② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제14조의7 (의견교환)

위원회는 감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 감사인과 회사의 내부통제제도 및 회사 재무제표의 정확성 등에 관하여 의견을 교환할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제16조 (내부감사부서의 설치)

① 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하는 전담 지원부서를 설치·운영 하거나 회사의 내부감사부서를 활용할 수 있다.

② 전담 지원부서 또는 내부감사부서의 장은 위원회의 명을 받아 회사 또는 자회사의 업무 또는 재산상태 등을 조사할 수 있다.

라. 감사위원회의 주요활동내역

회사	일자	의안	가결여부	사외이사의 성명					
				백갑중 (출석률 :100%)	송재용 (출석률 :100%)	조현명 (출석률 :100%)	김두경 (출석률 :100%)	김대일 (출석률 :100%)	이창양 (출석률 :100%)
				찬반여부					
1	12.01.30	1. 2011년 재무상태표·손익계산서·이익잉여금처분계산서(안)	보고	-	-	-	해당 없음	해당 없음	해당 없음
		2. 내부회계관리제도 운영실태평가	가결	찬성	찬성	찬성	해당 없음	해당 없음	해당 없음
		3. 임시주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당 없음	해당 없음	해당 없음
2	12.03.15	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성
		2. 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성
		3. 감사보고서 승인의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성
3	12.03.28	1. 계열회사 대상 내부거래 한도 승인의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성
4	12.04.25	1. 경영진단업무 소개 및 2012년 업무계획	보고	해당 없음	해당 없음	해당 없음	-	-	-

2. SK(주)와의 브랜드 사용 계약 승인의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성
3. 내부 감사부서 책임자 임명의 건	가결	해당 없음	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성	찬성

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있으며, 집중투표제나 서면투표제, 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 또한 본 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단의 개요

- 명 칭 : SK계열

(2) 관련법령상의 규제내용 등

1) "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 상 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○
지정시기 : 1987년

- 규제내용 요약
 - 기업결합의 제한
 - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등
 - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시
 - 기업집단 현황 공시 등

2) "은행법"상 동일인 및 동일차주 신용공여한도 관리 대상 기업집단

- 규제내용 요약
 - 동일인 신용공여한도 : 금융기관 자기자본의 20%
 - 동일차주 신용공여한도 : 금융기관 자기자본의 25%

3) "은행감독규정"상 주채권은행 선정 대상 기업집단

- 규제내용 요약
 - 주채권은행 지정

(3) 관계회사간 출자현황

\ 피투자회사 투자회사	SK(주)	SK이노베이션	SK에너지	SK종합화학	SK텔레콤	SK네트웍스	SKC	SK건설	SK해운	SK증권
SK(주)		33.4%			25.2%	39.1%	42.5%	40.0%	83.1%	
SK이노베이션			100.0%	100.0%						
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스										22.7%
SK텔레콤										
SK케미칼						0.02%		25.4%		
SKC										
SK건설										
SK가스										
SK C&C	31.8%									
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK마케팅앤컴퍼니										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛										
SK하이닉스										
하이닉스엔지니어링										
계열사 계	31.8%	33.4%	100.0%	100.0%	25.2%	39.2%	42.5%	65.4%	83.1%	22.7%

\ 피투자회사 투자회사	SK E&S	SK가스	대한송유관	충청에너지	영남에너지	코원에너지	에스케이 사이텍	SK텔레콤	부산도시가스	전남도시가스
SK(주)	94.1%									
SK이노베이션			41.0%							
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤								83.5%		
SK케미칼		45.5%					50.0%			
SKC										
SK건설										
SK가스										
SK C&C	5.9%									
SK E&S				100.0%	100.0%	82.2%			40.0%	100.0%
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK마케팅앤컴퍼니										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛										
SK하이닉스										
하이닉스엔지니어링										
계열사 계	100.0%	45.5%	41.0%	100.0%	100.0%	82.2%	50.0%	83.5%	40.0%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	강원도시가스	전북에너지	영앤서비스	SK와이변스	인포섹	행복나래	SK텔레시스	엔카네트워크	에프앤유신용 정보	팍스넷
SK(주)										
SK이노베이션						42.5%				
SK에너지								0.0%		
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤				100.0%		42.5%			50.0%	
SK케미칼										
SKC							47.5%			
SK건설										
SK가스						5.0%				
SK C&C					100.0%	5.0%		91.7%		
SK E&S	100.0%	100.0%								
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK마케팅앤컴퍼니			100.0%							
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛										59.7%
SK하이닉스										
하이닉스엔지니어링										
계열사 계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.0%	47.5%	91.7%	50.0%	59.7%

\ 피투자회사 투자회사	SK디앤디	내트럭	로엔엔터테인먼트	인디펜던스	SK모바일 에너지	SK유휘	SK커뮤니케이 션즈	SK네트웍스인 터넷	SK에어가스	SK네트웍스 서비스
SK(주)										
SK이노베이션					100.0%					
SK에너지		92.4%								
SK종합화학						100.0%				
SK네트웍스								100.0%		85.0%
SK텔레콤										
SK케미칼										
SKC									80.0%	
SK건설	45.0%									
SK가스										
SK C&C				100.0%						
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK마케팅앤컴퍼니										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛			67.6%				64.6%			
SK하이닉스										
하이닉스엔지니어링										
계열사 계	45.0%	92.4%	67.6%	100.0%	100.0%	100.0%	64.6%	100.0%	80.0%	85.0%

\ 피투자회사 투자회사	커머스플래닛	리얼베스트	SKC솔믹스	SK브로드밴드	SK M&C	브로드밴드미 디어	브로드밴드 D&M	브로드밴드CS	유비케어	평택에너지 서비스
SK(주)										
SK이노베이션					50.0%					
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤				50.6%	50.0%					
SK케미칼									44.0%	
SKC			53.7%							
SK건설		100.0%								
SK가스										
SK C&C										
SK E&S										100.0%
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드						100.0%	100.0%	100.0%		
SK D&D										
SK마케팅앤컴퍼니										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛	100.0%									
SK하이닉스										
하이닉스엔지니어링										
계열사 계	100.0%	100.0%	53.7%	50.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	44.0%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	WS통상	인싸이도	남원사랑발전 소	제주유나이티 드 FC	MKS개런티	PS&마케팅	SK임업	그린바이로	SK루브리컨츠	지코스
SK(주)										
SK이노베이션									100.0%	
SK에너지				100.0%						
SK종합화학										
SK네트웍스	100.0%									
SK텔레콤						100.0%				
SK케미칼										
SKC		100.0%								
SK건설							100.0%			
SK가스								100.0%		
SK C&C										
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D			100.0%		100.0%					
SK마케팅앤컴퍼니										
SK루브리컨츠										100.0%
SK해운										
SK플래닛										
SK하이닉스										
하이닉스엔지니어링										
계열사 계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	에스케이신텍	대전광은물	광주광은물	에스케이더블 유	텔레비전미디 어코리아	네트워크앤에 스	서비스에이스	서비스탑	SK핀크스	유베이스에 뉴랙처링아 시아
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스									100.0%	
SK텔레콤						100.0%	100.0%	100.0%		
SK케미칼	100.0%									
SKC				65.0%						
SK건설		32.0%	42.0%							
SK가스										
SK C&C										
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK마케팅앤컴퍼니										
SK루브리컨츠										100.0%
SK해운										
SK플래닛					51.0%					
SK하이닉스										
하이닉스엔지니어링										
계열사 계	100.0%	32.0%	42.0%	65.0%	51.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	내트렉프랜즈	울산아로마틱 스	SK바이오팜	서비스인	SKC라이팅	김천에너지	SK에스엠	피엠피	엘씨앤씨	스피드모터 스
SK(주)			100.0%							
SK이노베이션										
SK에너지	50.0%									
SK종합화학		50.0%								
SK네트웍스									79.6%	100.0%
SK텔레콤										
SK케미칼										
SKC					65.0%					
SK건설										
SK가스										
SK C&C										
SK E&S						50.0%		100.0%		
SK커뮤니케이션즈				100.0%						
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK마케팅앤컴퍼니										
SK루브리컨츠										
SK해운							100.0%			
SK플래닛										
SK하이닉스										
하이닉스엔지니어링										
계열사 계	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	65.0%	50.0%	100.0%	100.0%	79.6%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	SK플래닛	하이웨이스타	SK하이닉스	하이닉스 엔지니어링	하이스텍	하이로지텍	하이닉스 인재개발원	큐알티반도체	실리콘화일	아미파워
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지		100.0%								
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤	100.0%		21.1%							
SK케미칼										
SKC										
SK건설										
SK가스										
SK C&C										
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK마케팅앤컴퍼니										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛										
SK하이닉스				99.6%	99.6%	99.6%	99.6%		29.7%	99.6%
하이닉스엔지니어링								100.0%		
계열사 계	100.0%	100.0%	21.1%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	100.0%	29.7%	99.6%

※ 사명 변경 : 코원에너지서비스(주) (舊 대한도시가스(주)), 울산아로마틱스(주) (舊 아로케미(주)),
 행복나래주식회사 (舊 엠알오코리아(주))

(4) 계열회사 관리조직 현황

[하이닉스엔지니어링, 하이스텍, 하이로지텍, 하이닉스인재개발원, 큐알티반도체, 아미파워]

당사는 상기 계열회사들과 특별약정을 체결하고 있으며, 총무팀에서 당사를 대표하여 대주주로서의 역할을 담당하고 있습니다. 각 계열회사의 경영상 의사결정은 자체적인 이사회 의결을 원칙으로 하 되, 경영계획, 이사 및 경영진 임면 등 주요 경영 사항과 관련해서는 특별약정에 의거하여 당사와 사 전 협의하도록 하고 있습니다. 당사의 총무팀은 회사를 대표하여 이들 계열회사들에 상기 특별약정 에 의거한 대주주로서의 의사표시를 하고 있습니다. 한편, 당사와 동 계열회사간의 서비스도급계약 은 다른 일반 계약과 상이하지 않게 진행하고 있습니다.

[실리콘화일]

당사는 CIS(CMOS 이미지 센서)사업에 진출하면서 보다 빠른 시일내에 사업경쟁력을 확보하기 위해 , 설계 경쟁력을 갖추고 있는 국내 팹리스 업체인 실리콘화일과 2007년 11월에 CIS 기술공동개발,

판권허여 및 파운드리 협력계약을 체결하였고, 2008년 8월에는 협력관계를 보다 강화하기 위해 주
 식인수를 통하여 실리콘화일의 경영권을 확보한 바 있습니다. 또한, 2009년 9월에는 공간적 통합을
 통한 개발 효율성 및 성과 극대화 도모를 위해 CIS 사업 협력 강화를 위한 합의서를 체결하였습니다.

본 보고서 제출일 현재 당사는 최대주주로서 실리콘화일과 특별약정을 체결하고, 1인의 이사를 선임
 하여 경영계획, 이사 및 경영진 임면 등 주요 경영 사항과 관련하여 당사와 사전에 협의토록 하고 있
 으며, 계약 관계 및 기타 이사회 관련 사항 등 경영 사안에 대해 조정하고 있습니다.

[SKHYA, SKHYD, SKHYU, SKHYJ, SKHYS, SKHYIS, SKHYH, SKHYT, SKHYCS, SKHYCW]

당사의 상기 계열회사들은 "Distribution Agreement"에 의해 당사의 해외 법인으로서 판매행위를 대
 행하며, 이에 계열회사 운영에 필요한 운영전반에 대해 본사의 지원을 보장 받습니다. 계열회사는
 본사 조직으로 구성, 운영되며 각 기능상의 소속본부에서 각 업무를 관장합니다. 계열회사의 판매
 및 마케팅 활동 등 영업활동에 필요한 제반항목에 대해 본사의 마케팅관리팀이 커뮤니케이션 창구
 로서의 지원 업무를 수행하며 영업과 무관한 고유업무는 해당기능의 본부에서 관할합니다.

(5) 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

[제출일 현재]

겸직임원		겸직 계열회사		비 고
성 명	직 위	회 사 명	상근여부	
최 태 원	대표이사/회장	SK(주)	상근	-
		SK이노베이션(주)	상근	-
		SK C&C(주)	상근	-
하 성 민	이사회 의장	SK텔레콤(주)	상근	-
권 오 철	대표이사/사장	SK hynix America Inc.	비상근	-
		SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	비상근	-

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2012년 03월 31일)

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일 자	출 자 목 적	최초취 득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분 율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
(주)하이닉스엔지니어링	2001.07.05	경영 참가	14,952	671,932	99.65	15,074	0	0	0	671,932	99.65	15,074	40,485	4,737
(주)하이스텍	2008.03.15	경영 참가	4,172	236,408	99.65	5,127	0	0	0	236,408	99.65	5,127	16,608	1,572
아이파워(주)	2010.01.26	경영 참가	13,816	524,852	99.65	13,816	0	0	0	524,852	99.65	13,816	59,607	-10,000

(주)실리콘화일	2008.08.12	경영 참가	22,835	2,358,832	29.69	8,138	0	0	87	2,358,832	29.69	8,225	38,988	1,552
(주)하이닉스인재개발원	2008.03.15	경영 참가	1,195	59,102	99.65	1,169	0	0	0	59,102	99.65	1,169	2,534	200
(주)하이로지텍	2008.03.15	경영 참가	441	39,401	99.65	431	0	0	0	39,401	99.65	431	2,963	603
SK hynix America Inc. (SKHYA)	1983.03.15	경영 참가	1,231,196	6,285,587	97.74	31	0	0	0	6,285,587	97.74	31	764,593	7,185
Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc.(HSMA)	2004.07.09	경영 참가	98	100,000	0.05	0	0	0	0	100,000	0.05	0	59,700	-11,184
SK hynix Deutschland GmbH.(SKHYD)	1989.03.01	경영 참가	80,956	출자증서	100.0	22,011	0	0	0	출자증서	100.00	22,011	132,495	1,816
SK hynix Europe Holding Ltd.(SKHYE)	1995.04.27	경영 참가	446,766	335,640.00	100.0	1,811	0	0	0	335,640.00	100.00	1,811	214,829	0
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)	1991.09.12	경영 참가	137,531	196,303.50	100.0	52,380	0	0	0	196,303.50	100.00	52,380	135,026	5,868
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd. (SKHYH)	1995.04.27	경영 참가	223,233	170,693.661	100.0	38,468	0	0	0	170,693.661	100.00	32,624	240,633	5,195
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(SKHYCS)	2006.06.29	경영 참가	6,357	출자증서	100.0	6,050	0	0	0	출자증서	100.00	4,032	23,125	1,841
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	1996.09.16	경영 참가	81,587	20,000	100.0	43,297	0	0	0	20,000	100.00	42,905	264,567	983
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc. (SKHYT)	1996.09.16	경영 참가	13,330	35,725.00	100.0	24,958	0	0	0	35,725.00	100.00	37,562	321,079	6,749
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(SKHYIS)	2007.03.29	투자	5	270	100	5	0	0	0	270	1.00	5	623	20
SK hynix Semiconductor (China) Ltd. (SKHYCL)	2005.06.30	경영 참가	1,866,810	출자증서	90.26	2,421,631	0	0	0	출자증서	90.26	2,421,631	3,732,468	-
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	2006.04.17	경영 참가	47,384	출자증서	100.0	238,271	0	0	0	출자증서	100.00	238,271	262,395	1,367
Hitech Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(HITECH)	2009.11.17	경영 참가	90,150	출자증서	45.00	95,475	0	0	7,499	출자증서	45.00	102,974	593,210	22,659
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	2010.07.29	경영 참가	237	출자증서	100.0	237	0	0	0	출자증서	100.00	237	883	-20
현대정보기술주	1994.03.24	투자	3,481	1,160,180	2.30	2,593	0	0	493	1,160,180	2.30	3,086	169,293	379
현대아이비티주	2007.03.23	출자 전환	63	25,286	0.03	3	-22,758	0	4	2,528	0.03	7	37,586	-18,301
(주)피델릭스	2008.04.18	투자	3,560	1,605,854	8.79	3,099	0	0	177	1,605,854	8.79	3,276	63,193	3,056
(주)씨앤에스테크놀로지	2008.09.03	투자	4,508	1,031,590	3.91	4,394	0	0	-1,005	1,031,590	3.91	3,389	67,395	-13,146

(주)아이테스트	2006.03.13	투자	1,166	481,780	1.04	1,604	0	0	-154	481,780	1.04	1,450	181,486	9,415
현대로지스틱스(주)	1995.10.16	투자	76	15,115	0.08	98	0	0	0	15,115	0.08	98	616,534	-92,449
(주)이큐베스텍	2002.01.18	투자	10	2,000	1.67	10	0	0	0	2,000	1.67	10	4,731	24
노벨리스코리아㈜	2005.09.09	투자	1,699	63,600	0.14	1,699	0	0	0	63,600	0.14	1,699	1,104,694	146,784
Anobit Technologies Ltd.	2008.07.14	투자	3,123	204,248	2.28	3,123	-	-3,123	0	0	0.00	0	27,658	-19,989
Phison Electronics Corp.	2008.07.16	투자	11,661	3,277,054	1.83	22,804	0	0	9,053	3,277,054	1.83	31,857	569,687	69,348
특정금전신탁	2008.11.17	투자	21,847	201,600,000	7.93	0	0	0	0	201,600,000	7.93	0	1,867,150	-756,385
인텔렉추얼디스커버리	2011.05.13	투자	4,000	800,000	11.41	4,000	0	0	0	800,000	11.41	4,000	35,455	-6,343
기타	-	투자	19,032	0	0.00	2	0	0	0	0	0.00	2	-	-
합 계						3,036,160	-	-3,123	16,154			3,049,191		

※ 평가손익은 지분법 평가 등 금전의 수수를 수반하지 않는 증가/감소 포함임

※ 최근 사업년도 재무현황은 2011년말 실적이며, 미공시 법인은 2011년 9월말 재무제표를 반영

※ 기타 항목은 손상차손 및 출자전환 주식으로 장부가액이 감소한 법인들을 표시함

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

[제출일 현재]

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기초		기말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
에스케이텔레콤(주)	최대주주	보통주	146,100,000	21.05	146,100,000	21.05	유상증자 참여 / 구주지분 인수
최신원	특별관계자	보통주	5,000	0.00	5,000	0.00	장내매수
권오철	특별관계자	보통주	13,500	0.00	13,500	0.00	장내매수
박성욱	특별관계자	보통주	1,394	0.00	1,394	0.00	장내매수
계		보통주	146,119,894	21.05	146,119,894	21.05	-
		우선주	0	0.00	0	0.00	
		합계	146,119,894	21.05	146,119,894	21.05	

최대주주명 : 에스케이텔레콤(주)

특수관계인의 수 : 3명

(주1) 상기 에스케이텔레콤(주)의 보유내역은 주식관리협회의 구주지분 44,250,000주 인수 및 제3자배정 유상증자 참여 주식 101,850,000주를 합산한 것임.

(주2) 최대주주(법인)에 대한 개요

에스케이텔레콤은 정보통신업, 단말기 매매 및 임대업, 뉴미디어사업 등을 영위하는 사업자로 1984년 3월 29일 설립되었습니다. 에스케이텔레콤은 단말, 요금제, 네트워크, 콘텐츠등의 본원적 경쟁력을 기반으로 이동통신 서비스를 제공하고 있으며 LTE 상용화를 통해 기존에 유선 네트워크에서 가능했던 고품질의동영상 서비스 및 멀티미디어 게임 등 다양한 신규서비스가 무선 환경에서도 활성화될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2012년 3월 23일 정기주주총회 기준 에스케이텔레콤의 등기임원은 총 8명으로 사내이사 3명(김영태, 하성민, 지동섭), 사외이사 5명(임현진, 심달섭, 엄낙용, 정재영, 조재호)으로 구성되어 있습니다.

- 등기임원 현황

이름	약력
김영태	- SK에너지(주) Top Team Coordinator(前) - SK에너지(주) 울산CLX부문장(前) - SK(주) 기업문화부문장(前) - SK(주) 사장(現)
하성민	- SK텔레콤 경영기획실장(前) - SK텔레콤 경영지원부문장(前) - SK텔레콤 MNO Biz 사장(前) - SK텔레콤 대표이사/사장(現)
지동섭	- SK(주) 기업문화부문장(前) - SK텔레콤 IPE 사업단장(前) - SK텔레콤 MNO기획실장(前) - SK텔레콤 미래경영실장(現)
임현진	- 서울대학교 사회과학대학 학장(前) - 제48대 한국사회학회 회장(前) - 서울대학교 사회과학대학 사회학과 교수(現) - 서울대학교 아시아연구소 소장(現)
심달섭	- 주미국대사관 재정경제관(前) - 신용보증기금 상근 감사(前) - 한국기술투자(주) 상근 감사(前) - 세계경제연구원 초빙연구원(前)
엄낙용	- 한국산업은행 총재(前) - 제2대 재정경제부 차관(前) - 제16대 관세청장(前) - 중앙대학교 초빙교수(現)
정재영	- 성균관대학교 경영학부 교수(前) - 한국국제통상학회 회장(前) - 성균관대학교 인문사회과학캠퍼스 부총장(前) - 성균관대학교 명예교수(現)
조재호	- 뉴욕시립대 바루크대학 교수(前) - 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원장(現) - 학교법인 경희학원 재단이사(現) - 서울대학교 경영대학 경영학과 교수(現)

- 재무현황

(단위: 백만원)

구분	2011년말	2010년말
자산총계	24,442,166	23,132,389
부채총계	11,702,840	10,724,390

자본총계	12,739,325	12,407,999
영업이익	2,134,959	2,777,327
당기순이익	1,582,589	1,766,835

나. 최대주주의 변동 현황

[제출일 현재]

(단위 : 주, %)

최대주주명	사업연도	지분변동일	소유주식수	지분율(%)	변동 사유
(주)한국외환은행	2007	-	37,742,000	8.2	-
	2008	-	37,742,000	8.2	-
	2009	2009.01.17	37,742,000	7.3	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
		2009.05.19	37,742,000	6.4	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
한국정책금융공사	2010	2010.03.16	32,412,935	5.5	변경 전 최대주주의 지분매각
미래에셋자산운용투자자문(주)		2010.03.19	35,362,056	6.0	장내 매수/매도
		2010.05.04	44,041,030	7.46	장내 매수/매도
한국정책금융공사		2010.08.03	32,412,935	5.50	변경 전 최대주주의 지분매각
국민연금공단	2010	2010.10.11	35,894,454	6.08	장내 매수/매도
		2011	2011.01.10	47,786,668	8.10
	2011.04.11		53,774,325	9.11	장내 매수/매도
	2011.07.08		47,838,426	8.08	장내 매수/매도
	2011.10.07	54,202,391	9.15	장내 매수/매도	
에스케이텔레콤(주)	2012	2012.02.15	146,100,000	21.05	유상증자 참여 및 구주 지분 인수
		2012.02.23	146,105,000	21.05	특별관계자 추가
		2012.04.02	146,119,894	21.05	계열편입에 따른 특별관계자 추가

2. 주식의 분포

가. 5%이상 주주의 주식소유 현황

[제출일 현재]

(단위 : 주, %)

순위	성명(명칭)	보통주		우선주		소계		비고
		주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	
1	에스케이텔레콤(주)	146,119,894	21.05	-	-	146,119,894	21.05	(주1)
2	국민연금공단	56,060,192	8.08	-	-	56,060,192	8.08	(주2)
합 계		202,180,086	29.13	-	-	202,180,086	29.13	

(주1) 상기 에스케이텔레콤(주)의 보유내역은 주식관리협회의 구주지분 44,250,000주 인수 및 제3자배정 유상증자 참여 주식 101,850,000주와 특별관계자의 보유주식 19,894주를 합산한 것임.

(주2) 상기 국민연금공단의 보유내역은 2012년 4월 10일자 주식등의 대량보유상황보고서 기준임.

나. 주주 분포

[실질주주기준]

2011년 12월 31일 현재

구 분	주주수	비 율	주식수	비 율	비 고
소액주주 합계	392,037	99.99	446,474,102	75.39	-
소액주주(법인)	2,139	0.54	145,943,570	24.64	-
소액주주(개인)	389,898	99.45	300,530,532	50.75	-
최대주주등	1	0	27,820,453	4.69	-
주 요 주 주	0	0	0	0	-
기타주주 합계	9	0	117,877,027	19.90	-
기타주주(법인)	6	0	97,054,343	16.38	-
기타주주(개인)	3	0	20,822,684	3.51	-
합 계	392,047	100.00	592,171,582	100.00	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2011년 12월 31일 기준임.

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
------------------	---

	<p>② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 신주를 인수하게 하는 경우 <개정 2009.3.26> 2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하게 하는 경우 <개정 2009.3.26> 3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 <개정 2009.3.26> 4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 <개정 2009.3.26> 5) 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 <개정 2000.3.24, 2009.3.26> 6) 자금조달, 기술도입 기타 경영상 필요로 국내외 금융 기관 (여기서 '금융기관'이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항의 전문투자자를 의미하되, 동항 제4호의 주권상장법인, 동법 시행령 제10조 제3항 제16호 및 제17호의 법인, 단체 또는 개인은 포함하지 아니한다), 제휴법인, 전략적 투자자 또는 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 <개정 1999.3.26, 2001.3.29, 2009.3.26, 2010.3.26> 7) 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우 8) 회사가 "경영상 필요로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 제1항 제2호 가목 내지 다목의 자"에게 신주를 발행하는 경우 [신설 1999.3.26] <개정 2009.3.26> 9) 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우[신설 1999.3.26] 10) 근로자복지기본법의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 [신설 2006.3.28] <p>③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.</p>		
결산일	12월 31일	정기주주총회	3월중
주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지		
주권의 종류	일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권 (8종)		
명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 여의도동 43-2)		
주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지게재<개정 2012.03.23>

4. 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 천주)

종류		'12년 3월	'12년 2월	'12년 1월	'11년 12월	'11년 11월	'11년 10월
보통주	최고주가	30,550	30,200	27,450	23,450	24,850	24,150

	최저주가	28,800	25,400	23,450	20,750	21,500	20,000
	평균주가	29,667	27,862	25,208	22,031	22,864	22,248
거래량	최고일거래량	9,809	20,809	12,170	9,393	23,467	17,939
	최저일거래량	2,568	4,713	3,566	2,297	4,434	4,354
	월간거래량	106,528	186,338	147,348	127,788	220,815	175,459

※ 주가는 일별 증가 기준임.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 룩셈부르크]

(단위 : USD, DR)

종류		'12년 3월	'12년 2월	'12년 1월	'11년 12월	'11년 11월	'11년 10월
GDR	최고	-	-	-	-	-	-
	최저	-	-	-	-	-	-
월간거래량		-	-	-	-	-	-

※ GDR의 거래량은 미미하며, 장외비중이 크므로 거래량의 정확한 산정이 어려워 기재를 생략함.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(1) 등기임원의 현황

[제65기]

(단위 : 주)

성명	출생 연월	직위	등기임 원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료 일
							보통 주	우선 주		
최태 원	1960. 12	회장	등기임 원	상근	대표이사	SK주식회사 대표이사 회장(現) SK이노베이션 대표이사 회장(現) SK C&C 이사(現) SK하이닉스 대표이사 회장(現)	-	-	선임 (12.02.14)	-
하성 민	1957. 03	이사회 의장	등기임 원	상근	이사회 의장	SK텔레콤 MNO Biz 사장 SK텔레콤 대표이사 사장(現) SK하이닉스 이사회 의장(現)	-	-	선임 (12.02.14)	-
권오 철	1958. 07	사장	등기임 원	상근	대표이사	서울대학교 무역학과 SK하이닉스 CFO 재무기획담당 SK하이닉스 전략기획실장 SK하이닉스 대외협력실장 SK하이닉스 중국생산법인(SKHYCL) 법인장 SK하이닉스 중국생산법인(SKHYCL) 이사회 의장 (現) SK하이닉스 대표이사 사장(現)	13,5 00	-	선임 (06.03.28) 중임 (09.03.26,1 0.03.26)	-
김두 경	1949. 10	사외이 사	등기임 원	비상 근	감사위원회 위원	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수(現)	-	-	선임 (12.02.14)	-
박영 준	1952. 11	사외이 사	등기임 원	비상 근	사외이사후 보 추천위원회 위원	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기공학부 교수(現)	-	-	선임 (12.02.14)	-

윤세리	1953.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사후보추천위원회 위원	서울대 법학 학/석사 캘리포니아대 법학 박사 사법고시 20회 부산지검 검사 우방종합법무법인 변호사 법무법인올촌 파트너 변호사(現)	-	-	선임 (12.02.14)	-
김대일	1962.08	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	-	-	선임 (12.02.14)	-
이창양	1962.09	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장	-	-	선임 (12.02.14)	-
박성욱	1958.01	부사장	등기임원	상근	연구개발총괄	한국과학기술원(KAIST) 재료공학 박사 하이닉스반도체 연구개발제조총괄	1,394	-	선임 (09.03.26) 중임 (12.02.14)	-

※ 등기임원의 담당업무 및 소유주식현황은 제65기 1분기보고서 제출일 기준임.

(2) 등기임원의 겸직 현황

[제출일 현재]

겸직임원		겸직회사		비고
성명	직위	회사명	직위	
최태원	대표이사/회장	SK(주)	대표이사/회장	
		SK이노베이션(주)	대표이사/회장	
		SK C&C(주)	이사	
하성민	이사회 의장	SK텔레콤(주)	대표이사/사장	
권오철	대표이사/사장	SK hynix America Inc.	이사	
		SK hynix China Ltd.	이사	
김두경	사외이사	주식회사 전북은행	사외이사	
이창양	사외이사	Tokai Carbon Korea	사외이사	

(3) 미등기 임원 현황(제출일 현재)

직명	등기임원	성명	생년월일	약력	담당업무	소유주식수	비고
----	------	----	------	----	------	-------	----

보통주	우선주
-----	-----

부사장 (상근)	미등기임 원	박상훈	55.04.29	KAIST(화공) 박사 SK바이오팜 대표이사 사장	제조총괄	-	-	
부사장 (상근)	미등기임 원	김준호	57.08.28	고려대(법학) 학사 SK텔레콤 Corporate Center장	CorporateCenter 총괄 겸> SKMS실장	-	-	
부사장 (상근)	미등기임 원	윤상균	49.09.26	연세대(영어영문) 학사 HSJ 법인장	대표이사 자문역	-	-	
부사장 (상근)	미등기임 원	백동원	55.03.14	고려대(재료공학) 석사 품질보증실장	PKG&TEST제조본부장	938	-	
전무 (상근)	미등기임 원	한성규	58.10.27	경북대(전자) 학사 제조본부장	M8사업부장	15,453	-	
전무 (상근)	미등기임 원	김지범	58.10.16	KAIST(재료공학) 석사 마케팅본부 Application마케팅담당	마케팅본부장	3,338	-	
전무 (상근)	미등기임 원	고요환	60.07.23	KAIST(전자) 박사 Flash개발본부장	품질보증실장	10,000	-	
전무 (상근)	미등기임 원	김동균	57.11.05	고려대(재료) 학사 구매실장	FAB제조본부장	-	-	
전무 (상근)	미등기임 원	김용탁	58.09.25	성균관대(전자) 학사 DRAM개발사업부 Mobile담당	DRAM개발본부장	17,548	-	
전무 (상근)	미등기임 원	한광마	58.11.26	성균관대(전기) 학사 경영전략실 대외협력그룹장	전략기획실장	-	-	
전무 (상근)	미등기임 원	홍성주	62.11.06	KAIST(물리학) 박사 연구소 소자그룹장	연구소장	6,842	-	
전무 (상근)	미등기임 원	배기현	58.11.16	경북대(전자) 학사 Anobit	Flash개발본부장	-	-	
전무 (상근)	미등기임 원	길인	57.10.25	한양대(경제) 학사 SK차이나	기업문화실장	-	-	
전무 (상근)	미등기임 원	송현중	65.11.23	M.I.T(경영) 석사 SK텔레콤	미래전략실장	-	-	
전무 (상근)	미등기임 원	진정훈	63.10.21	JOHN MARSHALL LAW SC 박사 SKTA	마케팅본부 해외영업단장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	이명영	62.02.20	연세대(경영) 학사 SK네트웍스	재경실장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	임종필	60.11.14	고려대(화학공업) 학사 SK텔레콤	SCM실장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	장성춘	59.01.04	연세대(기계공학) 학사 SK이노베이션	제조지원실장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	양예석	60.01.11	인하대(화학) 학사 Flash개발본부장	Mobile개발본부장	428	-	

상무 (상근)	미등기임 원	고광덕	56.05.18	연세대(경영) 석사 제조본부 Package그룹장	PKG&TEST제조본부 D- P&T그룹장	720	-	
상무 (상근)	미등기임 원	강효상	60.02.26	성균관대(항공) 학사 연구소 FAB기술그룹장	연구소 DRAM공정그룹장	5,178	-	
상무 (상근)	미등기임 원	진교원	62.09.22	서울대(물리) 학사 Flash개발사업부 Flash제품담당	SC사업기획본부파견	540	-	
상무 (상근)	미등기임 원	김진웅	64.02.01	KAIST(재료) 박사 연구소 선행공정담당	연구소 FLASH공정그룹장	2,771	-	
상무 (상근)	미등기임 원	유영호	55.02.25	성균관대(노무학) 석사 경영지원실 청주지원담당	기업문화실 총무그룹장	5,128	-	
상무 (상근)	미등기임 원	이강철	59.07.28	연세대(경영학) 석사 제조본부 F-TEST기술담당	DRAM개발본부 MM제품그룹 장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	이상선	61.09.23	고려대(전기) 학사 제조본부 A-Project담당	FAB제조본부 M11제조기술/신 제품그룹장	4,000	-	
상무 (상근)	미등기임 원	박성기	59.08.12	연세대(요업) 학사 연구소 선행공정그룹장	연구소 NM공정그룹장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	천명환	58.09.07	경기대(회계) 학사 경영지원실 인사그룹장	SKMS실 현장경영그룹장	7,090	-	
상무 (상근)	미등기임 원	김진국	64.07.17	연세대(전기) 학사 DRAM개발본부 MM소자그룹장	Mobile개발본부 Mobile소자그 룹장	581	-	
상무 (상근)	미등기임 원	최춘엽	60.08.28	전북대(경영) 학사 HSD 법인장	마케팅본부 영업1그룹장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	정병태	61.03.01	경북대(물리) 석사 연구소 설계2그룹장	DRAM개발본부 DRAM설계그 룹장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	이철호	60.09.15	광운대(재료) 학사 품질보증실 품질보증담당	품질보증실 DRAM품질보증그 룹장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	김정수	59.06.06	연세대(제어공학) 석사	재경실 IR/PR그룹장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	최석훈	57.12.23	일산고등학교	기업문화실 노경복지그룹장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	변광유	59.08.11	인하대(기계) 학사 PKG&TEST제조본부 PKG연구소	PKG&TEST제조본부 PKG연구 1그룹장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	이승용	59.08.05	중앙대(전자계산) 학사 경영지원실 노경복지그룹장	PKG&TEST제조본부 F-P&T그 룹장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	이석규	63.12.21	서울대(재료) 박사 연구소 Flash개발소자그룹장	연구소 FLASH소자기술팀장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	이병석	61.03.25	영남대(화학) 석사 연구소 Flash공정1팀장	연구소 FLASH공정3팀장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	유경동	61.12.23	옥스포드(재료) 박사 CIS개발설계그룹장	M8사업부 Image개발그룹장	2,480	-	

상무 (상근)	미등기임 원	정재관	60.09.09	영남대(물리) 석사 DRAM개발사업부 MM소자2팀장	연구소 DRAM소자기술그룹장	2,144	-	
상무 (상근)	미등기임 원	안근욱	59.08.15	단국대(전자) 학사 리디스테크놀로지	Flash개발본부 Flash양산소자 그룹장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	김남석	67.02.20	서울대(금속) 박사 삼성전자	PKG&TEST제조본부 PKG연구 2그룹장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	임동규	64.04.10	서울대(물리교육) 박사 연구소 선행공정1팀장	연구소 MASK기반기술그룹장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	오중훈	64.08.20	서울대(전자) 학사 키몬다	마케팅본부 상품기획그룹장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	김은태	58.11.12	인하대(전자) 학사 경영진단그룹장	CorporateCenter총괄 특허그 룹장	-	-	
상무 (상근)	미등기임 원	김동석	60.02.12	경북대(물리) 석사 연구소 FAB기술Etch팀장	연구소 DRAM공정2팀장	2,990	-	
상무 (상근)	미등기임 원	한봉석	64.04.01	한양대(전기) 석사 CIS사업부 CIS설계담당	Flash개발본부 Flash설계그룹 장	428	-	
상무 (상근)	미등기임 원	김현곤	62.07.17	KAIST(물리) 박사 Mobile사업부 Mobile개발그룹장	Mobile개발본부 Mobile설계그 룹장	3,749	-	
상무 (상근)	미등기임 원	김형수	65.02.24	KAIST(재료) 박사 연구소 선행공정1팀장	연구소 기술기획팀장	428	-	

* 미등기임원의 담당업무 및 소유주식현황은 제65기 1분기보고서 제출일 기준임.

나. 직원의 현황

[2012. 03. 31 현재]

(단위 :천원, 명, 년)

직원 수	평균 근속년수	당기 급여총액	1인평균 급여액	비 고
20,046	8.0	306,312,554	15,946	-

* 상기 직원의 수는 본사기준임

* 총당성 인건비 제외 기준임

* 해외법인을 포함한 연결기준 직원수는23,838명임

다. 노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고
가입대상	이천 7,399명 / 청주 4,911명	-
가입인원	이천 7,266명 / 청주 4,875명	-
근로시간 면제자	이천 8명 / 청주 6명	-
소속된 연합단체	한국노총 금속연맹	-

기 타	-	-
-----	---	---

라. 회계 및 공시 전문인력 보유현황

구 분	보유인원	담당업무	비고
회계학박사	1	관리회계	-
미국공인회계사	2	재무회계	-
	2	관리회계	-
	2	재무관리	-
공인회계사	1	IR	-
공시	2	공시 / 상장	-
국내변호사	3	법률자문	-
미국변호사	6		-

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수 현황

[제65기(2012년)]

(단위 : 백만원)

구분(*1)	지급총액(*2)	주총승인금액	1인당 평균 지급액(*2)	주식매수선택권의 공정가치 총액	비중	비고
사내이사(4명)	445	50억원	111	-	-	-
사외이사(5명)	사외이사(2명) 55		28	-	-	-
	감사위원회 위원(3명) 47		16	-	-	-
계	547		61	-	-	-

(*1) 제 65기 이사 및 감사위원회 위원 기준임.

(*2) 지급총액은 임시주주총회(2012. 02. 13)에서 임기만료한 사외이사 및 임기 중 퇴임한 사외이사의 보수를 포함함.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(1) 2005.10.24자 부여 현황

[기준일: 2012. 03. 31 현

(단위 : 원, 주)

재]

부여 받은자	관계	부여일	부여방법	주식의 종류	변동수량			미행사 수량	행사기간	행사 가격	종가
					부여	행사	취소				

황학중	-	2005.10.2 4	신주발행	보통주	22,500	-	-	22,500	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
민형욱	-	2005.10.2 4	신주발행	보통주	22,500	-	-	22,500	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
김덕수	-	2005.10.2 4	신주발행	보통주	22,500	-	-	22,500	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
이준호	-	2005.10.2 4	신주발행	보통주	22,500	-	-	22,500	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
이민호	-	2005.10.2 4	신주발행	보통주	18,750	-	-	18,750	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
이호창	미등기임원	2005.10.2 4	신주발행	보통주	18,750	-	-	18,750	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Swanson, Gary	-	2005.10.2 4	신주발행	보통주	28,000	-	-	28,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Palonsky, Paul	HSA	2005.10.2 4	신주발행	보통주	15,000	-	-	15,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Kassak, Abed	HSA	2005.10.2 4	신주발행	보통주	15,000	-	-	15,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
McBroom, Jerome	HSA	2005.10.2 4	신주발행	보통주	10,500	-	-	10,500	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Heller, Kenneth	HSA	2005.10.2 4	신주발행	보통주	10,500	-	-	10,500	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Chang, Scott	HSA	2005.10.2 4	신주발행	보통주	8,000	-	-	8,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Stanley, Ronald	HSA	2005.10.2 4	신주발행	보통주	8,000	-	-	8,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Hartsoch, Mitchell	-	2005.10.2 4	신주발행	보통주	7,000	-	-	7,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250

Fogarty, John	HSA	2005.10.2 4	신주발행	보통주	7,200	-	-	7,200	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Woo, Sung Sik	-	2005.10.2 4	신주발행	보통주	6,000	-	-	6,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Park, Chang Sun	HSA	2005.10.2 4	신주발행	보통주	6,000	-	-	6,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Franz Ruffer	-	2005.10.2 4	신주발행	보통주	9,000	-	-	9,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Chung Soo, Lee	HSD	2005.10.2 4	신주발행	보통주	7,500	-	-	7,500	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Eric Maillart	HSD	2005.10.2 4	신주발행	보통주	7,500	-	-	7,500	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Marco Ghirardat o	HSD	2005.10.2 4	신주발행	보통주	6,000	-	-	6,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Ulf Akerlind	HSD	2005.10.2 4	신주발행	보통주	3,000	-	-	3,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
Mathieu Deuvergn e	-	2005.10.2 4	신주발행	보통주	3,000	-	-	3,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
마츠시타	HSJ	2005.10.2 4	신주발행	보통주	3,000	-	-	3,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
마츠마루	HSJ	2005.10.2 4	신주발행	보통주	3,000	-	-	3,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
스기무라	HSJ	2005.10.2 4	신주발행	보통주	1,500	-	-	1,500	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
William Roberts	-	2005.10.2 4	신주발행	보통주	12,000	-	-	12,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250
John Michael	-	2005.10.2 4	신주발행	보통주	5,000	-	-	5,000	2007.10.25 ~2012.10.2 4	22,800	29,250

Ara Baboyan	-	2005.10.24	신주발행	보통주	5,000	-	-	5,000	2007.10.25~2012.10.24	22,800	29,250
Gregory Sladcik	-	2005.10.24	신주발행	보통주	5,000	-	-	5,000	2007.10.25~2012.10.24	22,800	29,250
James Stefano	-	2005.10.24	신주발행	보통주	5,000	-	-	5,000	2007.10.25~2012.10.24	22,800	29,250
합계	-	-	-	-	324,200	-	-	324,200	-	-	-

※ 상기 증가는 2012년 03월 31일 기준임.

[미행사 주식매수선택권의 가중평균행사가가격 : 22,800원]

▷ 미행사 주식매수선택권의 가중평균행사가가격 산출방법

= 각 부여받은자(임원 및 직원 모두 포함)의 (미행사 주식매수선택권 수량 × 행사가격)의 합계액 ÷ 미행사 주식매수선택권의 총수량

다. 임원배상책임보험 가입 현황

(1) 보험의 개요

[2012. 03. 31 현재]

(단위 : 백만원)

보험의 명칭	보험료납입액		부보(보상)한도	비고
	당기 납입액	누적납입액 (당기분 포함)		
임원배상책임보험	68	68	70,000	

(2) 피보험자

회사 및 회사의 과거·현재·미래의 모든 임원으로 보험기간 중 선임, 퇴임 임원을 모두 포함합니다.

(3) 보상하는 손해

임원의 업무상 과실 및 임원으로서 의무위반으로 최초 제기된 손해배상 청구에 따른 주주 또는 제3자에 대한 손해배상책임을 보상하며, 임원의 손해배상청구에 대해 회사가 해당임원에게 지급한 회사발생 손해를 보상합니다.

(4) 보험회사의 면책사항

- 보험개시일 이전의 원인행위로 인해 발생한 손해배상
- 법령을 위반하여 발생한 환경오염에 대해 제기되는 손해배상청구
- 임원의 범죄행위(사기, 횡령, 배임 등)로 인한 손해배상청구

IX. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	계정 과목	변 동 내 역				미수 이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
SK hynix America Inc.(SKHYA)	계열 사	단기 대여 금	51,899 (USD45,000,000)	-	698	51,201 (USD45,000,000)	98 (USD 86,400)	거래기간: 2010.11.1 6~ 2012.11.1 5
아미파워	자회 사	장기 대여 금	54,328	-	-	54,328	935	거래기간: 2006.06.0 8~ 2019.12.3 1
합 계			106,227	-	698	105,529	1,033	-

※ 당기 중 증감분에는 환율변동으로 인한 외화평가금액이 반영되었음.

나. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	거 래 내 역				비 고
		기초	증가	감소	기말	
SK hynix America Inc. (SKHYA)	계열회사	15,772 (USD13,675,290)	-	623 (USD361,202)	15,149 (USD13,314,088)	-
합 계		15,772	-	623	15,149	-

※ 당기 중 증감분에는 환율변동으로 인한 외화평가금액이 반영되었음.

다. 영업양수도 내역

(단위 : 백만원)

성명	관계	거래일자	거래일자 기	거래금액	거래내용	비 고
----	----	------	--------	------	------	-----

(법인명)			준			
SK텔레콤(주)	최대주 주	2011.11.14	계약 체결일	1,084,125	지분인수계약 체결	-

회사의 주식관리협의회 및 회사는 2011년 11월 14일 SK텔레콤(주)와 지분인수계약을 체결하였습니다. SK텔레콤(주)는 동 계약에 따라 2012년 2월 14일에 주식관리협의회가 보유한 지분 4,425만주를 매입하고 회사가 제3자 배정방식으로 발행한 신주 1억 185만주를 인수하여 회사 발행 보통주식의 약 21.05%를 취득함으로써 회사의 최대주주가 되었습니다.

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 · 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 · 변경사항

신고일자	제 목	신고한 내용	신고사항의 진행상황
2005.01.18	소송 등의 제기 · 신청	1. 사건의 명칭 : 약정금등 청구의 소 2. 원고·신청인: 현대중공업 주식회사 3. 피고: (주)하이닉스반도체, 현대증권(주), 이익치	1. 2009년 10월 22일 서울중앙지방법원은 다음과 같이 판결함. 가) 피고 (주)하이닉스반도체는 원고에게 50,302,838,040원 및 그 중 별지 1. 도표 '청구금액'란 기재 각 금액에 대하여 목록 '지연손해금 기산일'란 기재 각 일자부터 2009. 10. 22까지는 연 6%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. 나)피고 (주)현대증권, 이익치는 피고 (주)하이닉스반도체와 연대하여 원고에게 40,242,270,429원 및 그 중 별지 2. 도표 '청구금액'란 기재 각 금액에 대하여 같은 목록 '지연손해금 기산일'란 기재 각 일자부터 2009. 10. 22까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. - 당사대책: 당사는 지연이자 지급 부담을 회피하기 위하여 공동피고인 현대증권(주)과 연대하여 동 판결 선고일인 2009. 10. 22 현대중공업(주)에 지연이자를 포함한 판결에 따른 책임금액 전부를 가지급 완료하였으며, 2009년 11월 11일, 위 약정금 등 청구사건의 판결에 불복하여 고등법원에 항소를 제기함. 2. 2010년 12월 17일 서울중앙지방법원은 다음과 같이 판결함. (주)하이닉스반도체는 현대증권(주)에게 금 99,172,640,749원 및이에 대한 지연이자를 지급하라. - 당사대책: 당사는 동 판결 선고일인 2010. 12. 17일자로 현대증권(주)에 판결에 따른 판결금액 및 지연이자를 합산한 1,607억원을 전액 지급 완료함. 3. 2011년 9월 23일 서울 고등법원은 당사의 항소건과 관련하여 다음과 같이 판결함. 가) 원고의 항소를 기각한다. 나) 항소비용은 원고가 부담한다.

<p>2006.08.1 1</p>	<p>소송 등의 제기·신청</p>	<p>1. 사건의 명칭 : 외화대납금 반환등 청구 2. 원고: 현대중공업 주식회사 3. 피고: (주)하이닉스반도체 [파기환송 前 공동피고: 현대증권(주), 이익치]</p>	<p>1. 2009년 8월 21일 서울고등법원은 다음과 같이 판결함. 대법원에서 파기환송된 (주)하이닉스반도체 부분에 대하여 서울고등법원은 당심에서 추가된 청구를 포함하여 제1심 판결을 다음과같이 변경하여 판결함.[판결 주문]: 피고는 원고에게 2002. 4. 18.부터 2009. 8. 21.까지는 연6%, 그 다음날부터 다 갚는날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라. - 당사대책: 당사는 지연이자 지급 부담을 회피하기 위하여 동 판결 선고일인 2009년 8월 21일 현대중공업에 이자를 포함하여 86,226백만원을 가지급 완료함으로써 판결에 따른 책임금액을 전부지급하였음. 2. 2009년 09월 10일, 위 외화대납금반환 등 청구사건의 서울고등법원 파기환송심 판결에 대하여 현대중공업(주)는 원고 패소부분 중 금 13,136,180,341원 및 이에 대한 지연손해금 부분에 대하여 불복하여 대법원에 상고를 제기하였으며, 2012년 02월 09일 대법원은 원심판결의 원고 패소부분 중 4,283,500,000원 및 이에대한 지연손해금 부분을 파기하고 서울고등법원에 환송함. - 당사대책: 당사는 동 대법원 판결에 따라 변경될 판결금액 원리금 합계금7,971,137,550원을 현대중공업(주)에 2012년 02월 14일자로 조건부 변제하였으며, 향후 서울고등법원의 판결 선고 결과에 따라 정산할 예정임.</p>
------------------------	------------------------	---	---

2009.04.07	기타 주요 경영사항 (자율공시)	<p>1. 사건의 명칭: 램버스와의 특허권 침해소송</p> <p>2. 원고(항소인) : Hynix Semiconductor Inc., Hynix Semiconductor America Inc., Hynix Semiconductor U.K.Ltd., and Hynix Semiconductor GmbH.</p> <p>3. 피고 (피항소인) : Rambus, Inc.</p>	<p>1. 2009년 3월 10일(미국 현지시간), 미국 캘리포니아주 북부 지구 연방지방법원(The United States District Court For the Northern District of California) San Jose Division은 미화 396,881,244달러의 손해배상금 및 2009년 2월 1일 이후부터 향후 2010년4월 18일까지 미국에 판매되는 당사 제품에 대해서는 SDR(Single Data Rate) DRAM의 경우 1%, DDR(Double Data Rate) DRAM의 경우 4.25%의 로열티 요율을 적용한 손해배상금을 당사가 램버스에 지불할 것을 결정하는 1심 최종 판결을 내린바 있음.</p> <p>2. 당사는 이에 불복하여 미국 현지시간으로 2009년 4월 6일 미국 연방고등법원에 항소한 결과, 미국 현지시간으로 2011년 5월 13일 미국 연방고등법원은 램버스의 불법적인 증거 파기 행위가 있었음을 판시하고, 1심 법원의 원심을 파기환송하면서 1심 법원이 증거 파기 행위에 고의(Bad-faith)가 있었는지, 하이닉스의 방어권에 악영향을 미쳤는지(Precjudice) 부분에 대하여 재 심리하고 그에 따른 적절한 조치를 취할 것을 명령하였음.</p> <p>3. 향후 각 당사자는 금번 미국 연방고등법원의 판결에 대해 재 심리를 신청할 수 있으며, 재 심리 신청이 받아들여지지 않을 경우 미국 연방대법원에 상고 가능함.</p>
------------	-----------------------------	---	--

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제 64기 정기주주총회 (2012.03.23)	제64기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인	-
	정관 변경의 건	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 50억원)	
임시주주총회 (2012.02.13)	정관 변경의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
제 63기 정기주주총회 (2011.03.30)	제63기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인	-
	이사 선임의 건	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 50억원)	

제 62기 정기주주총회 (2010.03.26)	제62기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인	-
	정관 변경의 건	원안대로 승인	
	이사 선임의 건	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 40억원)	

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

□ 반독점법 위반소송

2002년 6월부터 미국법무부(Department of Justice)는 전세계 DRAM업체들의 미국내 매출거래에 대한 미국 반독점법 위반여부를 조사한 바 있습니다. 동 조사와 관련하여 회사는 2005년 4월 22일에 미국법무부와 Plea Agreement를 체결하였습니다. 이와 관련하여 미국의 DRAM 소비자들은 회사와 회사의 종속회사인 미국 판매법인("SKHYA(구 HSA)")을 대상으로 민사상의 손해배상을 청구하였습니다. 이에 따라, 미국 법무부와는 별도로 회사는 직접구매자집단 및 개별업체들과 화해계약을 체결한바 있으며, 2010년 11월에는 간접구매자집단과 USD 50백만을 지급하는 민사상의 화해계약을 체결하였습니다.

한편, 보고기간 종료일 현재 미국 법원에서 Flash 제품 관련하여 제기된 간접구매자 집단 소송이 2심법원에서 기각되어 종료되었으며, 23개의 개별 민사소송이 남아 있습니다. 그 외 캐나다 BC, Ontario, Quebec 3개 주에서 DRAM, SRAM 제품의 반독점법 위반과 관련한 직접 및 간접구매자집단과 민사소송이 진행 중에 있습니다. Flash 제품과 관련한 민사소송으로, Ontario주의 소송이 2011년 12월 19일 원고측에 의해 취하되었기 때문에 현재 캐나다에서는 BC와 Quebec주의 직접 및 간접구매자 집단소송이 남아있습니다.

위 사항들과 관련된 소송의 결과는 보고기간 종료일 현재 예측될 수 없으며 이로 인한 영향은 중요할 수 있습니다. 회사의 분기연결재무제표는 이러한 불확실성으로 인하여 추가적으로 발생할 수 있는 영향이 반영되어 있지 않습니다.

□ Rambus 특허권 침해소송

회사는 보고기간 종료일 현재 High-bandwidth chip connection 기술의 개발자인 Rambus사로부터 회사의 SDR SDRAM, DDR SDRAM 제품이 Rambus사 소유의 특허권을 침해하고 있다고 주장하는 소송에 피소되어 있습니다. 동 소송은 독일, 프랑스, 영국 그리고 미국에서 진행되었으나, 유럽특허청이 소송의 근거가 된 Rambus사의 유럽특허가 무효임을 결정함에 따라 영국에서의 소송은 기각되었으며, 프랑스에서의 소송은 사실상 중단되었고, 독일에서의 소송은 소송절차 진행이 유예된 상태

입니다.

미국에서 진행되고 있는 소송과 관련해서는, 2009년 3월 10일 캘리포니아 북부연방지방법원이 회사의 Rambus사 특허침해를 인정하고 회사에게 손해배상금 지불을 명하는 한편, 2009년 2월 1일부터 2010년 4월 17일까지 미국 내 생산 및 판매되는 DRAM제품에 대해 SDR제품의 경우 1%, DDR 이후 제품의 경우 4.25%에 해당하는 로열티를 지불하라는 1심 최종판결을 내렸고, 회사는 이에 불복하여 2009년 4월 6일 미국연방고등법원에 항소하였습니다.

1심 판결의 집행과 관련하여 캘리포니아 북부연방지방법원은 회사의 항소기간 중 최종판결 집행유예 신청안을 받아들여 2009년 하반기에 전체 손해배상금액 중 일부 금액은 특정 금융기관이 회사를 위하여 Rambus사에게 지급을 보증하고, 나머지 금액은 회사의 청구 공장 일부를 Rambus사에게 저당권을 설정하되, 2009년 2월 1일부터 2010년 4월 17일까지 미국 내 생산 및 판매되는 DRAM 제품에 대한 로열티(USD 59백만 상당액)는 Escrow 계좌에 예치하는 조건으로 동 판결의 집행을 유예하도록 명령하였습니다. 그러나 2010년 9월 17일 캘리포니아 북부연방지방법원은 회사 재무환경의 호전을 이유로 청구 공장 일부에 대해 저당권을 설정하는 대신 해당금액에 대해 추가로 지급 보증할 것을 명령하였습니다. 이와 관련하여 한국산업은행 등은 회사를 위하여 USD 400백만의 지급보증을 제공한 바 있습니다.

그러나, 2011년 5월 13일 미국연방고등법원은 Rambus사의 불법적인 증거파기행위가 있었음을 판시하고, 1심 법원이 Rambus사의 증거파기행위에 고의(Bad-faith)가 있었는지, 동 증거파기행위가 회사의 방어권에 악영향을 미쳤는지(Prejudice) 부분에 대하여 재심리하고 그에 따른 적절한 조치를 취할것을 명령하면서 1심 최종판결을 파기환송하여, 보고기간 종료일 현재 1심법원에서는 미국연방고등법원의 판결에 따라 재심리를 진행하고 있습니다. 미국연방고등법원이 1심 판결에 대해 파기 환송 결정을 함에 따라, 법원은 1심 판결 집행을 유예시키기 위해 회사가 예치한 USD 400백만의 지급 보증 의무를 해소하고 Escrow 계좌에 보관하고 있던 2009년 2월 1일부터 2010년 4월 17일까지 미국 내 생산 및 판매된 DRAM제품에 대한 로열티를 반환할 것을 결정하였습니다.

또한 회사는 Rambus사 특허의 무효 및 반도체표준화기구(JEDEC)에서의 Rambus사의 특허공개의 무위반여부 등 미국연방고등법원이 기각한 회사의 다른 주장에 대해 2011년 10월 27일 미국연방대법원에 상고한 바 있으나 미국연방대법원은 2012년 2월 21일 회사의 상고를 기각하였습니다.

이와 별도로 Rambus사는 회사와 미국 내 자회사를 상대로 DDR2, GDDR 메모리 제품이 Rambus사 소유의 다른 특허권을 침해하고 있다는 소송을 추가로 제기하여 현재까지 계류 중에 있습니다.

또한, Rambus사는 상기 특허소송 이외에 회사 및 미국 내 자회사와 회사의 경쟁회사들을 상대로 이 회사들이 자사의 제품인 RDRAM의 시장진입을 방해하였다는 이유로 반독점 소송을 제기하였으나 1심 법원은 2012년 2월 15일 회사와 공동피고인 Micron사가 불법적인 담합행위를 하지 않았다고 결정하면서 회사가 승소하였다는 1심 최종 판결을 내렸고, 이에 대해 Rambus사는 2012년 4월 2일 항소하였습니다.

상기 소송들의 최종결과는 보고기간 종료일 현재 예측될 수 없으며 이로 인한 영향은중요할 수 있습니다. 회사의 분기연결재무제표는 이러한 불확실성으로 인하여 추가적으로 발생할 수 있는 영향이 반영되어 있지 않습니다.

□ 외화대납금 반환 및 손해배상금 청구소송

회사는 1997년 7월 24일자로 Canadian Imperial Bank of Commerce (이하 "CIBC")에 (주)푸르덴셜투자증권(구, 현투증권(주)) 발행주식 13백만주를 매각하였으며, 이와 관련하여 현대중공업(주)는 CIBC와 동 주식의 재매입에 관한 약정(Share Option Agreement)을 체결한 바 있습니다. 동 재매입 약정과 관련하여 회사와 상기 거래를 주선한 현대증권(주)는 연명으로 동 약정상의 현대중공업(주)의 의무가 현대중공업(주)에 부담을 주지 않도록 한다는 내용의 각서를 현대중공업(주)에 제공하였고, 회사는 유사한 내용의 각서를 현대증권(주)로부터 징구받았습니다. 현대중공업(주)는 2000년 7월에 CIBC의 요구에 따라 USD220,480천에 상기 주식을 매입하고, 동 매입대금의 지급을 회사와 현대증권(주)에 요청하였습니다. 그러나 회사는 현대중공업(주)와 CIBC간의 거래에 회사가 직접 관여한 바 없었고 위 각서는 경영상의 책임을분담한다는 의미이며 법적인 보증이 아니라는 점을 이유로 위의 요청을 거부하였습니다.

이에 현대중공업(주)는 회사와 현대증권(주) 및 동 발행주식 매각 당시 현대증권(주)의 대표이사를 상대로 외화대납금 반환 및 손해배상청구소송을 2000년 7월 28일 자로 법원에 제기하였습니다. 상기 소송의 결과로 2002년 1월 25일자 1심 판결에서 법원은 회사와 현대증권(주) 및 동 발행주식 매각 당시 현대증권(주)의 대표이사 등 3인의 공동피고에 대해 현대중공업(주)에 주식매입대금의 70%인 171,822백만원의 손해배상금 지급을 명령하는 원고 일부승소를 선고한 바 있습니다. 이에 회사는 동 1심 판결금액의 임시 귀속분 및 이에 대한 이자 123,677백만원을 현대중공업(주)에 지급하고 이에 대해 2002년 2월 항소하였습니다. 2006년 6월 14일 항소심 판결에서 법원은 주식매입대금의 약 80%인 192,942백만원의 손해배상금 지급을 명하는 원고 일부승소 판결을 하였습니다.

회사는 동 항소심 판결금액의 임시 귀속분 및 이에 대한 이자 1,926백만원을 현대중공업(주)에 추가로 지급하고 이에 대하여 2006년 6월 30일자로 대법원에 상고하였습니다. 대법원은 2009년 3월 26일자로 3심 판결에서 현대증권(주)와 상기 발행주식 매각 당시 현대증권(주)의 대표이사에 대해서는 제2심의 판결내용을 그대로 인정하면서, 회사에 대한 부분에 대하여는 회사가 현대중공업(주)에 대해 비용상환의무가 있다는 점을 이유로 서울고등법원으로 파기환송을 선고한 바, 서울고등법원은 2009년 8월 21일자 파기환송심 판결에서 회사가 현대중공업(주)에 제공한 각서에 따른 약정에 기한 책임을 인정하여, 현대중공업(주)의 청구금액에서 현대증권(주)가 현대중공업(주)에 지급한 금액을 변제 총당한 나머지 금액인 167,219백만원 및 지연이자의 지급을 명하는 원고 일부 승소 판결을 하였습니다.

이에 회사는 상기 판결금액에서 회사가 1심 판결 및 2심 판결에 따라 현대중공업(주)에 지급한 금액을 차감한 나머지 금액인 86,226백만원을 현대중공업(주)에 지급 완료하였습니다. 그러나 현대중공업(주)는 2009년 9월 10일자로 대법원에 상고한 바, 대법원은 2012년 2월 9일자 재상고심 판결에서 이 사건 주식의 시가를 공제한 원심판단에 위법이 있다는 이유로, 원심판결의 원고 패소부분 중 4,284백만원 및 이에 대한 지연손해금 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다고 선고하였습니다.

이에 회사는 지연이자 부담을 감면하기 위하여, 대법원 판결선고 직후 현대중공업(주)와 조건부 변제합의를 하고 청구원리금 7,971백만원을 가지급 완료하였으며, 동 소송은 서울고등법원에 계류중입니다. 상기 소송의 최종 결과는 보고기간 종료일 현재 예측될 수 없으며 이로 인한 영향은 중요할 수 있습니다. 회사의 연결재무제표는 이러한 불확실성으로 인하여 발생할 수 있는 영향이 반영되어 있지 않습니다.

또한 현대중공업(주)는 상기의 (주)푸르덴셜투자증권의 주식매입과 관련하여 발생한 법인세비용 등과 관련하여 2004년 12월에 회사와 현대증권(주) 및 당시 현대증권(주)의 대표이사를 상대로 50,303백만원을 청구하는 별도의 소송을 서울중앙지방법원에 제기하였습니다. 상기 소송의 결과로 2009년 10월 22일자 1심 판결에서 서울

중앙지방법원은 회사와 현대증권(주) 및 동 발행주식 매각 당시 현대증권(주)의 대표이사 등 3인의 공동피고에 대해 현대중공업(주)에 청구금액 전부 및 지연이자의 지급을 명령하는 원고 승소를 선고하였고, 이에 회사와 현대증권(주)는 동 1심 판결금액 73,692백만원을 현대중공업(주)에 지급하고, 이에 대해 2009년 11월 11일자로 항소하였습니다. 2011년 11월 10일 항소심 판결에서 법원은 현대중공업의 청구금액 중 48,770백만원 및 지연이자의 지급을 명령하는 원고 일부 승소를 선고하여 1심 판결 결과를 일부 감축하였습니다. 이에 대해 회사와 현대증권(주) 및 현대중공업(주)는 2011년 11월 25일 대법원에 상고 하였습니다. 상기 소송의 최종결과는 보고기간 종료일 현재 예측될 수 없으며 이로 인한 영향은 중요할 수 있습니다.

□ 현대증권 소송

상기 외화대납금 반환 및 손해배상금 청구 소송과 관련하여, 현대증권(주)는 현대증권(주)와 회사가 현대중공업(주)에 대하여 부담한 지급의무의 최종적 책임은 회사에 있음을 이유로 2009년 8월 27일자로 회사를 상대로 99,172백만원 및 지연이자의 지급을 요구하는 구상금 청구 소송을 서울중앙지방법원에 제기하였습니다.

상기 소송의 결과로 2010년 12월 17일자 1심 판결에서 서울중앙지방법원은 현대증권(주)는 회사를 위한중개인의 역할을 한 것으로서 현대중공업(주)에 지급한 금원은 회사를 위한 것이므로 회사에게 동 금액에 대한 구상 또는 비용상환 청구권이 있음을 이유로 회사 전부 패소를 선고한 바, 이에 회사는 동 1심 판결금액 160,724백만원을 현대증권(주)에 가지급하고, 이에 대해 2011년 1월 7일자로 항소하였습니다. 고등법원은 2011년 9월 28일자 판결에서 구상의무는 1심과 동일하다는 이유로 회사의 항소를 기각하는 판결을 선고한 바, 회사는 이에 대해 2011년 10월 19일 대법원에 상고하였습니다. 상기 소송의 최종결과는 보고기간 종료일 현재 예측될 수 없으며 이로 인한 영향은 중요할 수 있습니다.

이와 별도로 회사는 회사와 현대증권(주)가 현대중공업(주)에 제공한 각서와 유사한 내용의 각서를 현대증권(주)가 회사에 제출한 사실 및 현대증권(주)의 손실보장 약정에 근거하여 2009년 9월 21일자로 현대증권(주)를 상대로 211,829백만원 및 지연이자의 지급을 구하는 약정금 청구 소송을 서울중앙지방법원에 제기하였습니다.

상기 소송의 결과로 2010년 12월 17일자 1심 판결에서 서울중앙지방법원은 현대증권(주)이 회사에 제공한 각서는 정부의 제재 및 그로 인한 손해에 국한되므로 회사 청구금액에는 적용 없으며, 따라서 별도 '손실 보전 약정'한 사실을 인정하기 어려움을 이유로 회사전부 패소를 선고하였고, 이에 대해 회사는 2011년 1월 7일자로 항소하였습니다. 고등법원은 2011년 9월 22일자 판결에서 1심과 동일한 이유로 회사의 항소를 기각하는 판결을 선고하였고, 회사는 이에 대하여 상고 실익을 검토한 결과 상고하지 않기로 결정하였고 이에 따라 본 소송은 확정되었습니다.

한편, 상기 외화대납금 반환 및 손해배상금 청구소송 중 (주)푸르덴셜투자증권 주식매입으로 발생한 법인세비용 등과 관련하여, 현대증권(주)는 현대증권(주)와 회사가 현대중공업(주)에 대하여 부담한 지급의무의 최종적 책임은 회사에 있음을 이유로 2011년 2월 25일자로 회사를 상대로 27,917백만원 및 지연이자의 지급을 구하는 별도의 구상금 청구소송을 서울중앙지방법원에 제기하였습니다. 이에 회사는 동 소송에서 회사가 패소하는 경우의 지연이자 부담을 감면하기 위하여 당기 중 현대증권(주)과 조건부 변제합의를 하고 청구원리금 30,235백만원을 가지급하고 응소하였습니다. 상기 소송의 결과로 서울중앙지방법원은 2012년 2월 17일자 1심 판결에서 현대증권은 사건의 중개인으로서 회사 부담의 보상의무를 대신 변제하였으므로 보증인으로서의 구상 또는 수임인으로서 비용상환청구권을 가진다는 이유로 회사 전부 패소를 선고한 바, 현대증권은 청구취지 감축분 949백만

원을 회사에 환급 완료하였습니다.

한편 회사는 상기 판결에 대해 2012년 2월 25일 서울고등법원에 항소하였습니다. 상기 소송의 최종결과는 보고기간 종료일 현재 예측될 수 없으며 이로 인한 영향은 중요할 수 있습니다.

□ 기타의 소송 및 특허 Claim 등

연결회사는 상기 소송을 포함하여 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며 향후 자원의 유출가능성이 매우 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다. 그러나 보고기간 종료일 현재 이러한 우발상황의 최종결과는 예측될 수 없으며 이로 인한 영향은 중요할 수 있습니다.

나. 채무보증 현황

(단위: 백만원)

채무자 (회사와의 관계)	채권자	채무금액	채무보증금 액	채무보증기간 (개시일~종료일)	비고
종업원	한국외환은행, 국민은행	34	34	2000.12.06 ~	- . 우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증

다. 그 밖의 우발채무 등

□ 특허라이선스 계약

연결회사는 보고기간 종료일 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이선스 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이선스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

□ 공업용수공급계약

연결회사는 2001년에 베올리아워터산업개발(주) ("Veolia")와 2001년 3월부터 2013년3월까지 총 12년간 공업용수를 공급받는 계약을 체결하였습니다. 그리고 2006년 12월에 갱신된 2018년 3월까지의 연장계약과, 2007년 3월의 M7공장 신설공사에 따른수정계약을 체결한 바 있습니다. 동 계약에 의하면 연결회사는 계약기간 동안 Base Service Charge ("BSC")와 공급받는 공업용수 사용량에 일정액을적용하여 계산된 Additional Service Charge ("ASC")를 Veolia에 지급해야 합니다.

□ HITECH와의 후공정서비스계약

회사는 2009년 중 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하였습니다. 그리고 HITECH는 회사 및 회사의 종속기업인 HSMC로부터 기계장치를 각각 USD 177백만 및 USD 128백만에 매입하기로 계약하였으며, 설립 후 5년 동안 회사에 대한 후공정 서비스 제공을 위하여 동 매입 장비를 배타적으로 사용하기로 하였습니다. 이후회사는 2011년 중 HITECH와, 기존 후공정 서비스 공급계약과 연계하여 모듈서비스 공급을 추가하는 계약을 체결하였고 HITECH는 회사로부터 기계장치를 USD 9.5백만에 매입하기로 계약하였습니다. 동 계약에 의하면 연결회사는 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 후공정서비스 가격을 지불하기로 하였습니다.

□ 열병합발전소 재매입계약

회사는 사이스이천열병합발전유한회사 (이하 "사이스이천")로부터 증기와 전력을 제공받는 장기계약을 체결하고 있으며, 회사의 종속기업인 (주)하이닉스엔지니어링(이하 "하이닉스엔지니어링")은 2005년3월에 사이스이천과 동 시설에 대한 매입계약을 체결하였습니다. 동 계약과 관련하여 회사는 2005년7월 중 사이스이천에 매입계약금액 119,000백만원에 대한 계약이행보증을 제공하고 매입계약금액중 계약해지보상금 39,106백만원 및 향후 자산처분손실 보상예상액 17,213백만원 등 총 56,319백만원을 보상해주는 손실부담계약을 하이닉스엔지니어링과 체결하였습니다. 회사는 2005년 중 동 손실부담계약에 의하여 부담하게 될 채무를 모두 손실로 인식하였습니다.

보고기간 종료일 현재 해당 계약 및관련된 자산은 모두 하이닉스엔지니어링의 인적분할로 설립한 회사의 종속기업인 (주)아미파워(이하 "아미파워")로 이전되었습니다. 이후 회사는 하이닉스엔지니어링과, 하이닉스엔지니어링은 아미파워와 '스팀 공급 및 설비유지보수 계약' 및 '전기공급계약'(이하 위 양 계약을 합쳐 '에너지 공급 계약')을 체결하였습니다. 회사는 2011년 11월 아미파워에게 에너지 공급계약을 해지할 것을 통보하였고, 이에 따라 아미파워는 본건 설비의 매각과 청산을 예정하고 있습니다.

이에 회사는 이와 같은 에너지 공급계약의 해지로 인하여 아미파워가 발전설비를 처분하게 됨에 따라 입게 될 경제적 불이익을 보상하기 위하여 아미파워와 사이에 체결된 처분손실보전 계약에 따라 회사가 부담하게 될 것으로 예상되는 금액인 30,530백만원(이하 "처분손실 보전금")을 전기에 손실로 인식하였으며, 향후 아미파워 실제 자산매각 처분 금액에 따라 상기 처분손실 보전금은 정산될 예정입니다.

회사의 분기연결재무제표는 이러한 불확실성으로 인하여 추가적으로 발생할 수 있는 영향을 반영하고 있지 않습니다.

라. 공모자금의 사용내역

2010년 5월 해외전환사채 발행 결과(전환가격: 34,394원) 2010년 5월 14일 발행대금이 납입되었으며, 당사는 발행 당시 외국환거래신고서에 기재된 순서대로 자금을 집행하여 본 보고서 제출일 현재 공모자금의 사용을 모두 완료하였습니다.

(기준일 : 2012년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등
-----	-----	------	--------------	------------	-----------

전환사채 (신주인수권부사채) 발행	2010년 05월 14일	565,500	- 운영자금: 565,500 - 기타(발행비용): 8,483	- 운영자금: 565,500 - 기타(발행비용): 8,483	-
-----------------------	------------------	---------	--------------------------------------	--------------------------------------	---

마. 사모자금의 사용내역

2012년 2월 당사 보통주 101,850,000주에 대한 제3자배정 방식의 유상증자 결과(발행가액: 23,000원), 2012년 2월 14일 2,342,550백만원의 대금이 납입되었으며, 당사는 2012년 3월 31일까지 시설자금결제와 운영자금결제 및 기타비용으로 1,861,795백만원을 집행하였습니다.

(기준일 : 2012년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발 생 사유 등
주권상장법인사모증자 (증권시장사모)	2012년 02월 14일	2,342,550	-	- 운영자금: 1,677,466 - 시설자금: 167,756 - 기타(발행비용): 16,573	-

3. 녹색경영 현황

가. 녹색기업의 지정

당사는 자발적 환경개선활동과 그 성과를 인정 받아 '환경기술개발 및 지원에 관한 법률 제16조의 2(녹색기업의 지정)'에 의거 녹색기업으로 지정되었습니다.

나. 온실가스·에너지 관리업체 지정

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스·에너지 관리업체 지정·관리 지침(환경부 고시 제2010-109호)'에 따라 2010년 9월 30일 산업·발전 부문 관리 업체로 지정되었습니다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2011년 온실가스 배출량은 2,553,655톤 CO₂e (tCO₂e), 에너지 사용량은 31,866 테라줄(TJ)입니다.

XI. 재무제표 등

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 65 기 1분기말 2012.03.31 현재

제 64 기말 2011.12.31 현재

제 63 기말 2010.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 65 기 1분기말	제 64 기말	제 63 기말
자산			
유동자산	6,634,695	4,936,850	5,416,086
현금및현금성자산	2,691,104	1,243,788	1,253,226
단기금융상품	707,583	632,139	948,476
매출채권	1,572,139	1,540,925	1,604,952
기타수취채권	264,081	212,641	167,684
재고자산	1,254,207	1,183,608	1,281,519
매각예정자산	28,637	29,033	53,204
기타금융자산		1	
기타유동자산	116,944	94,715	107,025
비유동자산	12,629,665	12,301,298	11,996,031
조인트벤처 및 관계기업 투자	111,199	103,613	98,163
매도가능금융자산	52,988	47,492	57,044
유형자산	11,224,263	10,899,308	10,590,580
무형자산	702,410	707,648	603,653
투자부동산	30,848	31,168	37,186
기타수취채권	38,091	38,461	93,093
기타금융자산	8,690	3,441	8,085
이연법인세자산	316,970	315,718	388,773
기타비유동자산	144,206	154,449	119,454
자산총계	19,264,360	17,238,148	17,412,117
부채			
유동부채	4,688,708	4,817,286	5,349,559

매입채무	710,644	678,408	875,174
미지급금	818,906	516,724	649,797
기타지급채무	328,851	345,878	494,635
총당부채	380,702	353,467	532,123
기타금융부채	36,684	38,678	4,805
차입금	2,348,541	2,830,426	2,577,707
기타유동부채	54,512	42,535	206,730
당기법인세부채	9,868	11,170	8,588
비유동부채	4,677,404	4,545,591	4,154,982
차입금	4,046,041	3,946,039	3,476,982
기타지급채무	76,022	94,326	232,893
확정급여부채	471,094	458,699	359,062
기타금융부채	45,148	7,796	54,963
기타비유동부채	39,099	38,731	31,082
부채총계	9,366,112	9,362,877	9,504,541
자본			
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	9,898,873	7,875,742	7,905,923
자본금	3,487,768	2,978,498	2,969,023
자본잉여금	3,045,857	1,229,052	1,193,100
기타포괄손익누계액	75,355	107,107	(23,261)
기타자본항목	5,762	5,762	5,762
이익잉여금(결손금)	3,284,131	3,555,323	3,761,299
비지배지분	(625)	(471)	1,653
자본총계	9,898,248	7,875,271	7,907,576
자본과부채총계	19,264,360	17,238,148	17,412,117

연결 포괄손익계산서

제 65 기 1분기 2012.01.01 부터 2012.03.31 까지

제 64 기 1분기 2011.01.01 부터 2011.03.31 까지

제 64 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

제 63 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 65 기 1분기		제 64 기 1분기		제 64 기	제 63 기
	3개월	누적	3개월	누적		
매출액	2,388,389	2,388,389	2,793,185	2,793,185	10,395,811	12,106,090

매출원가	2,182,277	2,182,277	2,112,379	2,112,379	8,721,257	7,643,517
매출총이익	206,112	206,112	680,806	680,806	1,674,554	4,462,573
판매비와경상개발비	473,548	473,548	348,469	348,469	1,569,335	1,461,172
기타영업수익	14,029	14,029	17,723	17,723	350,334	147,852
기타영업비용	6,574	6,574	27,231	27,231	130,079	173,982
영업이익(손실)	(259,981)	(259,981)	322,829	322,829	325,474	2,975,271
금융수익	196,371	196,371	209,335	209,335	630,310	866,522
금융비용	203,339	203,339	253,265	253,265	911,399	1,034,489
지분법 손익	6,543	6,543	2,519	2,519	10,533	2,120
기타영업외수익	949	949			1,621	47,263
기타영업외비용	11,571	11,571			11,392	190,305
법인세비용차감전순이익(손실)	(271,028)	(271,028)	281,418	281,418	45,147	2,666,382
법인세비용	195	195	7,878	7,878	101,118	68,807
당기순이익(손실)	(271,223)	(271,223)	273,540	273,540	(55,971)	2,597,575
기타포괄손익	(31,799)	(31,799)	(71,727)	(71,727)	68,850	(103,395)
매도가능금융자산평가손익	5,890	5,890	(5,920)	(5,920)	7,129	(28,947)
해외사업환산손익	(38,728)	(38,728)	(63,998)	(63,998)	123,236	(14,989)
부의지분법자본변동	1,044	1,044	(1,792)	(1,792)	(735)	(2,033)
보험수리적손익	(5)	(5)	(17)	(17)	(60,780)	(57,426)
총포괄손익 소계	(303,022)	(303,022)	201,813	201,813	12,879	2,494,180
당기순이익(손실)의 귀속						
지배기업의 소유지분	(271,119)	(271,119)	273,264	273,264	(56,641)	2,620,962
비지배지분	(104)	(104)	276	276	670	(23,387)
총포괄손익의 귀속						
지배기업의 소유지분	(302,868)	(302,868)	202,926	202,926	12,947	2,524,853
비지배지분	(154)	(154)	(1,113)	(1,113)	(68)	(30,673)
지배기업의 소유지분에 대한 주 당이익						
기본주당이익(원)	(420)	(420)	463	463	(96)	4,440
희석주당이익(원)	(420)	(420)	462	462	(96)	4,171

연결 자본변동표

제 65 기 1분기 2012.01.01 부터 2012.03.31 까지

제 64 기 1분기 2011.01.01 부터 2011.03.31 까지

제 64 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

제 63 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지

			자본							비지배자본	자본 합계
			지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계		
			자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금				
2010.01.01 (기초자본)			2,965,833	1,238,089	15,428	5,769	1,201,918	5,427,037	472,619	5,899,656	
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					2,620,962	2,620,962	(23,387)	2,597,575	
		보험수리직손익					(57,420)	(57,420)	(6)	(57,426)	
		매도가능금융자산평가손익			(12,958)			(12,958)	(15,989)	(28,947)	
		부의지분법자본변동			(2,033)			(2,033)		(2,033)	
		해외사업환산손익			(23,698)			(23,698)	8,709	(14,989)	
		총포괄손익			(38,689)		2,563,542	2,524,853	(30,673)	2,494,180	
	자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자									
		주식선택권 행사	13	7		(7)			13		13
		배당금지급									
		전환사채의 전환	3,177	11,314					14,491		14,491
		종속기업의 지분율변동 효과		(56,310)					(56,310)	(440,293)	(496,603)
		연결범위의 변동									
		기타의 변동					(4,161)	(4,161)			(4,161)
		자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	3,190	(44,989)		(7)	(4,161)	(45,967)	(440,293)		(486,260)
자본 증가(감소) 합계											
2010.12.31 (기말자본)			2,969,023	1,193,100	(23,261)	5,762	3,761,299	7,905,923	1,653	7,907,576	
2011.01.01 (기초자본)			2,969,023	1,193,100	(23,261)	5,762	3,761,299	7,905,923	1,653	7,907,576	
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					(56,641)	(56,641)	670	(55,971)	
		보험수리직손익					(60,780)	(60,780)		(60,780)	
		매도가능금융자산평가손익			7,905			7,905	(776)	7,129	
		부의지분법자본변동			(735)			(735)		(735)	
		해외사업환산손익			123,198			123,198	38	123,236	
		총포괄손익			130,368		(117,421)	12,947	(68)	12,879	
	자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자									
		주식선택권 행사									
		배당금지급					(88,541)	(88,541)		(88,541)	
		전환사채의 전환	9,475	36,193					45,668		45,668
		종속기업의 지분율변동 효과									
		기타의 변동									

		연결범위의 변동							(2,056)	(2,056)	
		기타의 변동		(241)		(14)	(255)			(255)	
		자본에직접반영된 소유 주와의 거래 소계	9,475	35,952		(88,555)	(43,128)	(2,056)		(45,184)	
		자본 증가(감소) 합계									
2011.12.31 (기말자본)			2,978,498	1,229,052	107,107	5,762	3,555,323	7,875,742	(471)	7,875,271	
2011.01.01 (기초자본)			2,969,023	1,193,100	(23,261)	5,762	3,761,299	7,905,923	1,653	7,907,576	
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					273,264	273,264	276	273,540	
		보험수리적손익					(17)	(17)		(17)	
		매도가능금융자산평가 손익			(4,641)			(4,641)	(1,279)	(5,920)	
		부의지분법자본변동			(1,792)			(1,792)		(1,792)	
		해외사업환산손익			(63,888)			(63,888)	(110)	(63,998)	
		총포괄손익			(70,321)		273,247	202,926	(1,113)	201,813	
	자본에직접반영된 소유주와의 거래	유상증자									
		주식선택권 행사									
		배당금지급					(88,556)	(88,556)		(88,556)	
		전환사채의 전환	2,172	8,239				10,411		10,411	
		종속기업의 지분율변동 효과									
		연결범위의 변동			(220)			(220)		(220)	
		기타의 변동									
		자본에직접반영된 소유 주와의 거래 소계	2,172	8,019			(88,556)	(78,365)		(78,365)	
			자본 증가(감소) 합계								
	2011.03.31 (기말자본)			2,971,195	1,201,119	(93,582)	5,762	3,945,991	8,030,484	540	8,031,024
2012.01.01 (기초자본)			2,978,498	1,229,052	107,107	5,762	3,555,323	7,875,742	(471)	7,875,271	
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					(271,119)	(271,119)	(104)	(271,223)	
		보험수리적손익					3	3	(8)	(5)	
		매도가능금융자산평가 손익			5,890			5,890		5,890	
		부의지분법자본변동			1,044			1,044		1,044	
		해외사업환산손익			(38,686)			(38,686)	(42)	(38,728)	
		총포괄손익			(31,752)		(271,116)	(302,868)	(154)	(303,022)	
	자본에직접반영된 소유주와의 거래	유상증자	509,250	1,816,727				2,325,977		2,325,977	
		주식선택권 행사									
		배당금지급									

	전환사채의 전환	20	78				98		98
	종속기업의 지분율변동 효과								
	연결범위의 변동								
	기타의 변동					(76)	(76)		(76)
	자본에직접반영된 소유 주와의 거래 소계	509,270	1,816,805			(76)	2,325,999		2,325,999
	자본 증가(감소) 합계								
2012.03.31 (기말자본)		3,487,768	3,045,857	75,355	5,762	3,284,131	9,898,873	(625)	9,898,248

연결 현금흐름표

제 65 기 1분기 2012.01.01 부터 2012.03.31 까지

제 64 기 1분기 2011.01.01 부터 2011.03.31 까지

제 64 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

제 63 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 65 기 1분기	제 64 기 1분기	제 64 기	제 63 기
영업활동현금흐름	747,075	593,830	2,855,960	5,883,541
영업으로부터 창출된 현금흐름	779,504	613,319	3,079,193	6,153,749
이자수취	15,303	19,174	68,107	67,732
이자지급	(41,311)	(36,868)	(275,866)	(334,144)
배당금수취	1		8,883	
배당금지급				
법인세의환급(납부)	(6,422)	(1,795)	(24,357)	(3,796)
투자활동현금흐름	(1,266,511)	(713,805)	(3,389,264)	(4,683,472)
기타금융자산의 감소			325,552	
기타금융자산의 증가				(721,526)
매각예정자산의 처분	23	3,806	6,931	
단기대여금의 감소			9,403	
단기대여금의 증가			(4,621)	(21,806)
관계기업투자의 취득			(12,180)	(496,604)
매도가능금융자산의 감소	8,995			441
매도가능금융자산의 취득	(51)	(3,049)	(7,897)	(9,557)
장기대여금의 감소			601	
장기대여금의 증가			(910)	(18,342)
유형자산의 처분	19,884	249	14,371	127,688

유형자산의 취득	(1,188,639)	(937,222)	(3,568,238)	(3,391,910)
무형자산의 처분	4	5	13,946	
무형자산의 취득	(27,637)	(35,861)	(176,111)	(151,856)
투자부동산의 처분			12,153	
종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름			(661)	
기타투자활동으로 인한 유출			(1,603)	
단기금융상품의 감소	463,205	901,975		
단기금융상품의 증가	(540,319)	(634,710)		
기타수취채권의 감소	1,652	1,795		
기타수취채권의 증가	(4,635)	(1,044)		
파생상품거래로 인한 현금유입	1,450	2,355		
파생상품거래로 인한 현금유출	(443)	(12,104)		
재무활동현금흐름	1,969,254	291,563	519,133	(1,140,424)
차입금의 증가	1,092,187	641,424	2,434,510	1,187,488
차입금의 상환	(1,448,910)	(349,620)	(1,826,595)	(2,327,912)
'배당금의 지급			(88,541)	
종속회사지분의 취득		(241)	(241)	
유상증자	2,325,977			
주식매입선택권의 행사				
현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,449,818	171,588	(9,438)	40,870
현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	(2,502)	(8,781)	4,733	(18,775)
기초현금및현금성자산	1,243,788	1,253,226	1,253,226	1,212,356
기말현금및현금성자산	2,691,104	1,416,033	1,243,788	1,253,226

2. 재무제표(별도)

재무상태표

제 65 기 1분기말 2012.03.31 현재

제 64 기말 2011.12.31 현재

제 63 기말 2010.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 65 기 1분기말	제 64 기말	제 63 기말
자산			

유동자산	5,932,262	4,307,194	4,437,352
현금및현금성자산	2,415,705	980,359	960,046
단기금융상품	665,979	588,528	844,368
매출채권	1,454,514	1,417,886	1,389,394
기타수취채권	351,070	307,753	196,678
재고자산	939,876	928,891	926,456
매각예정자산		5	24,449
기타유동자산	105,118	83,772	95,961
비유동자산	12,421,453	12,086,716	11,566,908
중속기업, 조인트벤처와 관계기업 에 대한 투자자산	2,989,863	2,989,863	3,001,328
매도가능금융자산	52,771	47,327	50,477
유형자산	8,242,641	7,902,653	7,277,397
무형자산	700,742	705,807	601,988
투자부동산	30,848	31,168	37,186
기타수취채권	29,877	30,208	142,508
기타금융자산	8,685	3,436	8,017
이연법인세자산	221,935	221,935	328,734
기타비유동자산	144,091	154,319	119,273
자산총계	18,353,715	16,393,910	16,004,260
부채			
유동부채	4,246,147	4,496,983	4,618,003
매입채무	849,297	840,146	868,338
미지급금	728,029	489,684	693,626
기타지급채무	300,608	320,395	456,164
총당부채	434,369	449,696	535,290
기타금융부채	32,457	34,315	42,426
차입금	1,869,843	2,343,892	1,999,534
기타유동부채	31,544	18,855	22,625
비유동부채	3,871,201	3,693,866	3,219,211
차입금	3,272,442	3,130,094	2,584,237
기타지급채무	56,124	70,617	197,301
퇴직급여부채	460,206	448,430	353,486
기타금융부채	45,148	7,796	54,561
기타비유동부채	37,281	36,929	29,626
부채총계	8,117,348	8,190,849	7,837,214
자본			

자본금	3,487,768	2,978,498	2,969,023
자본잉여금	3,084,060	1,267,257	1,231,064
기타포괄손익누계액	16,265	10,375	2,469
기타자본항목	5,762	5,762	5,762
이익잉여금(결손금)	3,642,512	3,941,169	3,958,728
자본총계	10,236,367	8,203,061	8,167,046
자본과부채총계	18,353,715	16,393,910	16,004,260

포괄손익계산서

제 65 기 1분기 2012.01.01 부터 2012.03.31 까지

제 64 기 1분기 2011.01.01 부터 2011.03.31 까지

제 64 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

제 63 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 65 기 1분기		제 64 기 1분기		제 64 기	제 63 기
	3개월	누적	3개월	누적		
매출액	2,367,709	2,367,709	2,703,665	2,703,665	10,188,162	11,973,426
매출원가	2,228,074	2,228,074	2,039,519	2,039,519	8,492,945	7,487,386
매출총이익	139,635	139,635	664,146	664,146	1,695,217	4,486,040
판매비와경상개발비	436,401	436,401	314,694	314,694	1,424,298	1,320,820
기타영업수익	16,028	16,028	18,064	18,064	351,434	114,807
기타영업비용	5,651	5,651	24,648	24,648	110,836	151,660
영업이익(손실)	(286,389)	(286,389)	342,868	342,868	511,517	3,128,367
금융수익	177,361	177,361	179,365	179,365	521,195	719,419
금융비용	181,680	181,680	222,045	222,045	786,628	837,157
기타영업외수익	949	949			1,621	47,263
기타영업외비용	11,571	11,571			11,392	190,305
법인세비용차감전순이익(손실)	(301,330)	(301,330)	300,188	300,188	236,313	2,867,587
법인세비용	(2,677)	(2,677)	619	619	107,171	81,642
당기순이익(손실)	(298,653)	(298,653)	299,569	299,569	129,142	2,785,945
기타포괄손익	5,886	5,886	(4,652)	(4,652)	(50,254)	(67,929)
매도가능금융자산평가이익(손실)	5,890	5,890	(4,641)	(4,641)	7,906	(12,958)
보험수리적손익	(4)	(4)	(11)	(11)	(58,160)	(54,971)
총포괄손익 소계	(292,767)	(292,767)	294,917	294,917	78,888	2,718,016
지배기업의 소유지분에 대한 주당 이익						

기본주당이익(원)	(463)	(463)	507	507	218	4,720
희석주당이익(원)	(463)	(463)	505	505	218	4,433

자본변동표

제 65 기 1분기 2012.01.01 부터 2012.03.31 까지

제 64 기 1분기 2011.01.01 부터 2011.03.31 까지

제 64 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

제 63 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지

(단위 : 백만원)

		자본					
		자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계
2010.01.01 (기초자본)		2,965,833	1,219,742	15,427	5,769	1,227,754	5,434,525
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)				2,785,945	2,785,945
		보험수리적손익				(54,971)	(54,971)
		매도가능금융자산평가손익			(12,958)		(12,958)
		총포괄손익			(12,958)		2,730,974
	주식선택권행사	13	7		(7)		13
	전환사채의전환	3,177	11,315				14,492
	배당금지급						
	유상증자						
2010.12.31 (기말자본)		2,969,023	1,231,064	2,469	5,762	3,958,728	8,167,046
2011.01.01 (기초자본)		2,969,023	1,231,064	2,469	5,762	3,958,728	8,167,046
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)				129,142	129,142
		보험수리적손익				(58,160)	(58,160)
		매도가능금융자산평가손익			7,906		7,906
		총포괄손익			7,906		70,982
	주식선택권행사						
	전환사채의전환	9,475	36,193				45,668
	배당금지급					88,541	88,541
	유상증자						
2011.12.31 (기말자본)		2,978,498	1,267,257	10,375	5,762	3,941,169	8,203,061
2011.01.01 (기초자본)		2,969,023	1,231,064	2,469	5,762	3,958,728	8,167,046
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)				299,569	299,569
		보험수리적손익				(11)	(11)
		매도가능금융자산평가손익			(4,641)		(4,641)

		총포괄손익			(4,641)		299,558	294,917	
		주식선택권행사							
		전환사채의전환	2,172	8,239				10,411	
		배당금지급					88,541	88,541	
		유상증자							
2011.03.31 (기말자본)			2,971,195	1,239,303	(2,172)	5,762	4,169,745	8,383,833	
2012.01.01 (기초자본)			2,978,498	1,267,257	10,375	5,762	3,941,169	8,203,061	
자본의 변 동	포괄손 익	당기순이익(손실)					(298,653)	(298,653)	
		보험수리적손익					(4)	(4)	
		매도가능금융자산평가손익			5,890			5,890	
		총포괄손익			5,890		(298,657)	(292,767)	
	주식선택권행사								
	전환사채의전환	20	77					97	
	배당금지급								
	유상증자	509,250	1,816,726					2,325,976	
	2012.03.31 (기말자본)			3,487,768	3,084,060	16,265	5,762	3,642,512	10,236,367

현금흐름표

제 65 기 1분기 2012.01.01 부터 2012.03.31 까지
제 64 기 1분기 2011.01.01 부터 2011.03.31 까지
제 64 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 63 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 65 기 1분기	제 64 기 1분기	제 64 기	제 63 기
영업활동현금흐름	365,248	365,041	1,817,256	4,335,263
영업으로부터 창출된 현금흐름	384,390	379,061	1,974,466	4,553,565
이자수취	14,474	18,950	65,503	53,007
이자지급	(39,538)	(32,970)	(231,595)	(275,792)
법인세납부(환급)				3,796
배당금수취	5,922		8,882	687
투자활동현금흐름	(938,944)	(632,716)	(2,526,151)	(3,944,311)
단기금융상품의 감소	391,059	665,632	1,983,348	1,475,068
파생상품거래로 인한 현금유입	1,450	2,355	19,013	
기타수취채권의 감소	53	7,686	11,661	
매각예정자산의 처분	23	3,672	6,931	18,158

매도가능금융자산의 처분	8,995			
종속기업, 조인트벤처와 관계 기업에 대한 투자자산의 처분			14,420	260,631
유형자산의 처분	22,830	345	9,207	34,785
투자부동산의 처분			12,151	
무형자산의 처분	4		10,107	
단기금융상품의 증가	(468,510)	(475,023)	(1,727,508)	(2,079,009)
파생상품거래로 인한 현금 유 출	(443)	(12,104)	(51,381)	(29,572)
매도가능금융자산의 취득		(3,048)	(11,163)	(9,557)
종속기업, 조인트벤처와 관계 기업에 대한 투자자산의 취득		(241)	(12,426)	(806,243)
유형자산의 취득	(866,608)	(786,066)	(2,613,485)	(2,579,900)
무형자산의 취득	(27,637)	(35,861)	(175,242)	(148,568)
기타수취채권의 증가	(160)	(63)	(320)	(28,271)
기타투자활동으로 인한 현금유 출			(1,464)	(51,833)
재무활동현금흐름	2,007,789	428,065	730,964	(517,664)
차입금의 증가	945,194	642,235	1,990,943	1,183,462
주식매입선택권의 행사				13
유상증자	2,325,976			
차입금의 상환	(1,263,381)	(214,170)	(1,171,438)	(1,701,139)
배당금의 지급			(88,541)	
현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,434,093	159,410	20,313	(125,945)
현금및현금성자산에 대한 환율변 동 효과	1,253	(980)	(1,756)	767
기초현금및현금성자산	980,359	960,046	960,046	1,085,991
기말현금및현금성자산	2,415,705	1,119,456	980,359	960,046

3. 대손충당금 설정현황

가. 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률
제65기	매출채권	1,575,836	3,697	0

	장·단기 대여금	11,164	6	0
	장·단기 미수금	200,602	16,201	8
	장·단기 미수수익	13,344	0	0
	장·단기 보증금	10,105	156	2
	장·단기 예치금	84,970	1,651	2
	장기성 외상매출금	74	74	100
	합 계	1,896,095	21,785	1
제64기 연간	매출채권	1,544,780	3,855	0
	장·단기 대여금	10,784	6	0
	장·단기 미수금	154,380	16,127	10
	장·단기 미수수익	7,565	0	0
	장·단기 보증금	10,086	155	2
	장·단기 예치금	74	74	100
	장기성 외상매출금	86,121	1,547	2
	합 계	1,813,791	21,764	1
제63기 연간	매출채권	1,609,018	4,066	0
	장·단기 대여금	8,554	60	1
	장·단기 미수금	162,815	15,757	10
	장·단기 미수수익	16,659	2	0
	장·단기 보증금	8,198	140	2
	장·단기 예치금	81,977	1,466	2
	장기성 외상매출금	76	76	100
	합 계	1,887,297	21,567	1

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제65기 1분기	제64기	제63기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	21,764	21,567	37,343
2. 순대손처리액(① - ② ± ③)	-	324	17,603
① 대손처리액(상각채권액)	-	324	17,603
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	21	521	1,827
4. 기말 대손충당금 잔액합계	21,785	21,764	21,567

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분		설정 기준
매출채권	1)정상채권	-.과거 경험률을 바탕으로 설정
	2)장기채권	-.거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정 -.담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정 -.담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

* 연결대상회사 매출채권 충당금 설정 제외

라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 :백만원, %)

구분		6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금액	일반	1,564,135	46	936	280	1,565,397
	특수관계자	10,438	-	-	-	10,438
	계	1,574,573	46	939	280	1,575,836
구성비율		99.9	0.0	0.0	0.0	100.0

4. 재고자산 현황 등

가. 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제65기 1분기	제64기	제63기	비고
메모리 부문	제품	386,271	384,231	374,436	-
	재공품	624,235	530,123	663,416	-
	원재료	130,346	137,742	138,796	-
	저장품	41,724	44,761	41,272	-
	미착품	71,631	86,752	63,598	-
	합계	1,254,207	1,183,608	1,281,519	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%)		6.5%	6.9%	7.3%	-

[재고자산÷기말자산총계×100]				
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고) }÷2]	7.2회	7.1회	6.5회	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 재고자산의 실사내역

실사내역	실사 일자	입회자	비고
제품	2011-12-01	삼일회계법인/ 삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체	2011-12-01		-
원부자재	2011-12-01		-
제품	2011-01-01	한영회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체	2011-01-01		-
원부자재	2011-01-01		-
제품	2010-01-01	한영회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체	2010-01-01		-
원부자재	2009-12-30		-

XII. 부속명세서

1. 공정가치평가 절차요약

회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

수준	내용
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
수준3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

보고기간 종료일 현재 공정가치로 측정된 회사의 자산과 부채는 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위: 백만원)

구분	2012.03.31			
	수준1	수준2	수준3	합계
자산				
당기손익인식금융자산				
파생상품자산	-	8,363	-	8,363
매도가능금융자산				
지분증권(시가법)	43,065	-	-	43,065
합계	43,065	8,363	-	51,428
부채				
당기손익인식금융부채				
파생상품부채	-	81,832	-	81,832
합계	-	81,832	-	81,832

<전기말>

(단위: 백만원)

구분	2010.12.31			
	수준1	수준2	수준3	합계

자산				
당기손익인식금융자산				
파생상품자산	-	3,114	-	3,114
매도가능금융자산				
지분증권(시가법)	34,498	-	-	34,498
합계	34,498	3,114	-	37,612
부채				
당기손익인식금융부채				
파생상품부채	-	46,474	-	46,474
합계	-	46,474	-	46,474

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 상품들은 대부분 단기매매 또는 매도가능으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 비상장주식)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유 정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다.

2. 유형자산의 공정가치와 그 평가방법

당사는 한국채택국제회계기준 2011년 도입을 위해 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준 최초채택' 규정에 의거 토지자산의 개별항목별 공정가치를 간주원가로 사용하여왔습니다.

당사의 토지자산에 대한 공정가치 평가는 다음과 같습니다.

(1) 평가대상: 유형자산 중 토지자산

(2) 평가금액: 4,383억원

(3) 공정가액 추정시 사용한 방법 및 중요한 가정

:전문 감정평가기관(가온감정평가법인)의 감정평가를 기초로 회사 토지에 대한 재평가를 수행하였으며, 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한법률」에 의거 공시지가를 기준하여 평가한 금액과 「감정평가에 관한 규칙」 제10조제1항의 규정에 따라 원가방식, 비교방식, 수익방식의 세가지 방식 중 대상 부동산의 성격, 평가목적 또는 평가조건을 고려하여 적정하다고 판단되는 거래사례비교법에 의한 시산가격을 비교·검토하여 최종 평가금액을 산정함.

(4) 원가모형 비교

:재평가된 유형자산이 토지에 대해 원가모형을 적용하여 평가하였을 경우 장부금액은 2,567억원입니다.

공정가치평가 결과는 한국채택국제회계기준 도입기준일인 2011년 1월 1일에 장부에 반영하고, 한국채택국제회계기준 전환일인 2010년 1월 1일의 재무상태표에 포함하여 비교 표시하였습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.